

# 瑞昱半導體股份有限公司

## 公開說明書

### (發行一四年限制員工權利新股申報用)

一、公司名稱：瑞昱半導體股份有限公司

二、公開說明書編印目的：發行一四年限制員工權利新股

(一)發行種類：本公司普通股股票。

(二)發行股數及金額：2,700,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總額為新台幣 27,000,000 元。

(三)發行價格：新台幣 0 元發行，即無現金對價之無償配發予員工。

(四)發行條件：請參閱本公開說明書附件一。

(五)發行期間：於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，授權董事會一次或分次發行之。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。

四、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：不適用。

(二)其他費用，包括會計師、律師等其他費用約新台幣 150,000 元。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項：請參閱本公開說明書第 7~9 頁說明。

八、查詢本公開說明書之網址：

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

公司網站：<https://www.realtek.com>



瑞昱半導體股份有限公司 編製

中 華 民 國 一 一 四 年 六 月 二 十 三 日 刊 印

一、本次發行前實收資本額之來源：

單位：新台幣仟元；%

資本來源	金額	占實收資本額比率
設立資本	5,000	0.10
現金增資	611,950	11.93
資本公積轉增資	1,745,504	34.03
盈餘轉增資	5,586,756	108.94
可轉換公司債	1,410,314	27.50
註銷庫藏股	(129,310)	(2.52)
員工酬勞轉增資	79,123	1.54
減資	(4,180,701)	(81.52)
合計	5,128,636	100

二、公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：依規定函送金融監督管理委員會、台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。

(二)分送方式：除依規定派員送達主管機關外，依證交法第三十一條辦理。

(三)索取方式：請透過網路取閱 (<http://mops.twse.com.tw>) 查詢。

三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：不適用

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部 網址：[www.ctbcbank.com](http://www.ctbcbank.com)

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓 電話：(02)6636-5566

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：李典易、鄭雅慧 網址：[www.pwc.tw](http://www.pwc.tw)

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 電話：(02)2729-6666

地址：臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：黃依瑋

代理發言人姓名：陳慧珊

職稱：副總經理

職稱：總經理特助

聯絡電話：(03)578-0211

電子郵件信箱：[investors@realtek.com](mailto:investors@realtek.com)

十三、公司網址：<https://www.realtek.com>

## 瑞昱半導體股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：5,128,636仟元	公司地址：新竹科學園區創新二路2號	電話：(03)578-0211
設立日期：76年10月21日	網址： <a href="https://www.realtek.com">https://www.realtek.com</a>	
上市日期：87年10月26日	上櫃日期：無	公開發行日期：81年10月30日 管理股票日期：不適用
負責人：董事長 邱順建	發言人：黃依瑋 副總經理 代理發言人：陳慧珊 總經理特助	
股票過戶機構：中國信託商業銀行服務代理部	電話：(02) 6636-5566 地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	網址： <a href="http://www.ctbcbank.com">www.ctbcbank.com</a>
股票承銷機構：無	電話：無 地址：無	網址：無
最近年度簽證會計師： 資誠聯合會計師事務所 李典易、鄭雅慧會計師	電話：(02)2729-6666 地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓	網址： <a href="http://www.pwc.tw">www.pwc.tw</a>
現任簽證會計師： 資誠聯合會計師事務所 李典易、鄭雅慧會計師	電話：(02)2729-6666 地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓	網址： <a href="http://www.pwc.tw">www.pwc.tw</a>
複核律師：不適用	電話：不適用 地址：不適用	網址：不適用
信用評等機構：不適用	電話：不適用 地址：不適用	網址：不適用
評等標的	發行公司：不適用	無■；有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用
	本次發行公司債：不適用	無■；有□，評等日期：不適用 評等等級：不適用
董事選任日期：113年5月30日，任期：3年	監察人選任日期：不適用	
全體董事持股比例：3.21% (114年5月31日)	全體監察人持股比例：不適用	
董事、監察人及持股超過 10% 股東及其持股比例：(114 年 5 月 31 日)		
<u>職 稱</u>	<u>姓 名</u>	<u>持 股 比 例</u>
董事長	莫理仕有限公司 代表人：邱順建	0.64%
副董事長	莫理仕有限公司 代表人：黃湧芳	0.64%
董事	桃德有限公司 代表人：葉博任	0.62%
董事	顏光裕	0.00%
董事	倪淑卿	1.23%
董事	德佳投資股份有限公司 代表人：葉明翰	0.72%
獨立董事	楊泮池	-
獨立董事	柯復華	-
獨立董事	謝穎青	-
工廠地址：新竹科學園區創新二路2號	電話：(03) 578-0211	
主要產品：積體電路	市場結構：(113 年度) 內銷 39.19% 外銷 60.81%	參閱本文之頁次 第36頁
風 險 事 項	請參閱本公開說明書公司概況之風險事項	參閱本文之頁次 第7~9頁

去(113)年度	營業收入：新台幣113,393,698仟元；稅前純益：新台幣16,341,210仟元 ；每股盈餘：新台幣29.82元	第19、48頁
本次募集發行有價證券種類及金額	請參閱本公開說明書封面	
發行條件	請參閱本公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概述	不適用	
本次公開說明書刊印日期：114年6月23日	刊印目的：發行一一四年限制員工權利新股	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄		

**瑞昱半導體股份有限公司**  
**公開說明書**  
**目 錄**

<b>壹、公司概況</b> .....	1
一、公司簡介 .....	1
(一)設立日期 .....	1
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話 .....	1
(三)公司沿革 .....	1
二、風險事項 .....	7
(一)風險因素 .....	7
(二)訴訟或非訴訟事件 .....	8
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響 .....	8
(四)其他重要事項 .....	9
三、公司治理報告 .....	10
(一)關係企業組織圖 .....	10
(二)董事 .....	12
四、資本及股份 .....	17
(一)股本形成過程 .....	17
(二)最近股權分散情形 .....	18
(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 .....	19
(四)員工及董事酬勞 .....	19
<b>貳、營運概況</b> .....	21
一、公司之經營 .....	21
(一)業務內容 .....	21
(二)市場及產銷概況 .....	36
二、轉投資事業 .....	40
(一)轉投資事業概況 .....	40
三、重要契約 .....	42
<b>參、發行計畫及執行情形</b> .....	43
一、本次發行限制員工權利新股應記載事項 .....	43
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項 .....	43
三、本次併購發行新股應記載事項 .....	43
<b>肆、財務概況</b> .....	44
一、最近五年度簡明財務資料 .....	44
(一)財務分析 .....	44
二、財務報告應記載事項 .....	47
(一)最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告 .....	47
(二)最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告 .....	47
(三)申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告 .....	47
三、財務概況應記載事項 .....	47
(一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第 185 條情事者 .....	47

四、財務狀況及經營結果檢討分析 .....	47
(一)財務狀況 .....	47
(二)財務績效 .....	48
(三)現金流量分析 .....	48
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	48
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 .....	48
(六)其他重要事項 .....	49
伍、特別記載事項 .....	50
一、內部控制制度執行狀況 .....	50
二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告 .....	50
三、證券承銷商評估總結意見 .....	50
四、律師法律意見書 .....	50
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 .....	50
六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項 .....	50
七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 .....	50
八、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書 .....	50
九、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書 .....	50
十、公司治理運作情形 .....	50
(一)董事會運作情形 .....	50
(二)審計委員會運作情形 .....	54
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .....	56
(四)薪資報酬委員會之組成及運作情形 .....	62
(五)提名委員會之組成及運作情形 .....	64
(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 .....	66
(七)公司氣候相關資訊 .....	74
(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 .....	78
(九)公司治理守則及相關規章之揭露查詢方式 .....	81
(十)最近年度及截至本公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 .....	81
(十一)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 .....	81

## 壹、公司概況

### 一、公司簡介

#### (一) 設立日期

瑞昱半導體成立於民國76年10月21日，並於民國87年10月在台灣證券交易所掛牌上市。公司總部設於台灣，並於中國大陸、新加坡、美國、日本及韓國設有銷售或研發團隊。

#### (二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：新竹科學園區創新二路2號

電話：(03) 578-0211

二廠：新竹科學園區園區二路9號

電話：(03) 578-0211

三廠：新竹科學園區園區二路9-1號

電話：(03) 578-0211

#### (三) 公司沿革

- 1987年10月 公司正式成立。
- 1988年04月 台北辦事處成立。
- 1991年12月 口袋型乙太網路控制器獲頒科學園區產品「創新技術獎」。
- 1993年12月 視窗加速器榮獲新竹科學園區「創新產品獎」。
- 1995年02月 全雙工隨插即用乙太網路控制器榮獲 EDN Asia 頒發「產品創新獎」。
- 1996年12月 以企業整體研發投入與績效獲新竹科學園區頒發「研究發展投入獎」。
- 1997年06月 高速乙太網路單一晶片控制器在台北國際電腦展榮獲「最佳零組件」與「最佳產品」二項大獎。
- 1997年09月 股票公開上櫃。
- 1997年11月 高速乙太網路單一晶片控制器獲頒經濟部工業局「新產品開發獎」。
- 1998年10月 股票轉上市掛牌。
- 1998年12月 連續第四年獲科學園區管理局頒發「研究發展投入獎」。
- 1999年12月 以四埠高速乙太網路收發器獲國科會新竹科學園區管理局創新技術研發獎助。
- 2000年05月 第一次發行無擔保可轉換公司債，總金額達新台幣壹拾肆億元整。
- 2000年08月 優異研發成果榮獲經濟部第八屆產業科技發展獎之「傑出獎」。
- 2001年12月 以多功能模組單晶片 10/100M 高速乙太網路控制器獲得 EDA Asia 雜誌評選為年度最佳零組件設計。
- 2002年01月 第一次發行海外存託憑證，總金額達美金 240,180,375 元。
- 2002年06月 以 ALC650 六聲道高階音訊轉換晶片榮獲 2002 年台北電腦展評選為「最佳外銷資訊產品獎」。

- 2002 年 11 月 獲得新電子科技雜誌主辦之「十大傑出電子零件供應商」之一。
- 2003 年 10 月 連續兩年以整體營業績效獲美國 Forbes 雜誌評列為全球前 200 最佳中小企業之一。
- 2003 年 10 月 RTL8169S/RTL8110 Gigabit 超高速乙太網路單晶片控制器獲得國科會新竹科學園區管理局「創新產品獎」。
- 2004 年 03 月 以 PCI Express 超高速乙太網路控制器單晶片，獲國科會新竹科學園區管理局創新研究發展獎助新台幣 300 萬元。
- 2004 年 06 月 雙頻三模無線區域網路晶片組 RTL8185L 及 RTL8255 獲台北國際電腦展 (Computex Taipei 2004) 之「台灣最佳外銷資訊產品獎」(Best Choice of Computex)。
- 2004 年 09 月 IEEE802.11a/b/g 無線區域網路晶片組 RTL8185L 及 RTL8255 的參考設計通過 Wi-Fi 聯盟的 WPA2 安全性測試，並成為 WPA2 無線網路卡端標準測試平台之一。
- 2004 年 10 月 雙頻三模無線區域網路晶片組獲得資訊月活動委員會評選為 93 年資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」。
- 2004 年 12 月 無線區域網路晶片組(RTL8187L + RTL8255)榮獲國科會新竹科學園區管理局創新產品獎。
- 2004 年 12 月 獲國科會新竹科學園區管理局頒發年度「研發成效獎」。
- 2005 年 3 月 發表 7.1+2 聲道 High Definition 音訊轉換晶片 ALC882。
- 2005 年 6 月 新竹科學園區創新二路新廠房正式落成啟用。
- 2005 年 8 月 推出全球第一顆整合 5V/3.3V 電源調整器與功率電晶體的 USB 2.0 多合一讀卡機控制晶片 RTS5111。
- 2005 年 11 月 再度以扎实的研發成果榮獲國科會新竹科學園區管理局所頒發的「研發成效獎」。
- 2006 年 3 月 推出新一代 High Definition 音訊轉換晶片 ALC885&ALC888 Telecom。
- 2006 年 3 月 ALC888 Telecom 榮獲 2006 IDF(Digital Office Platform'的 TIAA(Technology Innovation Acceleration Award)獎項。
- 2006 年 8 月 通過 ISO14001 環境管理系統驗證。
- 2006 年 10 月 瑞昱正式邁入建廠 20 週年里程碑。
- 2006 年 12 月 ALC888 Telecom 榮獲國科會新竹科學園區管理局「創新產品獎」。
- 2006 年 12 月 連續第三年榮獲新竹科學園區管理局「研發成效獎」。
- 2007 年 1 月 召開臨時股東會決議通過現金減資案，減資金額為新台幣 4,180,701,000 元(每股可退還現金約新台幣 5 元)，減資比率為 50%。
- 2007 年 6 月 PCI Express 超高速乙太網路控制單晶片 RTL8111C 榮獲 2007 年台北國際電腦展「最佳外銷資訊產品獎」。
- 2007 年 7 月 發表採用 GreenEthernet 先進專利技術之低功耗高整合度的 6 埠超高速乙太網路交換器單晶片 RTL8366S/RTL8366SR。
- 2007 年 10 月 推出業界第一顆整合 NAND Flash card reader, Smart card reader, Finger print 介面以及 IR 接收多功能讀卡機晶片 RTS5161/68/69。
- 2007 年 10 月 推出業界第一顆整合 2W Class-D Amplifier 及符合最新 Low Power 規格的 HD Audio Codec ALC269，為筆記型電腦省電趨勢帶入新紀元。

- 2007年11月 推出音效雜訊比(SNR)高達 108dB 以及業界唯一支援全頻藍光光碟撥放 (Full Rate Blue-Ray DVD Playback)的 HD Audio Codec ALC889，為電腦邁向數位家庭跨進一大步。
- 2007年12月 PCI Express 超高速乙太網路控制晶片 RTL8111C-GR，榮獲 2007 年國科會新竹科學工業園區「創新產品獎」。
- 2007年12月 連續第四年榮獲國科會新竹科學園區管理局「研發成效獎」。
- 2008年5月 於 2008 年台北國際電腦展 (COMPUTEX TAIPEI) 中展示一系列的網路多媒體單晶片解決方案。
- 2008年6月 RTD2485D 多合一 LCD 螢幕控制晶片榮獲 2008 年台北國際電腦展「最佳外銷資訊產品獎」。
- 2008年9月 推出全世界最小、耗功最低、第一顆整合 MAC\BB\RF、送收開關、功率放大器、EEPROM 和交換式電源控制器之 802.11n 單晶片無線網路控制器 RTL8191S 和 RTL8192S 系列產品。
- 2008年10月 RTL8366SR 6 埠超高速乙太網路交換器單晶片榮獲 EDN China 「2008 年度創新獎」。
- 2008年12月 RTD2485D 多合一 LCD 螢幕控制晶片榮獲 97 年科學工業園區優良廠商「創新產品獎」。
- 2009年8月 榮獲 98 年「國家發明創作獎之貢獻獎」。
- 2009年10月 推出全球首顆應用 IEEE 802.3az 標準的 RTL8111E 超高速乙太網路單晶片。
- 2009年10月 RTD1083 全高清數位媒體處理器榮獲 EDN China 2009 「年度創新獎」。
- 2009年11月 RTD1083/1283 Full HD 數位媒體處理器榮獲 98 年資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」。
- 2009年11月 RTL8111DP-GR PCI Express 超高速乙太網路遠端控管晶片榮獲 98 年國科會新竹科學工業園區優良廠商「創新產品獎」。
- 2009年11月 榮獲 98 年國科會新竹科學工業園區「國際交流合作獎」。
- 2009年11月 榮獲 98 年新竹科學工業園區「研發成效獎」。
- 2010年1月 於 2010 CES 展示領先業界的「Green Ethernet」、IEEE 802.3az 乙太網路單晶片及交換器產品，並展出只需 USB 埠供電的全球最省電的「Green WLAN」802.11n 2x2 無線路由器...等多項新產品及技術。
- 2010年6月 ALC899-GR 高音質音訊編碼解碼晶片榮獲 2010 年台北國際電腦展「台灣最佳外銷資訊產品獎」。
- 2010年6月 RTL8111E 超高速乙太網路單晶片榮獲 2010 年台北國際電腦展「台灣最佳外銷資訊產品獎」。
- 2010年12月 RTL8111E 超高速乙太網路單晶片榮獲 99 年資訊月「傑出資訊應用暨產品獎」。
- 2010年12月 RTL8367M 7 埠超高速乙太網路交換器單晶片榮獲 99 年「科學工業園區優良廠商創新產品獎」。
- 2010年12月 榮獲 99 年「科學工業園區研發成效獎」。
- 2011年10月 獲頒經濟部國際貿易局「第一屆台灣綠色典範獎」。
- 2011年12月 獲頒經濟部工業局「工業精銳獎」。
- 2011年12月 榮獲經濟部技術處頒發「國家產業創新獎-績優創新企業獎」。
- 2011年12月 榮獲 100 年「科學工業園區研發成效獎」。

- 2012 年 12 月 ALC5642 傳真音訊編解碼暨語音/音效數位訊號處理器單晶片榮獲 101 年「科學工業園區優良廠商創新產品獎」。
- 2012 年 12 月 榮獲 101 年「科學工業園區研發成效獎」。
- 2013 年 6 月 RTD2995 4K2K UHD 智能電視單晶片榮獲 2013 台北國際電腦展 Best Choice Golden Award。
- 2013 年 11 月 RTL8153 低功耗 USB 3.0-to-Gigabit Ethernet 控制晶片榮獲 EDN China 2013 年度創新獎。
- 2013 年 12 月 RTD2995 4K2K UHD 智能電視單晶片榮獲 102 年「科學工業園區優良廠商創新產品獎」。
- 2014 年 6 月 RTL8118AS 低功耗遊戲用乙太網路解決方案榮獲 2014 台北國際電腦展 Best Choice Award「綠色節能產品獎」。
- 2014 年 6 月 RTL8881A AP/Router 網路處理器單晶片(包含 11ac 元件)榮獲 2014 台北國際電腦展 Best Choice Award「通信類組獎」。
- 2015 年 4 月 子公司 Realtek Singapore Pte Ltd 取得美國 Cortina Access, Inc. 暨其子公司之 100% 股權。
- 2015 年 6 月 RTL8195AM 低功耗無線網路物聯網系統單晶片榮獲 2015 台北國際電腦展 Best Choice Golden Award。
- 2015 年 12 月 瑞昱 RTD2999 4K 超高畫質智慧電視系統單晶片榮獲 104 年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」。
- 2016 年 6 月 瑞昱 RTL8762A 高整合低功耗藍牙單晶片榮獲 2016 年台北國際電腦展 Best Choice Golden Award。
- 2016 年 6 月 瑞昱 RTS5421 USB 3.1 Type-C 集線器晶片榮獲 2016 年台北國際電腦展 Best Choice Golden Award。
- 2016 年 12 月 瑞昱以整體研發成效榮獲 107 年「科學工業園區研發成效獎」。
- 2016 年 12 月 瑞昱半導體整合乙太網路之車用影像暨音訊處理單晶片(RTL9020AA)榮獲 107 年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」。
- 2017 年 6 月 瑞昱 RTL9047A 車用乙太網路交換器單晶片榮獲 2017 台北國際電腦展 Best Choice Award「車用電子」類別獎
- 2017 年 6 月 瑞昱 RTL8771B 低功耗全球衛星定位晶片榮獲 2017 台北國際電腦展 Best Choice Award「移動及穿戴設備」類別獎
- 2017 年 6 月 瑞昱 RTL8763B 世界最省電藍牙 5 之雙模音頻晶片榮獲 2017 台北國際電腦展 Best Choice Award「IC 與零組件產品」類別獎
- 2017 年 6 月 瑞昱 RTL8117 網路儲存個人雲晶片方案榮獲 2017 台北國際電腦展 Best Choice Award 評審團特別獎
- 2017 年 11 月 瑞昱通訊網路事業群 CN3 無線網路研發團隊榮獲「2017 科技管理獎」
- 2018 年 5 月 瑞昱推出全球首顆涵蓋電競解決方案的超高速 2.5G 乙太網路單晶片
- 2018 年 6 月 瑞昱 RTL8715A 高整合度超低功耗無線網路攝影機單晶片榮獲 2018 台北國際電腦展 Best Choice Award「IOT 應用」類別獎
- 2018 年 6 月 瑞昱 RTL8762C 藍牙 5 低功耗單晶片榮獲 2018 台北國際電腦展 Best Choice Award「IC 與零組件產品」類別獎
- 2018 年 6 月 瑞昱 ALC5520 多麥克風遠距語音識別增強單晶片解決方案榮獲 2018 台北國際電腦展 Best Choice Award 金獎
- 2018 年 6 月 瑞昱榮獲「2018 亞洲企業社會責任獎」

- 2018年12月 瑞昱多麥克風遠距語音識別增強單晶片解決方案 (ALC5520) 榮獲 108 年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2019年6月 瑞昱RTD2893 8K影像解碼與處理晶片榮獲2019年台北國際電腦BC Award金獎及年度最佳產品獎
- 2019年6月 瑞昱RTL8773B 藍牙5主動式降噪智能耳機方案榮獲2019年台北國際電腦展BC Award金獎
- 2019年6月 瑞昱RTL8722DM Ameba D: 超低耗電多功能物聯網方案榮獲2019台北國際電腦展BC Award「IoT Applications」類別獎
- 2019年12月 瑞昱RTD2893 8K影像解碼與處理晶片榮獲108年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2019年12月 瑞昱以整體研發成效榮獲108年「科學工業園區研發成效獎」
- 2020年12月 瑞昱全球最小封裝最低功耗2.5G USB乙太網路單晶片(RTL8156B)榮獲109年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2020年12月 瑞昱以整體研發成效榮獲109年「科學工業園區研發成效獎」
- 2021年5月 瑞昱新一代高度整合2.5GbE電競網路解決方案(RTL8125BG + RTL8852AE & RTL9313 + RTL8221B)榮獲2021台北國際電腦展創新設計獎
- 2021年7月 瑞昱車載乙太網路交換器晶片 (RTL9075AAD/RTL9072AAD)榮獲2021台北國際電腦展BC Award金獎
- 2021年7月 瑞昱低功耗AI攝影機晶片(RTS3916N)榮獲2021台北國際電腦展BC Award「AI, Big Data & Cloud Computing」類別獎
- 2021年9月 瑞昱榮獲「2021亞洲企業社會責任獎」
- 2022年4月 瑞昱獲選科睿唯安2022「全球百大創新機構」
- 2022年5月 瑞昱RTL8763E 藍牙雙模語音手錶方案榮獲2022年台北國際電腦展 Best Choice Award「IC and Component」類別獎
- 2022年5月 瑞昱RTD2892NND AI超級解像度晶片榮獲2022年台北國際電腦展 Best Choice Award金獎及年度最佳產品獎
- 2022年11月 瑞昱(RTL8125BG、RTL8156BG)2.5千兆乙太網路控制器榮獲第31屆「台灣精品獎」
- 2022年12月 瑞昱RTS5863首創具邊緣運算能力之USB攝影機控制器榮獲111年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2023年4月 瑞昱獲選科睿唯安2023全球百大創新機構
- 2023年5月 瑞昱AI運算USB攝影機晶片(RTS5863)榮獲2023台北國際電腦展 Best Choice Award金獎
- 2023年10月 榮獲111年度經濟部國際貿易署授予「出進口績優廠商證明標章」
- 2023年11月 瑞昱USB4集線器控制器(RTS5490)榮獲2023亞洲金選獎「年度IP/Processor最佳潛力標竿獎」
- 2023年12月 瑞昱ALC5575具類神經網路運算加速器之車用智能音訊數位信號處理器榮獲112年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2024年1月 瑞昱邊緣人工智能人體感應USB攝影機晶片(RTS5866)榮獲CES 2024 Innovation Awards
- 2024年4月 瑞昱獲選科睿唯安2024全球百大創新機構
- 2024年5月 瑞昱Wi-Fi 7 4x5無線單晶片(RTL8934AR)榮獲2024台北國際電腦展 Best Choice Award「Networking & Communication」類別獎

- 2024 年 5 月 瑞昱智能車用音訊處理器(ALC5575) 榮獲 2024 台北國際電腦展 Best Choice Award 「Vehicle Technology & Smart Cockpit」類別獎
- 2024 年 5 月 瑞昱 2.5GBASE-T1 MACsec 乙太網收發器(RTL9021AS) 榮獲 2024 台北國際電腦展 Best Choice Award 「Vehicle Technology & Smart Cockpit」類別獎
- 2024 年 5 月 瑞昱新一代智能物聯網智慧家居單晶片(RTL8730E) 榮獲 2024 台北國際電腦展 Best Choice Award 金獎
- 2024 年 10 月 瑞昱 ALC5575 具類神經網路運算加速器之 車用智能音訊數位信號處理器 榮獲 2024 亞洲金選獎“年度 IP/Processor 最佳潛力標竿獎”
- 2024 年 10 月 瑞昱獲選台灣董事學會與企業發展研究中心 2024 外資精選台灣 100 強
- 2024 年 11 月 瑞昱 RTL8730E 智慧物聯網智慧家居單晶片 榮獲 113 年「新竹科學工業園區優良廠商創新產品獎」
- 2024 年 11 月 瑞昱 RTL8126-CG 5 千兆乙太網路控制器榮獲第 33 屆「台灣精品獎」
- 2025 年 5 月 瑞昱超低功耗多模態 AI 系統單晶片(RTL8735C) 榮獲 2025 台北國際電腦展 Best Choice Award 金獎
- 2025 年 5 月 瑞昱多功能無線高速傳輸晶片(RTL8922D) 榮獲 2025 台北國際電腦展 Best Choice Award 「IC & Component」類別獎
- 2025 年 5 月 瑞昱企業邊緣 AI 交換機晶片(RTL9335) 榮獲 2025 台北國際電腦展 Best Choice Award 「Networking & Communication」類別獎

## 二、風險事項

### (一) 風險因素：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率變動對本公司影響主要為定期存款與長短期借款，尚無重大風險。

本公司係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元。因應匯率變動對公司損益之影響，本公司政策為集團內各公司透過集團財務單位就其整體匯率風險進行避險，並以採用自然避險方式進行為主。

通貨膨脹對本公司損益尚無重大影響。

2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司採取穩健保守之投資政策，並未從事高風險及高槓桿之投資。本公司訂有資金貸與他人及背書保證作業程序、從事衍生性商品處理程序，據以作為從事上述交易之依據，並以提升公司營運績效及降低財務風險為目標。

3. 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司持續研發通訊網路、電腦週邊、多媒體、聯網多媒體及智慧互聯等相關晶片，並積極延攬優秀研發人才，投入最佳研發資源，自行研發關鍵技術，或透過支付技術權利金等方式取得必要技術，預計未來 114 年將投入約 355 億研發費用。

4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司密切關注國內外重要政策與法律之變動，適時配合調整公司內部制度及營運措施，以確保公司運作合規與順暢。

最近年度及截至公開說明書刊印日止，國內外重要政策及法令變動對本公司財務業務尚未造成重大影響。

5. 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意科技改變趨勢，目前除了致力於及時推出新產品外，並將配合市場趨勢及客戶需求，不斷提昇產品功能與技術規格，以強化市場之競爭力及市占率。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司之企業文化為自信信人，以誠信為本公司企業文化之主軸，未來本公司將繼續以誠信之文化，維持良好之企業形象。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

因應公司未來成長需求及營運發展之用，本公司會評估擴充廠房需求與其相關效益和風險後，採取必要的因應措施，以達到公司的營運目標。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：  
本公司原料以晶圓為主，與晶圓製造廠維持良好合作關係，並無集中向單一廠商進貨情形。另，本公司銷貨客戶亦未集中於單一對象，且收款期間依公司政策執行，尚無異常情形。
10. 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
12. 其他重要風險及因應措施：無。

(二) 訴訟或非訴訟事件：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：
  - (1) DivX, LLC於民國109年於美國國際貿易委員會及美國德拉瓦州法院控告本公司晶片產品侵害其專利權。DivX, LLC已於民國110年7月4日終止於美國國際貿易委員會控告本公司之訴訟。於美國德拉瓦州法院之案件目前仍依相關上訴程序審理中，本公司尚無法對結果進行任何預測。
  - (2) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.及PHILIPS NORTH AMERICA LLC於民國109年於美國國際貿易委員會及美國德拉瓦州法院控告本公司晶片產品，侵害其專利權。美國國際貿易委員會於民國111年3月23日做出最終判決，判定本公司晶片產品不侵權且原告未符合國內產業之要件。於美國德拉瓦州法院之案件目前仍依相關程序審理中，本公司尚無法對結果進行任何預測。
  - (3) ParkerVision, Inc.於民國111年於西德州法院控告本公司晶片產品，侵害其專利權。該案件目前正依相關程序審理中，本公司尚無法對結果進行任何預測。
  - (4) 本公司於民國112年於美國北加州聯邦地方法院對聯發科技股份有限公司、Future Link Systems, LLC及Future Link之母公司IPValue Management提起告訴，指控其違反包括但不限於美國反壟斷法及不公平競爭法等法令。該案件目前正依相關程序審理中，本公司尚無法對結果進行任何預測。
  - (5) ParkerVision, Inc.於民國112年於西德州法院另案控告本公司晶片產品，侵害其專利權。該案件目前正依相關程序審理中，本公司尚無法對結果進行任何預測。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

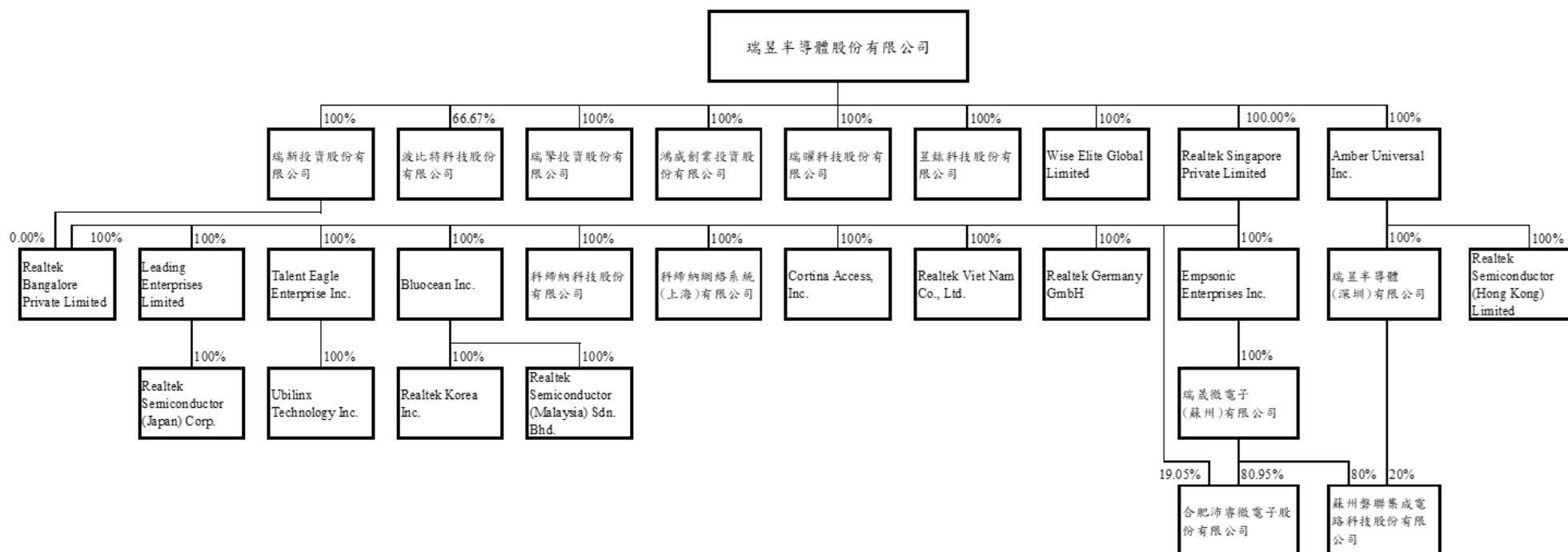
(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公

開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四) 其他重要事項：無。

三、公司治理報告  
 (一) 關係企業組織圖

截至 114 年 3 月 31 日止



本公司與關係企業之關係、相互持股情形、股份及實際投資金額

114年3月31日，單位：股數 / 新台幣千元；%

關係企業名稱	與本公司關係	本公司投資情形(註)		
		持股比例	股數	實際投資金額
Amber Universal Inc.	子公司	100%	41,432	1,905,162
Realtek Singapore Private Limited	子公司	100%	116,059,638	4,708,031
瑞新投資股份有限公司	子公司	100%	28,000,000	280,000
鴻威創業投資股份有限公司	子公司	100%	25,000,000	250,000
瑞擎投資股份有限公司	子公司	100%	29,392,985	293,930
瑞曜科技股份有限公司	子公司	100%	500,000	5,000
波比特科技股份有限公司	子公司	66.67%	1,918,910	19,189
昱鉉科技股份有限公司	子公司	100%	2,000,000	20,000
Wise Elite Global Limited	子公司	100%	1,000	33,182
Realtek Semiconductor (Japan) Corp.	孫公司	100%	400	4,450
Realtek Semiconductor (Hong Kong) Limited	孫公司	100%	-	6,398
Empsonic Enterprises Inc.	孫公司	100%	2,825,000	937,392
Cortina Access, Inc.	孫公司	100%	16,892	1,335,352
科締納科技股份有限公司	孫公司	100%	21,130,000	66,364
Realtek Viet Nam Co., Ltd.	孫公司	100%	4,000,000	132,728
Leading Enterprises Limited	孫公司	100%	34,630	16,389,585
Bluocean Inc.	孫公司	100%	110,050,000	3,651,679
Talent Eagle Enterprise Inc.	孫公司	100%	114,100,000	3,786,066
Realtek Germany GmbH	孫公司	100%	500,000	17,971
Realtek Bangalore Private Limited	孫公司	100%	1,300,000	5,037
Ubilinx Technology Inc.	孫公司	100%	60,000,000	1,990,920
Realtek Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd.	孫公司	100%	10,450,000	78,141
Realtek Korea Inc.	孫公司	100%	200,000	45,080
科締納網絡系統(上海)有限公司	孫公司	100%	-	119,455
瑞晟微電子(蘇州)有限公司	孫公司	100%	-	929,096
瑞昱半導體(深圳)有限公司	孫公司	100%	-	165,910
合肥沛睿微電子股份有限公司	孫公司	100%	-	120,115
蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司	孫公司	100%	-	45,758

註：本公司之關係企業未持有本公司股票。

## (二) 董事

### 1. 董事資料

114年5月31日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份(註)		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	Belize	莫理仕有限公司	—	113.05.30	三年	110.08.09	3,265,954	0.64%	3,265,954	0.64%	—	—	—	—	不適用	不適用	—	—	—
董事長	中華民國	莫理仕有限公司 代表人：邱順建	男 61~70歲	113.05.30	三年	89.06.09	883,831	0.17%	883,831	0.17%	1,384	0.00%	—	—	台灣大學電機所碩士	瑞昱半導體(股)公司董事長 瑞昱半導體(股)公司所屬關係企業之董事長/董事	—	—	—
副董事長	中華民國	莫理仕有限公司 代表人：黃湧芳	男 51~60歲	113.05.30	三年	107.06.05	42,205	0.01%	42,205	0.01%	75,625	0.01%	—	—	紐約州立大學電機所碩士	瑞昱半導體(股)公司執行長 瑞昱半導體(股)公司所屬關係企業之董事長/董事	—	—	—
董事	中華民國	桃德股份有限公司	—	113.05.30	三年	113.05.30	1,846,000	0.36%	3,166,000	0.62%	—	—	—	—	不適用	不適用	—	—	—
董事	中華民國	桃德股份有限公司 代表人：葉博任	男 61~70歲	113.05.30	三年	80.06.26	1,773,899	0.35%	1,513,899	0.30%	208,398	0.04%	—	—	英國拉夫伯諾大學材料工程博士	瑞昱半導體(股)公司所屬關係企業之董事長/董事	—	—	—
董事	中華民國	顏光裕	男 51~60歲	113.05.30	三年	110.08.09	23,948	0.00%	23,948	0.00%	4,000	0.00%	—	—	交通大學電信所碩士	瑞昱半導體(股)公司總經理 瑞昱半導體(股)公司所屬關係企業之董事	—	—	—
董事	中華民國	倪淑卿	女 61~70歲	113.05.30	三年	80.06.26	6,308,389	1.23%	6,308,389	1.23%	6,569,949	1.28%	—	—	空中商專	無	—	—	—
董事	中華民國	德佳投資股份有限公司	—	113.05.30	三年	113.05.30	3,648,035	0.71%	3,668,035	0.72%	—	—	—	—	不適用	不適用	—	—	—
董事	中華民國	德佳投資股份有限公司 代表人：葉明翰	男 41~50歲	113.05.30	三年	113.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	大同工學院工業設計系學士	瑞昱半導體(股)公司總經理特助 德佳投資(股)公司董事長 恆軒(股)公司董事 西德有機化學藥品(股)公司法人董事代表人	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份(註)		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
																精技電腦(股)公司法人董事代表人 精聯電子(股)公司法人董事代表人			
獨立董事	中華民國	楊泮池	男 71~80歲	113.05.30	三年	113.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學醫學院臨床醫學研究所博士	鑽石生技投資股份有限公司法人董事代表人暨董事長 台新人壽保險股份有限公司董事 永明生技投資股份有限公司董事 財團法人台灣人工智慧發展基金(Taiwan AI Labs) 董事 社團法人國家生技醫療產業策進會副會長 國立臺灣大學醫學院特聘研究講座 台灣生技醫藥發展基金會董事長 臺灣大學醫學院內科教授 中央研究院院士 基因體醫學國家型計畫微陣列核心實驗室負責人 基因體醫學國家型計畫肺癌組與吳成文院士擔任共同召集人 臺灣大學永齡健康研究院院長 宏碁股份有限公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	柯復華	男 61~70歲	113.05.30	三年	113.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士	SEMI DA Advisory LLC 負責人	-	-	-
獨立董事	中華民國	謝穎青	男 61~70歲	113.05.30	三年	113.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學法律系學士	太穎國際法律事務所主持律師 合作金庫金融控股股份有限公司獨立董事 大陸事務委員會諮詢委員	-	-	-

註：選任時持有股份，係指 113 年 4 月 1 日停止過戶股東名簿所記載股份數額。

表一：法人股東之主要股東

114年5月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
桃德股份有限公司	樂輝全球股份有限公司(持股 30.12%) 昇輝國際股份有限公司(持股 30.12%) 擎輝全球股份有限公司(持股 30.12%) 淑任股份有限公司(持股 9.64%)
德佳投資股份有限公司	葉明翰(持股 33.34%)、葉柏君(持股 33.33%)、葉威延(持股 33.33%)
莫理仕有限公司	Target Way Co., Ltd. (持股 100%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年5月31日

法人名稱	法人之主要股東
Target Way Co., Ltd.	Risetek Co., Ltd. (持股 100%)

## 2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
莫理仕有限公司 代表人：邱順建		經營管理、策略規劃、領導決策、國際行銷、技術研發	請參閱本公說書第16頁董事會獨立性說明	—
莫理仕有限公司 代表人：黃湧芳		經營管理、技術研發、危機處理		—
桃德股份有限公司 代表人：葉博任		經營管理、策略規劃、領導決策		—
顏光裕		經營管理、技術研發、國際行銷		—
倪淑卿		經營管理、會計及財務分析		—
德佳投資股份有限公司 代表人：葉明翰		經營管理、產業知識		—
楊泮池		生醫專業、經營管理、策略規劃		1
柯復華		科技專業、經營管理、產業知識		—
謝穎青		法律專業、營運判斷、危機處理		1

註：本公司董事未有公司法第30條各款情事。

## 3. 董事會多元化及獨立性

### 3.1 董事會多元化：本公司董事會成員多元化政策如下：

本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

本公司設置董事九席，其中三席為獨立董事，董事會每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、領導決策、產業知識、技術研發、財務會計、行銷業務等。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之四項。本公司目前董事會與個別董事成員均達成多元化政策之管理目標。

本公司董事會目前設置一位女性董事，未來將持續積極覓尋合適的女性董事成員名單，拓展董事會的多元性。

本公司個別董事成員資料及具備之能力請參閱第 12~13、16 頁及第 61 頁附註 1。

### 3.2 董事會獨立性：本公司設置獨立董事 3 人，佔董事會 1/3。

本公司董事會符合下列獨立性條件：

- (1) 董事非為本公司及其子公司高階管理人員之家庭成員
- (2) 董事非為本公司或本公司高階管理人員之顧問及其關係人。
- (3) 董事非為本公司重要供應商之關係人。
- (4) 董事未與本公司或本公司高階管理人員有個人服務合約。
- (5) 董事非為收受本公司重大捐贈之非營利組織關係人。
- (6) 董事於過去 3 年非為本公司外部審計會計師或人員。
- (7) 董事無董事會認為其不能被視為獨立之其他利益衝突。
- (8) 董事會符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。
- (9) 獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項規定。

#### 四、資本及股份

##### (一) 股本形成過程

##### 1.最近五年度及截至公開說明書刊印日止，股本變動之情形

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(千股)	金額(千元)	股數(千股)	金額(千元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	核准日期與文號
106年09月	10	890,000	8,900,000	506,506	5,065,062	員工酬勞轉增資	無	106/09/25 竹商字第 1060026285 號
107年04月	10	890,000	8,900,000	508,095	5,080,955	員工酬勞轉增資	無	107/04/11 竹商字第 1070010727 號
109年04月	10	890,000	8,900,000	510,685	5,106,849	員工酬勞轉增資	無	109/04/20 竹商字第 1090010606 號
111年04月	10	890,000	8,900,000	512,864	5,128,636	員工酬勞轉增資	無	111/04/13 竹商字第 1110011158 號

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	512,863,641 股	377,136,359 股	890,000,000 股	核定股本其中保留 80,000,000 股供發行員工認股權憑證股份數額。

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

3.公司採總括申報方式發行新股者，應揭露預定發行總額、已發行總額及總括申報餘額等相關資訊：無。

## (二) 最近股權分散情形

### 1. 主要股東名單

114年3月30日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	30,382,000	5.92%
國泰世華商業銀行受託保管元大寶來台灣高股息證券投資信託基金專戶	25,846,021	5.04%
闊德工業股份有限公司	22,146,604	4.32%
新制勞工退休基金	10,839,148	2.11%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	8,724,121	1.70%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	6,988,000	1.36%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	6,740,988	1.31%
江廷桔	6,569,949	1.28%
倪淑卿	6,308,389	1.23%
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶	6,095,000	1.19%

2. 最近二年度及當年度董事及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：無。

(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股/新台幣元

項 目		年 度			
		112 年	113 年	當年度截至 114 年 3 月 31 日	
每股 市價	最 高	492	620	507	
	最 低	280	433.50	585	
	平 均	397.49	518.91	547.09	
每股 淨值	分 配 前	82.34	103.24	88.45	
	分 配 後	66.84	77.74	—	
每股 盈餘	加權平均股數	512,863	512,863	512,863	
	每股盈餘	17.85	29.82	9.28	
每股 股利 (註 4)	現金股利	15	25.5	—	
	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利	—	—	—	
投資 報酬 分析	本益比(註 1)	22.27	17.40	—	
	本利比(註 2)	26.50	20.35	—	
	現金股利殖利率(註 3)	3.77%	4.91%	—	

註 1：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 2：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 3：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 4：113 年與 112 年每股股利係分別指 113 年分配 112 年股利與 112 年分配 111 年股利。現金股利不包含資本公積配發現金。

(四) 員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞最高百分之三，員工酬勞不低於百分之一，員工酬勞中應提撥不低於年度盈餘之百分之零點五為基層員工分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補累積虧損數額，再依前項比例提撥董事酬勞、員工酬勞及為基層員工分派酬勞。

前項員工酬勞之分派以現金或股票方式發放，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。董事酬勞及員工酬勞分派案應提股東會報告。

員工酬勞分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會或其授權之人訂定之。

2、本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司依據公司章程估列員工、董事酬勞，以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎為董事會決議日前一日收盤價。實際分派金額若與估列數有差異時，依據會計估計變動處理，

將列為次年度之損益調整數。

### 3、董事會通過分派酬勞情形

(1)114年2月27日董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派

單位：新台幣元；股

員工酬勞				董事酬勞	差異處理	
現金金額	股票金額	股票股數	合計金額	現金金額	差異金額	處理情形
4,497,482,930	0	0	4,497,482,930	100,000,000	無差異	不適用

註：員工酬勞及董事酬勞金額與113年度估列費用一致。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：113年度員工酬勞皆以現金方式發放，故不適用。

### 4、股東會報告分派酬勞情形及結果

於民國114年5月28日股東會報告以下事項

(1)依本公司章程第十八條規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞最高百分之三，員工酬勞不低於百分之一。

(2)本公司董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派：

單位：新台幣元

項目	金額	佔獲利比例
員工酬勞	4,497,482,930	22.05%
董事酬勞	100,000,000	0.49%

註：員工酬勞及董事酬勞金額與113年度估列費用一致。

(3)上述員工酬勞及董事酬勞皆以現金方式發放。

### 5、前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

單位：新台幣元；股

員工酬勞				董事酬勞	差異處理	
現金金額	股票金額	股票股數	合計金額	現金金額	差異金額	處理情形
2,696,047,171	0	0	2,696,047,171	90,000,000	無差異	不適用

註：員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與112年度估列費用一致。

## 貳、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一) 業務內容

##### 1. 業務範圍

###### (1) 公司所營業務主要內容

- A. 研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路
- B. 提供各種積體電路產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務
- C. 各種矽智財之研究開發及銷售
- D. 兼營與本公司業務有關之貿易業務

###### (2) 營業比重

單位：新台幣千元

113 年度	積體電路產品	其他	合計
營業收入淨額	113,082,609	311,089	113,393,698
營業比重(%)	99.73%	0.27%	100%

###### (3) 公司目前商品項目

###### 通訊網路暨聯網多媒體產品：

- 乙太網路控制器系列
- 乙太網路實體層收發器系列
- USB 存儲橋接晶片系列
- 超高清 HDR 多媒體機上盒晶片系列
- 車用乙太網路實體層收發器系列
- 車用乙太網路高度整合型交換器系列
- 整合型無線區域網路(WLAN)暨藍牙控制晶片系列
- 無線區域網路雙頻存取點/路由器整合型系統晶片系列
- 物聯網多功能單晶片系列
- 智慧家庭中控單晶片
- 物聯網 AI 無線網路攝影機單晶片系列
- 藍牙 5.3 低功耗單模單晶片
- 藍牙 5.3 音訊單晶片
- 藍牙助聽器單晶片方案
- Matter over Thread 單晶片方案
- GNSS 衛星定位單晶片系列
- 多埠乙太網路實體層晶片組系列
- 多埠乙太網路交換器晶片組系列
- 多埠乙太網路管理型交換器晶片組系列
- 高整合被動式光纖網路晶片組系列
- 多埠乙太網路供電設備控制晶片系列
- VDSL 35B 網路路由器控制晶片系列

###### 電腦週邊暨智慧互聯產品：

- HD-A 音訊編碼解碼晶片系列
- 高電壓音訊功率放大器晶片系列
- SoundWire 音訊編碼解碼晶片系列
- SoundWire 音訊功率放大器晶片系列
- USB 2.0 音訊編碼解碼晶片系列
- 車用音訊數位訊號處理器單晶片系列
- 遊戲機手把用高傳真音效數位訊號處理器單晶片系列
- 遊戲機用高傳真音訊編解碼晶片系列
- 行動裝置用高傳真音訊編解碼系列
- 行動裝置用高傳真音效數位訊號處理器單晶片系列
- 行動裝置用升壓及喇叭保護音訊放大器晶片系列
- USB 2.0/USB 3.0 介面之高畫質影像數位信號處理晶片系列
- 具邊緣 AI 運算 I2C 介面機器視覺控制晶片
- 第二代 USB 2.0 指紋辨識 MoC (Match on Chip) 控制加密晶片系列
- 高整合度 5 百萬畫素邊緣運算網路攝影機單晶片系列
- USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 集線器晶片系列
- USB4 集線器控制晶片系列
- USB Type-C 與電源傳輸(PD)控制晶片系列
- USB 3.2 Gen 2 與 DP 2.1 Redriver 晶片系列
- 高整合度低功耗嵌入式系統控制晶片系列
- I3C 集線器控制器晶片系列

#### **多媒體產品：**

- 整合型液晶顯示控制晶片系列
- 高解析度整合型電競液晶顯示控制晶片系列
- DisplayPort 轉換晶片系列
- DisplayPort MST 集線器控制晶片系列
- DP 2.1/HDMI 2.1 具 OSD 功能集線器控制晶片系列
- HDMI Retimer 晶片系列
- 高端智慧連網電視系統單晶片系列
- 智慧顯示系統單晶片系列
- 8K 影像解碼與處理晶片系列
- 超解析度成像畫質提升系統單晶片系列

#### **(4)計畫開發之新產品**

##### **通訊網路暨聯網多媒體產品：**

- 規格升級乙太網路控制器系列
- 規格升級乙太網路實體層收發器系列
- 規格升級存儲橋接晶片系列
- 管理型 USB 網路介面卡
- 100G 轉阻放大器與垂直共振腔面射型雷射驅動器
- 800G PAM4 數位訊號處理器

- 多界面橋接晶片
- 規格升級超高清 HDR 多媒體機上盒晶片系列
- 車用高速乙太網路安全實體層收發器系列
- 高埠數高整合型車用乙太網路安全交換器晶片系列
- 車用高速 MIPI 非對稱實體層橋接收發器系列
- 規格升級多埠乙太網路實體層晶片組系列
- 規格升級多埠乙太網路交換器晶片組系列
- 規格升級多埠乙太網路管理型交換器晶片組系列
- 規格升級多埠乙太網供電設備(PSE)晶片組系列
- 規格升級高埠數光纖上行高帶寬乙太網路管理型交換器控制晶片系列
- 規格升級高整合被動式光纖網路晶片組系列
- 規格升級 PON 激光驅動器晶片系列
- 規格升級整合型多鏈路無線區域網路(WLAN)暨藍牙晶片系列
- 規格升級物聯網智慧多功能系統單晶片系列
- 規格升級高整合度物聯網 AI 無線網路攝影機單晶片系列
- 規格升級高整合型無線區域網路雙頻存取點/路由器系統單晶片系列
- 規格升級藍牙 5.4 音訊單晶片系列
- 規格升級藍牙 5.4 低功耗物聯網單晶片系列
- 規格升級 BLE/Matter over Thread 多模式單晶片系列

#### 電腦週邊暨智慧互聯產品：

- SoundWire 音訊編碼解碼晶片系列
- 支援類神經網路運算之語音數位訊號處理器單晶片系列
- 高電壓音訊功率放大器晶片系列
- 車用音訊編碼解碼晶片系列
- 車用音訊功率放大器晶片系列
- 高傳真音訊晶片系列
- 行動電腦裝置用 SoundWire 介面高傳真音訊編解碼暨功率放大器單晶片系列
- 行動裝置用升壓及喇叭保護音訊放大器晶片系列
- 行動裝置與穿戴式裝置用震動及觸感回饋驅動晶片系列
- 筆記型電腦用新 eUSB2 (embedded USB2)介面高畫質影像數位信號處理晶片系列
- 第三代 USB 2.0 指紋辨識 MOC (Matching on Chip)控制加密晶片系列
- 新一代高畫素邊緣運算網路攝影機單晶片系列
- 規格升級高整合度 USB 3.2 Gen 2 多埠集線器晶片系列
- USB 3.2, DP2.1 and USB4 Redriver 晶片系列
- Type-C 電源傳輸 (PD) 控制晶片系列支援 EPR (Enhanced Power Range) 規格
- eUSB2 Repeater 控制晶片系列
- 規格升級高整合度低功耗嵌入式系統控制晶片系列
- 規格升級 I3C 集線器控制器/橋接晶片系列

#### 多媒體產品：

- 規格升級整合型液晶顯示控制晶片系列

- 規格升級 DisplayPort 轉換晶片系列
- 規格升級 DisplayPort MST 集線器控制晶片系列
- 規格升級視訊解碼液晶電視系統單晶片系列
- 規格升級支持串流媒體影像編解碼和顯示的 SoC 系列
- 規格升級支持 AI 影像及聲音處理的電視系統單晶片

## 2. 產業概況

### (1) 產業之現況與發展及產品之發展與競爭情形

民國 113 年作為疫情後的第一個完整年度，半導體產業的動能顯著恢復。這一復興主要得益於生成式人工智能的快速發展，該技術需要大量的計算能力和記憶體容量，這些都依賴於半導體解決方案。雖然瑞昱並不專注於高性能計算或高頻寬記憶體，但公司在人工智能領域的參與度積極提升。在民國 113 年，越來越多的瑞昱解決方案在各種形式中整合了嵌入式 AI 加速器，提升了音訊、視訊和連接的功能及性能。此外，瑞昱也在日常運營中擴展了 AI 的應用，從協助產品開發到提高業務流程效率。我們預計這一積極趨勢將延續到民國 114 年，使我們對來年的穩定增長充滿信心。

#### **通訊網路暨聯網多媒體產品：**

在民國 113 年，瑞昱不僅透過不斷的產品改進和升級來鞏固其市場領導地位，還積極投入開發新產品，以應對未來挑戰。隨著 AI、5G 和物聯網技術的迅速普及，公司正專注於推動光通訊產品的創新。瑞昱致力於為未來更高速的數據傳輸環境提供全面的規劃和佈局。這一策略不僅展現了公司對市場趨勢的敏感度，也顯示了其對技術創新和前瞻性規劃的承諾。

在乙太網路方面，綜觀民國 113 年的個人電腦(PC)市場，庫存已逐步去化完畢，年中開始已出現庫存回補。瑞昱在乙太網路方面深根多年，在筆記型電腦、主機板、網路存儲裝置(NAS)、遊戲機、介面擴充基座 (Docking Station)、USB 轉 Ethernet 轉接器、交換器、以及家庭路由器和智慧家庭市場等都有所耕耘。在民國 113 年，受惠於主機板網路速度規格升級的趨勢，初階主機板搭載 2.5GbE、中階產品搭載 5GbE 網卡的比例逐年攀升，帶動 2.5GbE 及 5GbE 高階網卡的銷售；此外，許多網路設備都在積極規劃往 Multi-G Ethernet 邁進，市場轉往更高速的網路應用趨勢愈加明顯。瑞昱的 2.5GbE 產品方案具有優異的規格，加上已經量產多年，產品相當成熟，在這快速成長的市場中，將持續擴大瑞昱的影響力與市佔率。瑞昱 10GbE Single Port PHY 在民國 113 年開始出貨，快速成長，深受寬頻網通和交換機市場肯定。

隨著資訊時代對大數據處理需求的迅速增長，SSD 憑藉其高速讀寫效能、輕巧便攜的特性，已逐步取代傳統硬碟，成為市場主流產品。其價格已趨於親民化，進一步促進了消費者的廣泛採用。瑞昱率先推出全球領先技術，支援 USB 10Gbps 及 20Gbps 介面，並具備自動偵測 PCIe/NVMe 與 SATA/AHCI 雙協議的能力，成功切入高階 SSD 存儲市場，彰顯其技術創新與市場競爭力。在高階影音系統、醫

療設備、邊緣運算設備及快速崛起的影音創作者市場，隨著 4K 甚至 8K 超高畫質內容需求的爆發，對記憶卡讀寫速度的要求越發嚴苛。為因應市場趨勢，除了先前已推出的 USB 20Gbps 轉 SD Express 橋接控制器解決方案，在民國 113 年底進一步推出首款 9 個 SATA 埠的 PCIe 轉接控制器，全面瞄準小型 NAS 儲存設備及監控 NVR 應用場景，致力於滿足外接及單機儲存市場的多元需求。瑞昱計劃於 114 年度推出更多創新產品，進一步推動讀卡機市場的發展，在商業存儲應用領域，更持續深耕技術創新。未來，瑞昱將持續深化核心技術，維持介面擴充方案領導品牌地位。

近年 OTT 服務百花齊放並已達全球化規模。傳統衛星、地面廣播等非 IP-based 電視服務運營商亦將其影視內容與服務 IP 化，加強 IP-based 電視服務運營 (IPTV 或 OTT)。大型運營商亦加強寬頻網路服務來因應此一趨勢。此外，FAST (Free Ad-supported Streaming Television) 服務興起，各大運營商以及各大機上盒平台莫不加速相關開發，豐富了消費者的影視選擇，也使廣告收益成為平台獲利動能。開放平台亦憑藉著應用程式商店 (App Store) 的支援以及對付費應用 (Premium App) 更好的整合架構吸引運營商揚棄過去封閉系統而改採用開放平台。Google 推出 Android TV，RDK 聯盟推出 RDK-V 平台，已成功吸引大運營商導入。同時 Netflix 也針對運營商市場推出 Netflix Scaling Program，加速運營商推出結合網路視頻且能支援 Netflix 的混合式 (Hybrid) OTT 及 IPTV 機上盒。消費者收視習慣的改變以及對內容品質的持續提升，讓運營商需要面對日益升高的安全挑戰，加上量子電腦攻擊隱憂浮現，機上盒平台開始展開對應安全性升級計畫。為因應市場快速成熟、產品趨向高效能低價格，瑞昱持續開發新一代超高清多媒體控制晶片的機上盒解決方案，整合各運營商所需之新一代安全性方案。此外，除了整合新一代高動態範圍 (High Dynamic Range) 以及 3D 沉浸式音訊技術，瑞昱更持續開發新一代影音編解碼技術來因應解析度提升同時降低網路頻寬需求，並能有效支援 Edge AI 及更多先進功能，且能與智慧家庭產品互動。除了能匯集 IoT 產品訊息，並能進行視訊、遠場語音。近期配合 Matter 規格制訂與普及，機上盒開始整合 Thread，讓機上盒逐漸成為智慧家庭中心。瑞昱以完整並具備成本競爭力以及低功耗的軟硬體參考設計，協助客戶開發高效能機上盒產品掌握商機，並結合多媒體加網路的完整解決方案，在未來的市場競爭中，擁有對手不易複製的優勢。

在乙太網路交換器晶片方面，瑞昱在嵌入式應用如家用開道器、Wi-Fi 路由器與 VoIP 電話、非網管型交換器 (Unmanaged Switch) 以及智慧型交換器 (Smart Switch) 市場都已取得市場領先地位。近年來在網管型交換器 (Managed Switch) 市場，市佔率亦逐年攀升，民國 113 年受全球景氣影響，上半年度進入庫存盤整階段，至下半年度客戶陸續去化庫存，逐漸恢復買氣，同時開始投入新世代產品開發，預計於 114 年陸續帶動業績。

乙太網供電設備 (PSE) 晶片產品隨著網管型交換器陸續成功打入各大客戶供應鏈，並隨著客戶在民國 113 年將之前庫存去化完畢，加上新一代產品問世，出貨穩健成長，市場占有率提高。2.5GbE 交換器部分，隨著 Wi-Fi 7 逐漸成長且其無線連網速度越來越快，市場感受到對 2.5GbE 交換器需求倍增。瑞昱在民國 112 年推出的 5 埠及 8 埠 2.5GbE 交換器晶片，已成功導入數個重要策略客戶並順利量

產，出貨量與營收皆逐月增加，尤其以 2\*2.5GbE+2\*GbE 為首的解決方案，非常適合用於升級 Wi-Fi 7 路由器的有線頻寬。113 年特別再針對 Wi-Fi 7 AP router、5 G FWA、Cable Modem 與 10G-PON 等家用路由器/開道器規劃 2 埠 2.5GbE 交換器晶片，具備更優化的功耗與更具競爭力的價格，相信可以更貼近 GbE (Gigabit Ethernet) 的市場，預期將可加速對於 2.5GbE 的滲透率並加大 2.5GbE 的市占率。管理型交換器產品線部分，瑞昱 10GbE Single Port PHY 獲得世界各電信廠商肯定，民國 113 年開始陸續出貨。同時，中高階管理型交換器產品持續累積諸多重要指標型客戶，除主要面向 GbE 市場區間的穩定需求之外，(24\*1GBASE-T+4\*10GBASE-T、48\*1GBASE-T+6\*10GBASE-T)、Multi-GbE (Multi-Gigabit Ethernet) 市場區間也開始發酵邁向成長期，且主打園區網路 (Campus Network) 市場的重要策略客戶也於 113 年開始陸續進入量產，預期網管型交換器業績能夠持續成長。此外，為因應客戶需求及市場競爭，瑞昱在民國 113 年推出高階園區網路匯聚等級 24/48\*10GBASE-T 交換機晶片方案，搭配自家 10G PHY，形成 Total Solution，並已獲電信設備大廠採用，可望為民國 114 年業績帶來新一波成長。

過去 5 年，家庭用戶對於網路頻寬需求增加，全球運營商加速光纖網路佈建與升級，瑞昱目前在 10G-PON (包括 XG-PON 及 XGS-PON)、2.5G PON、1G EPON 以及光器件的 Laser driver 等產品有相當完整的佈局。產品形態包括配置 4 埠 1GBASE-T、1 埠 GBASE-T+3 埠 100BASE-T、1 埠 1GBASE-T 乙太網路端口的家庭網關單元 (Home Gateway Unit，簡稱 HGU) 以及單戶單元 (Single Family Unit，簡稱 SFU) 各式產品方案，可滿足全球新標案的需求。同時，瑞昱於民國 113 年領先業界提供了 25G PON 單戶單元的解決方案，符合 25GS-PON 多源協議 (25 Gigabit Symmetric Passive Optical Network Multi-Source Agreement) 規範，適用於超高頻寬的企業、住宅和手機基地台回程鏈結等應用。目前已與多家運營商合作，規劃前所未有的 25Gbps 光纖接入速率的試營運計劃。

中國目前仍是全球光纖 (Optical Fiber) 需求量最大的地區，瑞昱在中國市場多年積極經營下已取得相當市場份額。後疫情時代，雖然中國經濟大環境趨緩，技術演進並未停歇，中國運營商將光纖網路導入 FTTR (Fiber To The Room) 新應用，進一步加速光纖產品的規模經濟以及價格親民化；另一方面，規格升級動能持續，XG-PON 家庭網關單元的招標數量持續增量，預計在民國 115 年的出貨量將會超越 2.5G PON 產品。

歐、美、中、日、韓等車廠當今都已經將車用乙太網路 (Automotive Ethernet) 做為車載網路骨幹，並應用於連接車內的安全感測器、360 度攝影機系統、車載資訊娛樂系統 (Infotainment Head Unit)、儀表板與先進駕駛輔助系統 (ADAS)。民國 113 年開始，車用乙太網路架構逐步由 Domain 轉型成 Zonal 架構。Zonal 架構的導入將明顯提高每台車乙太網技術的使用量。瑞昱車用乙太網產品已經被 IOP 認證實驗室定為互用性測試 (Interoperability Test) 的黃金樣本 (Golden Sample)，並已取得多家車廠的認證及一級供應商 (Tier 1) 的採用，且已量產出貨。瑞昱繼續憑藉技術優勢再次領先全球，陸續推出車用乙太網路產品，如第二代整合 100/1000BASE-T1 雙模的高埠數交換器晶片 (Switch) 已經獲得歐美中車廠的大量採用。第二代支援 100/1000BASE-T1 雙模 MACsec 的 PHY，陸續被歐美車廠及一

級供應商採用，導入新一代毫米波雷達的需求。第三代交換器晶片符合未來 UNECE 法規要求安全等級，同時滿足各式各樣的封包存取控制 (Packet Access Control) 偵測。第四代交換器即將推出，定位在高階自駕及閘道器 (Gateway) 的應用。未來，隨著自駕規格以及 AI 算力的提升，將帶動新一波的毫米波雷達升級，預計雙模 MACsec PHY 將會有更高市場滲透率。另外，瑞昱於民國 113 年推出 2.5GBASE-T1 的車用 IC，符合未來 5~8 年車用超高速乙太網需求，是個具有高度競爭力的產品。同時，與車廠合力推動的 10BASE-T1 技術規範也已經配置於新一代的多埠交換器單晶片。自民國 112 年開始，中國汽車產業迎來了一波內捲的競爭態勢，我們深耕中國多年，於中國前十大車廠均有合作。除了延續高規格產品的開發以外，也將開發入門款的交換器晶片以及車用高速 MIPI 非對稱實體層橋接收發器系列，將進一步被廣泛推廣成業界標準並適用於汽車攝影鏡頭數據橋接上的應用場景，以符合更多客人的產品需求。

在 Wi-Fi 產品方面，民國 113 年 PC 市場上，Wi-Fi 6 產品已成為市場的主流。而最新規格的 Wi-Fi 7 產品，也開始看到 OEM 客戶於高階機種採用出貨。同時，AI PC 的推出，在其高規格、高單價的產品定位下，也以 Wi-Fi 6E 或是 Wi-Fi 7 作為產品上 Wi-Fi 使用的規格。

除了 Wi-Fi 規格提升之外，藍牙技術目前也進展到 BT 5.4。於 PC 上的應用，在微軟作業系統開始支援 LE Audio 的推動下，各 OEM 客戶也要求 Wi-Fi/BT combo 晶片要能支援此 LE Audio 功能。我司方案在 Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E 上已陸續將此功能啟用。

Wi-Fi 在電視與機上盒市場方面，在後疫情時代，客戶在高端電視區塊尋求有價格競爭力之高規格 Wi-Fi，以支持高 CP 值終端產品的型式來刺激消費，低端電視 Wi-Fi 規格亦受應用需求的影響，被迫升級。藉由客戶優化產品組合來提升終端產品訂價，也符合瑞昱持續引導客戶往高性價比規格移動策略，以在市場競爭過程中，構築技術障礙。

無線監控設備 (IP CAM) 結合 AI 和 IoT 技術使得應用更加多樣化，仍是推動市場成長的動力。雖然市場穩定成長，但因傳送碼流量需求不高，且消費性無線監控設備的主要市場仍是集中在新興開發中國家，因此對於價格的敏感度高。因此，瑞昱目前積極規劃下世代的產品，並結合新的 Wi-Fi 技術，以取得市場的主導權。

在無線路由器產品方面，瑞昱的 Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 產品，持續以優異的性價比激發出新的市場需求，為產品創造新的成長動能。尤其在後疫情時代，生活習慣的改變，工作型態轉換成在家工作 (WFH) 的比例增加，為提升工作效率，消費者對於居家環境使用路由器的要求提高，同步推升無線訊號延展器/智能組網 (Extender / MESH AP) 的需求，瑞昱除了持續推廣 Wi-Fi 6 路由方案至更多的地區與國家外，也於民國 113 年第三季相繼推出 Wi-Fi 7 BE3600/BE6400 及 BE7200 等高階方案，為客戶提供更完整、更齊全的路由器產品解決方案。

瑞昱耕耘物聯網產品線多年，解決方案從智能操控，到增加語音和即時影像應用等，接下來會結合更多的人體、空間的感測技術以及搭配雲端生成式 AI，提供給消費者更好用的終端應用。瑞昱擁有完整的物聯網產品系列，具備高整合度、超低功耗、高安全性特點，每年積極投入研發資源來開發出新一代 Wi-Fi、藍牙技術，並增加 AI 應用，同時也符合物聯網最新的聯盟標準。除了智慧家居市場獲全球一線品牌客戶青睞，在綠能應用上，今年也積極搶入，另外，工業及醫療也積極佈局，期待讓各行業導入 AI 化 IoT，並讓使用者得到更好的使用體驗。此外，瑞昱持續與物聯網相關組織和主導者進行合作，瑞昱也是物聯網標準「Matter」的主要合作夥伴，已正式發布多款方案，與主要客戶同步發布終端產品，預計在民國 114 年可以看到更多的產品發布，建構更完整的智慧家居環境。

藍牙廣泛內建於手機、電視、機上盒、智能音箱等產品端，協助個人與家庭成員經由藍牙無線連接，享受藍牙耳機、運動手環、藍牙語音遙控器及藍牙 Mesh 周邊帶來更便利的娛樂享受及更人性化的人機互動和更簡易快速的反饋。

藍牙新規格 LE Audio 的問世提供更多音訊應用的新場景，同時將帶動更多類型的藍牙音訊產品發展。LE Audio 具備低延遲性能，可滿足多聲道條形音箱 (Soundbar)、遊戲耳機等高品質接收端的需求。Auracast 廣播音訊格式，能夠將一個或多個音訊串流廣播到不限數量的音訊接收設備 (如耳機、揚聲器、助聽器等)，滿足公共場合或小範圍音訊無線分享的場景，如市場上首個使用瑞昱方案上市的 Auracast 導遊機。而在支援 LE Audio 的主設備尚未普及之時，瑞昱也推出雙模式 Dongle 做為藍牙經典音訊和 LE Audio 之間的橋樑，可用於電腦、電視機上盒等音源裝置。並推出首款 Audio-mix 雙模音訊混合的遊戲耳機，滿足玩家越來越豐富的互動場景。瑞昱持續扮演藍牙音訊方案的重要推手，攜手供應鏈及品牌業者提供消費者更佳的語音體驗，滿足市場對於藍牙耳機新功能進化的期待，並推升市場成長，共創多贏。此外基於藍牙音訊平台及瑞昱的低功耗 Wi-Fi ISP (影像處理) 單晶片搭配所推出的智能眼鏡方案，可進一步將藍牙擴充到新一代智能穿戴設備以滿足市場使用雲端 AI 功能新需求，藉由帶來更多便利性及新體驗來持續提高瑞昱藍牙市場滲透率。

瑞昱低功耗藍牙 (BLE) 系列除支持藍牙最新規格 (BT 5.3/BT 5.4) 外，持續致力開發高算力、超低功耗等高低組合方案，並確保方案具備成本優勢及相容性以滿足市場需求。藍牙語音遙控器持續受到海內外知名家電品牌肯定。高性能產品系列延續藍牙穿戴產品在螢幕、通話等豐富的產品方案經驗，將藍牙+MCU+螢幕驅動的單晶片方案推向電動機車儀表，並結合耳機產品推出市場第一個彩屏耳機充電盒方案。BLE 低功耗產品系列亦推出 Apple/Google Find My 個人藍牙物品「尋找」方案；針對遊戲鍵盤滑鼠等應用推出支持高上報率的有線、無線及 BLE 三模式 HID 單晶片方案，開始進軍電腦遊戲周邊設備。此外針對電子貨架標籤 (ESL) 也推出低功耗對應方案，迎接因應綠能環保的新領域應用。瑞昱藍牙產品不僅應用在個人娛樂及智能家居，也已進入工業及車載娛樂應用領域，提供客戶多層面跨領域更多元的使用範疇。

**電腦週邊暨智慧互聯產品：**

民國 113 年 PC 市場表現穩定，品牌廠商原本期待的商用換機潮並不明顯，出貨主力仍以低價機種為主。展望後市，品牌廠商看好 AI PC 將成為未來幾年驅動 PC 升級換代的主要推手，因此積極且廣泛地發想及實驗各種概念機 (Proof of Concept)，探索 AI PC 能提升的用戶體驗。在這個充滿機會與挑戰的時刻，瑞昱持續精進自身關鍵技術及積極結合客戶需求開發新產品，以迎接 AI 新契機的到來。

瑞昱音訊產品線除了繼續精進這兩年頗獲市場肯定的類神經網路運算 AI Audio 降噪演算法，瑞昱再推出 AI 波束成型 (AI Beamforming)、AI 回聲消除 (AI Echo Cancellation) 與 AI 殘響消除 (AI Reverb Remover)，並增加了目標語者辨識 (Target Speaker Enhancement) 與聽力保護及聽力補償 (Hearing Protection & Hearing Compensation) 技術。除了全面提升 PC、會議型裝置與直播設備的使用體驗，更兼顧了隱私、安全與健康，讓 AI 算法的應用場域由線上會議擴展至內容創作者 (直播)，再擴展至生成式 AI 應用。而因應 PC 音訊介面 (audio interface) 未來的規格轉換，瑞昱早已積極參與前期規格制訂，搭配完整規劃的全產品線組合，以及瑞昱最引以為傲的從演算法、硬件、軟件及到場技術支持 (on-site support) 的完整方案 (Total Solution)，必定幫助業界與客戶順利銜接下個世代的規格轉換。

在影像產品方面，PC 用戶歷經疫情的洗禮，已經習慣打開攝影機參與遠距會議，故良好的通話品質以及清晰的影像品質成為用戶選購 PC 時的重點評比規格。因應此一消費習慣改變，PC 品牌客戶於民國 113 將其商務及高階消費筆電之攝影機規格大量從原本 HD (720p) 提升至 FHD (1080p) 或 5MP 解析度，以提升影像清晰度及對應畫質。在影像品質提升部分，瑞昱於民國 112 年領先業界推出視訊高動態 VHDR (Video High Dynamic Range) 方案，克服使用者在強背光環境使用攝影機時產生人臉黑影現象，大幅提升在戶外或窗前視訊時的影像品質。該規格推出後廣受 PC 品牌客戶好評及採用，已成為民國 113~114 年中高階筆電的另一項影像品質提升的重點項目。

除此之外，AI PC 在民國 113 年正式被定義並導入量產，AI 相關應用成為 PC 產業的最主要亮點。瑞昱身為 PC Camera 領導廠商，領先業界推出 PC 影像處理引擎 (Image Signal Processor) 整合邊緣 AI 運算處理器 (Edge AI) 的單晶片方案，榮獲 2023 年台北國際電腦展 (Computex) 最佳選擇金質獎 (Best Choice Golden Award) 殊榮。接著於民國 113 年底推出第二代內建更低功耗、更強算力的 Edge AI 引擎單晶片方案，獲得 2024 美國消費性電子展 (Consumer Electronic Show, CES) Innovation Award 創新獎項。瑞昱所推出的高整合型邊緣 AI 運算方案，以省電及智能偵測的人機互動優勢，獲得 PC 一線品牌客戶肯定，已在商用及消費高階機種陸續導入。目前已規劃第三代 Edge AI 單晶片方案結合更新一代的影像技術，將於民國 114 問世，持續樹立技術及市場領先標竿。

在指紋辨識產品方面，瑞昱在民國 113 年配合微軟推廣計劃，推出更省電且內建硬體算法加速器的第四代 MoC (Matching on Chip) 指紋 MCU 產品，並支援防偽/防假手指 (Anti-Spoofing) 功能，以優異性能及高整合度切入 PC 中高階指紋辨識市場。民國 114~115 年隨著微軟對桌上型 AI PC 的規格要求，需搭配符合微軟

ESS (Enhanced Sign-in Security) 加密生物辨識裝置的新規格，因此，將藉機切入桌上型主機週邊設備 (滑鼠/鍵盤) 加指紋認證的應用。

在監控攝影機單晶片產品方面，由於民國 112 下半年至 113 年中國內需市場較為低迷，加上中美關係等地緣政治等因素，瑞昱已逐步將目標市場轉往中國以外的地區並跟特定品牌合作差異化的加值應用。民國 113 年瑞昱海外市場深耕陸續獲得客戶認可，並有具知名度的品牌客戶陸續導入瑞昱的網路攝影機單晶片，且穩定量產中。

在消費性電子裝置音訊晶片市場方面，瑞昱獨特的低功耗晶片設計及軟硬體結合的省電方案，可有效延長電池使用時間，加上高效能音訊編碼解碼，內建適配性升壓電路，整合帶喇叭保護功能及等化器之 D 類功率放大器等高整合度解決方案，更可替客戶節省外部元件，有效縮小主板面積。在智慧型手機和遊戲機市場上，瑞昱低功耗音訊編解碼晶片 (Audio Codec)、智慧功率放大器 (Smart Amplifier)、可編程語音/音訊數位訊號處理器單晶片 (Programmable Audio DSP)，皆已導入一線品牌大廠，並獲得相當高的評價。近年也結合策略合作夥伴的方案，朝虛擬實境 (VR) 及車用語音市場布局，也陸續取得成果。

在讀卡器 (Card Reader) 晶片方面，瑞昱因應筆記型電腦及桌上型電腦的需求，推出 PCI Express 及 USB3.2 介面多功能整合型 Card Reader 產品，整合記憶卡 Card Reader、智慧晶片卡 (Smart Card) Card Reader，並領先業界推出支援最新 SD 記憶卡 SD 7.1 與 SD 8.0 規格及同時支援 Intel 最新省電規範的產品。憑藉獲得多個專利的架構，瑞昱 SD 7.1 與 SD 8.0 讀卡機晶片可在不影響功能的前提下大幅縮小晶片面積，有效提升產品成本與競爭力，除持續保持市佔率領先外，也期許為客戶創造新的產品應用價值。

因應支援 USB 3.2 的產品日益普及，需求持續成長，瑞昱 4 埠 USB 3.2 集線器 (Hub) 產品已獲得多家系統廠商的採用，出貨量逐月放大。瑞昱領先業界開發 USB 3.2 Gen 2 集線器，除傳輸速度快與低功耗外，更整合 USB Type-C 與 PD 3.2 功能，提供客戶更高規格及更為精巧的產品設計彈性。為拓展應用市場，民國 114 年推出整合 Type-C 與 PD 3.2 功能的 7 埠 USB 3.2 集線器單晶片，除了擴展到 7 個下行口外，上行口也擴充成 2 個，整合 Bridge 功能，讓連接 2 個 Host 的主機可以透過內建的 Bridge 電路相互交換檔案與滑鼠座標資訊。另外投入大量資源開發的 USB4 集線器控制晶片，完全符合 USB4 規範，更集成 Type-C、PD 3.1、DP 2.1 Tx、DP 2.1 Rx、USB 3.2 Gen 2x2 Hub、USB 2.0 Hub、xHCI、PCIe switch、security engine 等重要 IP，可以讓客戶以最精簡的成本與最快的效率開發符合 USB4、Thunderbolt 4、Type-C、PD 3.2、USB 3.2、USB 2、DP 2.1 等規格的終端產品，是當前業界整合度最高最具競爭力的 USB4 Hub 產品。

因應 USB Type-C 與 Power Delivery 的規格推出，瑞昱同步推出高整合度的產品。除可節省整體設計的成本，更使產品精巧化，已獲得多家不同應用市場的大廠採用。未來將持續開發出更新規格的產品，奠定瑞昱 Type-C 與 PD 控制晶片在各 PC 大廠的堅實基礎。此外瑞昱 PD controller 也獲得 Intel、AMD、Google 等大廠

的 PCL/AVL，可大幅提升客戶採用的信心度。產品線也結合客戶新的需求陸續開發出相對應的產品，包含整合 power switch 相關 IP 技術以推出 PD3.2 EPR28V 與 EPR48V 相關新產品，可幫助客戶再精簡成本以進一步擴大市場市佔。

隨著 USB 3.2 與 DP 2.1 規格的日漸普及與速度提升，Redriver 的需求日益增加，瑞昱同步推出可支持 USB 3.2 Gen 2x2 與 DP 2.1 的 Redriver 產品。除了製程選擇上的優勢以外，也藉由 Type-C 與 Power Delivery IP 整合型 Redriver 晶片，幫助客戶節省成本以快速搶佔 PC、Monitor 與各電腦周邊產品的市場。另外也開始佈局 USB4 Version 2.0 redriver 新規格的晶片，可滿足高速與高頻寬的應用需求。因應高階製程對 IO 電壓的限制，eUSB2 在未來勢必會取代 USB2 介面，瑞昱已推出高效能低功耗的 eUSB2 repeater 晶片，符合 eUSB2 最新規格，可以協助客戶滿足 eUSB2 應用的需求。

在當前 PC 市場對低功耗與安全性的需求日益增長的趨勢下，瑞昱專注於開發高整合度、低功耗的嵌入式系統控制器 (Embedded Controller, EC) 晶片。此晶片採用性能領先的高階 32 位元 MCU，並配備更大容量的記憶體空間，為系統提供更充裕的資源，讓客戶能夠更靈活地進行創新應用開發，尤其在 AI 相關應用領域更具競爭力。此外，該晶片採用先進製程並內建完整的硬體加密引擎，成功實現了高效能、省電與高安全性的完美平衡。針對市場對 USB Type-C 規格的廣泛需求，瑞昱的 EC 晶片與自家 USB Type-C 控制晶片相結合，為客戶提供了一套完整且卓越的電源管理與資料傳輸解決方案。瑞昱的嵌入式系統控制器於民國 112 年下半年成功導入多家 PC 品牌供應鏈。自民國 113 年起，相關產品已陸續進入量產階段，預期將成為 PC 產業的重要技術支柱，為客戶創造更高的價值。

為提升新一代伺服器系統的管理效率，伺服器平台的週邊元件管理電路正經歷從 I2C/SMBus 轉換為 I3C 的介面升級，為因應市場需求，瑞昱推出 I3C 集線器 (I3C Hub) 晶片。此晶片除滿足系統設計的 I3C 擴充性需求，也內建獨家的智慧輪詢功能來減輕規格轉換期間系統設計的複雜度，可提升客戶在系統設計上的彈性。瑞昱 I3C 集線器晶片已於民國 113 年下半年開發完成，預計於民國 114 年進入量產並積極推廣市場。

#### **多媒體產品：**

液晶顯示器新的機會主要來自於針對高解析度、高更新率 (refresh rate)、優質影像色彩表現與最新外接顯示介面的需求。舉凡 WFHD、QHD、WQHD、UHD 等超高解析度高影像品質專業顯示器，支援高動態範圍 (HDR) 或是廣色域 (WCG) 的高影像品質顯示器，或者透過提供更高更新率以改善遊戲快速反應體驗的電競顯示器等應用，都是業界競逐的焦點。針對筆記型電腦或桌上型電腦等應用，瑞昱提供 DisplayPort 介面對 VGA 介面轉換晶片、DisplayPort 介面對 HDMI 介面轉換晶片，在一/二線品牌客戶獲得廣泛採用。因應市場對高速影像介面的需求提升，瑞昱開發完成 HDMI 2.1 retimer 產品，為下一波成長注入動能。

由於筆記型電腦以及手機甚至是 Apple iPad、iPhone 15 及後續機型大量採用 USB Type-C 作為影像、資料、電源傳輸的接口，市場對 USB Type-C 的周邊產品需求

也水漲船高。民國 113 年瑞昱於市場上推出最新的低功耗 DP 2.1/ HDMI 2.1 具 OSD 功能集線器控制晶片以及 DP 2.1/ HDMI 2.1 高階液晶顯示器控制晶片，並持續強化液晶顯示器控制晶片的畫質提升技術 UltraVivid PRO 以及動態低藍光 (Dynamic Low Blue Light) 技術以提升產品的附加價值，加大與競爭產品的差異，以持續強化市場競爭力。面對 AI 時代的來臨，並與 AIoT 以及 AI 攝影機搭配以提供業界 AI sensing monitor、AIoT monitor、AIoT docking station 等創新應用之全方位解決方案 (total solution)。

在液晶電視方面，瑞昱開發先進的人工智慧 (AI) 技術，融合業界領先的畫質增強、音效優化、以及智能化應用，成就卓越的視聽享受。晶片內建 AI 分析技術，能即時辨識畫面中的各種場景及物體，自動調整色彩、對比及亮度。無論是電影、運動賽事或遊戲畫面，都能呈現出逼真的細節與生動的色彩。

規格升級的電視系統單晶片內的 AI 音效處理技術，會根據影像內容自動優化音質，使對話更清晰、背景音樂更立體，讓用戶沉浸於環繞音效之中，享受電影級的聆聽體驗。以及內建的語音辨識系統，支援多種語言和方言，用戶可以輕鬆透過語音進行電視操作，無需遙控器。AI 還能學習使用者的偏好，提供個人化的內容推薦和快捷指令。

為實現低功耗設計，晶片採用 AI 優化的能效管理系統，可根據場景自動調節功耗，延長設備壽命，並符合環保節能的趨勢。透過領先的 AI 技術，我們將為消費者提供更加便捷與智能的娛樂體驗。

## (2) 產業上／中／下游關聯性

IC 產業之上、中、下游關係大致可分為上游之 IC 設計及 IC 設計服務業，中游之 IC 晶圓製造廠及下游之 IC 封裝、測試廠。IC 設計主要業務為自行設計及銷售產品，或接受客戶之委託設計，在產業鏈中屬於上游產業及知識密集產業，在完成最終產品前，還需經光罩、晶圓製造、晶片封裝及測試等主要過程。一般而言，光罩、晶圓製造及晶片封裝等過程是委託外部專業廠商生產或製作。

## 3. 技術及研究發展

### (1) 所營業務之技術層次及研究發展

通訊網路暨聯網多媒體晶片：

瑞昱的有線乙太網路及無線區域網路晶片廣泛應用於個人電腦 (PC) 市場、寬頻網路市場、消費性電子產品及車用市場等等。PC 應用包括筆記型電腦、主機板、網路存儲裝置 (NAS)、介面擴充基座 (Docking Station)、USB 轉 Ethernet 轉接器等產品。寬頻網路設備應用包括無線路由器、IP-STB、Cable Modem、PON。消費性電子產品應用如遊戲機、智慧電視、印表機、電冰箱、冷氣、語音控制智能型喇叭、家庭劇院組、IP 攝影機、掃地機器人、無人機、投影機、消費性或工業用機器人、工業控制等等。

在乙太網路交換器晶片方面，瑞昱在嵌入式應用如家用閘道器、Wi-Fi 路由器與 VoIP 電話、非網管型交換器 (Unmanaged Switch) 以及智慧型交換器 (Smart Switch) 市場都已取得應用領先地位。此外隨著全球光纖網路佈建與升級，瑞昱在 PON 以及光器件的 Laser driver 等產品有完整的應用方案。

瑞昱耕耘物聯網產品除廣泛應用於消費性電子產品，更結合人體、空間的感測技術以及搭配雲端生成式 AI，提供給消費者好用的終端應用。除了智慧家居市場、綠能應用之外，工業及醫療應用也積極佈局，建構更完整的智慧萬物連網家居環境。藍牙廣泛內建於手機、電視、機上盒、智能音箱等產品端，協助個人與家庭成員經由藍牙無線連接，享受藍牙耳機、運動手環、藍牙語音遙控器，帶來更便利的娛樂享受及更人性化的人機互動。

電腦週邊暨智慧互聯晶片：

瑞昱電腦音訊產品及影像產品應用方面，整合邊緣 AI 運算處理器 (Edge AI) 及演算法，已成為 PC 應用領導廠商，持續樹立技術及市場領先標竿。此外在消費性電子裝置如智慧型手機和遊戲機市場上音訊晶片市場獲得相當高的評價。結合策略合作夥伴，虛擬實境 (VR) 及車用語音市場應用，也已取得成果。

瑞昱因應筆記型電腦及桌上型電腦市場的應用需求，多年來持續推出一系列晶片產品，包括多功能整合型 Card Reader 晶片、USB 集線器 (Hub)、高整合度的 USB Type-C 與 Power Delivery 產品、以及高整合度低功耗的嵌入式系統控制器 (Embedded Controller) 晶片。除持續保持應用領先外，也期許為客戶創造新的產品應用價值。

多媒體晶片：

瑞昱液晶顯示器控制器、低功耗 DP 2.1/ HDMI 2.1 集線器控制晶片以及 DisplayPort 介面對 VGA 介面/HDMI 介面轉換晶片，主要針對筆記型電腦或桌上型電腦等應用。面對 AI 時代的來臨，瑞昱液晶顯示器控制器並與 AIoT 以及 AI 攝影機搭配以提供業界 AI sensing monitor、AIoT monitor、AIoT docking station 等創新應用之全方位解決方案 (total solution)。

在液晶電視應用方面，瑞昱開發先進的人工智慧 (AI) 技術，融合業界領先的畫質增強、音效優化、以及智能化應用，成就卓越的視聽享受。內建的語音辨識系統，用戶可以輕鬆透過語音進行電視操作。AI 還能學習使用者的偏好，提供個人化的內容推薦和快捷指令。透過領先的 AI 技術，我們將為消費者提供更加便捷與智能的娛樂體驗。

## (2) 研究發展人員與其學經歷

截至民國一百一十四年三月三十一日，本公司研究發展人員共計 6,629 人，其中約 73.81% 擁有碩士以上學歷，平均服務年資約 7.7 年。

(3) 最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

A.最近五年度之研發費用情形

單位:新台幣千元

年度	營業額	研究發展支出	比重(%)
109	77,759,470	19,054,888	24.50
110	105,504,286	27,949,765	26.49
111	111,789,791	30,081,533	26.91
112	95,179,276	26,434,295	27.77
113	113,393,698	33,543,624	29.58

B.開發成功之技術或產品

**通訊網路暨聯網多媒體產品：**

- 乙太網路控制器系列
- 乙太網路實體層收發器系列
- USB 存儲橋接控制器系列
- PCIE 轉 SATA 橋接控制器系列
- 超高清機上盒系統單晶片系列
- 車用乙太網路實體層收發器系列
- 車用乙太網路高度整合型交換器系列
- 整合型正交分頻多重存取無線區域網路 (WLAN) 暨藍牙晶片系列
- 無線區域網路 802.11ax 雙頻存取點/路由器整合型系統單晶片系列
- 無線區域網路 802.11be 無線存取點/路由器整合型系統晶片系列
- 物聯網多功能單晶片系列
- 物聯網 AI 無線網路攝影機單晶片系列
- 藍牙 5.3 低功耗單模單晶片
- 藍牙 5.3 音訊單晶片
- 藍牙助聽器單晶片方案及
- Matter over Thread 單晶片方案
- GNSS 衛星定位單晶片系列
- 多埠乙太網路實體層晶片組系列
- 多埠乙太網路交換器晶片組系列
- 多埠乙太網路管理型交換器晶片組系列
- 高整合被動式光纖網路晶片組系列
- 多埠乙太網路供電設備控制晶片系列

**電腦週邊暨智慧互聯產品：**

- HD-A 音訊編碼解碼晶片系列
- USB 2.0 低功耗音訊編碼解碼晶片系列
- SoundWire 音訊編碼解碼晶片系列
- SoundWire 支援喇叭保護音訊功率放大器晶片系列
- 車用支援 AI 運算之語音數位訊號處理器單晶片系列
- 行動裝置用高傳真音訊編解碼暨音效功率放大器單晶片系列

- 行動裝置用高傳真音訊編解碼暨語音/音效數位訊號處理器單晶片系列
- 行動裝置用具喇叭保護功能及等化器之高音質高效能 D 類功率放大器晶片系列
- 遊戲機手把用高傳真音效數位訊號處理器單晶片系列
- 遊戲機用高傳真音訊編解碼晶片系列
- I2S D 類功率放大器晶片系列
- 高電壓 D 類功率放大器晶片系列
- 具邊緣 AI 運算內嵌式 USB 介面高畫質影像數位信號處理晶片系列
- 具邊緣 AI 運算 I2C 介面機器視覺控制晶片
- USB 2.0 指紋辨識 MOC (Matching On Chip) 控制晶片系列
- 高整合度 5MP 邊緣 AI 運算網路攝影機單晶片系列
- USB 3.2 介面支援 Intel 省電規範筆記型電腦用讀卡機晶片系列
- PCIe 介面支援 SD 7.1 與 SD 8.0 筆記型電腦用讀卡機晶片系列
- USB4 Hub 集線器控制晶片系列
- 4-Port USB 3.2 Gen 2 集線器晶片系列
- 7-Port USB 3.2 Gen 2 集線器晶片系列
- 高整合型 PD 3.2 EPR 控制晶片系列
- USB 3.2 與 DP 2.1 Redriver 晶片系列
- eUSB2 Repeater 控制晶片系列
- 高整合度低功耗嵌入式系統控制晶片系列
- I3C 集線器控制器晶片系列

#### **多媒體產品：**

- 高解析度整合型電競液晶顯示控制晶片系列
- 整合型液晶顯示控制晶片系列
- DisplayPort 視訊轉換晶片系列
- DisplayPort MST 集線器控制晶片系列
- HDMI Retimer 晶片系列
- 高端智慧聯網液晶電視控制晶片系列
- 智慧顯示系統單晶片系列
- 8K 影像解碼與處理晶片
- 超解析度成像畫質提升系統單晶片系列
- 規格升級支持 AI 影像及聲音處理的電視系統單晶片

## (二) 市場及產銷概況

### 1. 市場分析

#### (1) 主要商品之銷售地區

單位：新台幣千元

銷售地區	112 年度		113 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
台灣	38,940,171	40.91%	44,435,413	39.19%
亞洲	55,394,154	58.20%	67,922,330	59.90%
其他	844,951	0.89%	1,035,955	0.91%
合計	95,179,276	100.00%	113,393,698	100.00%

#### (2) 市場占有率

瑞昱為全球頂尖的 IC 供應商之一，設計和開發有線及無線通訊網路、電腦週邊、消費性及多媒體、車用等應用領域的各種 IC 產品。依據 Omdia 資料，瑞昱居 113 年全球 IC 設計公司營收排行第 7 名。

#### (3) 市場未來供需狀況與成長性

後疫情時代因生活與工作的模式改變，人們更加依賴物聯網及雲端服務。許多電子產品、家電產品甚至交通工具對於有線與無線網路晶片需求強勁，包括寬頻產品如 IP-STB、Cable Modem、PON，及消費性電子產品如遊戲機、智慧電視、印表機、電冰箱、冷氣、語音控制智能型喇叭、家庭劇院組、IP 攝影機、掃地機器人、無人機、投影機、消費性或工業用機器人、工業控制，甚至汽車內建乙太網路、Wi-Fi 或藍牙的比重也逐步提高。在愈來愈多的裝置都透過無線連結，加上智慧型手機和雲端服務的普及，物聯網和人工智慧等混合型應用將是帶動下一波 Wi-Fi 與藍牙成長的重要動能。同時，無線連結速度的提升也帶動有線網路及寬頻的升級，Multi-GbE 的網路時代已經來臨，在搭載 WAN 與 LAN 孔的 Wi-Fi 6 無線接入點/路由器(Access Point/Router)、交換器、PON 光纖網路、電視有線數據機(Cable Modem)網路用戶、電話網路數位用戶(DSL)、5G 網路終端用戶設備(CPE)、網路存儲裝置(NAS)、電競和商用電腦與擴充網路卡及 USB 轉乙太網路配件都有具體的升級規劃，未來 2.5GbE 以上的乙太網路將漸成主流。此外，乙太網路市場另一個成長動能來自車聯網，自駕車及電動車趨勢帶動車內數據流的頻寬大幅增長，以及減重節能的環保意識，使得乙太網路成為車內的主幹網路。

隨著全球 AI 技術與雲端運算的快速發展，高速運算與資料傳輸的需求急遽增加，推動超大規模資料中心 (Hyperscale Data Centers) 需求的成長。光通訊技術以其高頻寬與低延遲的特性，成為資料中心升級的關鍵解決方案。特別是在支持 100G、400G、800G 及更高速度的光通訊收發器需求不斷增加，以應對 AI 模型訓練與推理所需處理的大量數據傳輸需求。

根據研調機構預測，光通訊產業在 2023~2029 年的年複合成長率 (CAGR) 達

45%，這主要受益於資料中心和電信市場對更高速率傳輸的需求增長，以及雲端服務供應商加大對網路設備的投資。為因應這波趨勢，瑞昱計劃於 2025 年推出 100G Optical PHY 產品，並積極開發支援 400G 和 800G 尖端模組的 PAM4 DSP IC，全面布局未來數據中心應用市場，為產業長期發展奠定堅實基礎。

OTT 零售品牌機上盒與 IP 運營商機上盒市場需求未來將持續攀升，同時，因 8K 電視未見明顯成長，4K 產品出現更多變化以強化市場區隔，在超高清電視成長、多樣影音內容普及，以及 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、甚至 Wi-Fi 7 等高速聯網的需求快速成長的帶動下，加上智慧家居的整合和語音智慧控制的需求，機上盒市場對於高速連結的需求無線化、邊緣運算智慧化。此外，運營商市場轉向開放、網路串流化，帶動 IP 機上盒晶片需求的成長。瑞昱將藉由開發高整合度且具新功能的高性價比多媒體控制晶片，同時結合瑞昱的網路通訊晶片，提供結合軟硬體優勢的整體解決方案 (Total Solution) 給客戶，協助客戶掌握商機。

民國 113 年生成式 AI 大爆發，世人莫不期待在工作場合、日常生活或是教育場所皆可便利使用生成式 AI。面對無所不在的虛擬助理，語音控制是最人性化的方式。瑞昱耕耘語音識別、語音喚醒與降噪技術以及深度學習技術多年，已在諸多產品打造流暢語音應用的使用者經驗，讓使用者得以享受便捷的語音控制，成為新一代電腦產品中語音與音質方面最佳的整合方案，搭配低功耗物聯網單晶片，更可以實現即帶即走的 AI 隨身錄音卡，讓使用者無論是工作或生活上都可以隨時享受這個功能。瑞昱也開發整合功率放大器的音訊編碼解碼晶片，其中的功率放大器除了以低功耗設計整合內建適配性升壓電路外，也包含幫客戶節省外部元件的相關設計，讓新一代整合型晶片支援高電壓 (+9V) 具保護功能的 D 類功率放大器。因應電競 PC 的發展追求高音質的需求，如 Hi-Fi Audio (32bits/384KHz Sample Rate) 音訊規格，音訊技術發展將整合現有軟體與硬體優勢持續耕耘，以提供客戶在輕薄型電腦與 Hi-Fi Audio 應用最好的選擇。

液晶顯示器市場的成長契機來自於新的規格與介面技術，如 4K2K、USB4、USB Type-C、HDMI 2.1、DP 2.1、HDR、WCG、高更新率電競 (High frame rate gaming) 機種等，其中面板廠以及 TCON 廠商攜手在既有架構下 (相同 LVDS 線組，相同 LVDS 接頭，相同 PCB)，持續提升面板的更新率 (frame rate) 以提高附加價值已經成功引起品牌客戶的青睞，提升 scaler 的更新率支援已經變成重要的趨勢，而整機成本的降低以及減少功耗亦是重點發展方向。針對民國 113 年筆記型電腦/桌上型電腦市場，影像介面接頭採用數位介面的趨勢維持不變，帶動市場對於 DisplayPort 對 HDMI 2.0 介面控制晶片、高階的 DisplayPort 對 HDMI 2.1 介面轉換晶片、HDMI 2.1 Retimer 晶片、USB4 Retimer 晶片、外接 USB Type-C 影像轉換器以及 DisplayPort MST 集線器控制晶片的需求。

根據 TrendForce 最新調查，113 年上半年全球電視品牌出貨量為 9,071.7 萬台，年增 0.8%。各地區需求漲跌互見，中國因房地產市場疲軟及年輕族群使用習慣改變，電視銷售不如預期。北美地區有持續性低價競爭支撐需求，歐洲則受惠於運動賽事加上前兩年通膨壓低基期，上半年電視出貨優於預期。113 年下半年中國政府為刺激經濟，自九月開始實施家電舊換新政策，為購買家電產品的消

費者提供產品售價 15~20%的補貼，而此政策也讓原先低迷的電視需求開始復甦，Omdia 統計，中國國慶節期間，中國 LCD 電視銷量年增幅度達 2 位數，但全球年度電視出貨量仍僅小幅增加。

由 Google 主導的 Google TV 整合多項 Gemini AI 功能，包括提供節目摘要、評論以及逐季分析，藉此幫助用戶選擇欲觀賞的內容，環境模式也獲得升級，並新增透過使用生成式 AI 來設計螢幕保護程式的能力，以期吸引更多 OEM 加入。展望未來，全球液晶電視市場仍會維持一定的量能，瑞昱將持續積極推廣主要市場，提供客戶最完整的解決方案。

#### (4)競爭利基

- 先進核心技術：瑞昱具備優異的射頻、類比與混合訊號電路設計能力、積體電路製造知識、系統技術與智慧財產權的交互應用，藉以提升產品效能與生產良率，進而降低成本和增加產品價值。
- 堅強的客戶基礎：瑞昱的客戶群包括領導品牌的個人電腦廠商、主機板廠商及網路系統、消費性電子與多媒體產品生產廠商等，除提供客戶高附加價值、高效能、高經濟效益的解決方案，亦重視建立與客戶的長期合作關係。
- 高成本效益與客戶導向的產品：瑞昱也特長於研發具成本效益的產品，並將晶片與系統設計結合，以提供客戶高附加價值的系統整合解決方案，並協助客戶快速推出新產品上市。
- 引領新應用與新市場的創新產品：瑞昱持續探索新應用與新市場的新商機，並跟合作夥伴緊密合作，即時端出市場需要的創新產品，以解決終端使用者的痛點，也滿足終端使用者的潛在需求，以創新增加產品的應用與市場的價值。
- 經驗豐富的技術與管理團隊：瑞昱的技術與管理團隊，均有多年半導體產業豐富經驗，藉由良好的工作環境與企業文化，吸引優秀技術與管理人才加入。

#### (5)發展遠景之有利及不利因素

有利因素：

- 領先國內同業推出多項通訊網路暨聯網多媒體、電腦週邊暨智慧互聯及多媒體 IC 產品，具規格與價格競爭力。瑞昱持續建立先進核心技術，有助於改善產品良率、降低生產成本和增加產品價值。
- 瑞昱與晶圓廠及封裝廠均維持良好合作關係，有利原料供應及成本之穩定。
- 主動配合客戶需求，並提供最佳行銷服務予客戶，因此擁有堅強的客戶基礎。
- 具經驗豐富之研發與管理團隊，以充分授權與相互支援的企業文化吸引優秀技術人才加入。

不利因素：

因市場競爭激烈且產品生命週期短，若未能及時推出新產品，會失去市占率，進而影響獲利。

因應對策：

- 積極投入新產品研發，以及時推出新產品搶佔市場先機。
- 積極投入現有產品之改良，藉由良率提升與效能增加，以降低成本或提升產

品價值。

●藉由全方位產品服務或與客戶共同開發新產品，以達到雙贏的成效。

2.最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明：

(1)主要產品毛利比較

單位：新台幣仟元；%

年度	毛利率(%)	毛利率變動率(%)
113 年度	50.41%	17.75%
112 年度	42.81%	-12.40%

(2)毛利率較前一年度變動達百分之二十者，應分析造成價量變化之關鍵因素及對毛利率之影響：不適用。

## 二、轉投資事業

### (一)轉投資事業概況

114年3月31日，單位：股數/新台幣千元；%

轉投資事業	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬 (113年度)	
				股數	股權比例				投資損益	分配股利
Leading Enterprises Limited	對各種事業之投資	16,389,585	17,159,817	34,630	100%	17,159,817	不適用	權益法	699,592	-
Amber Universal Inc.	對各種事業之投資	1,905,162	877,304	41,432	100%	877,304	不適用	權益法	25,766	-
Wise Elite Global Limited	對各種事業之投資	33,182	36,414	1,000	100%	36,414	不適用	權益法	1,722	-
Empsonic Enterprises Inc.	對各種事業之投資	937,392	2,616,535	2,825,000	100%	2,616,535	不適用	權益法	207,437	-
Bluocean Inc.	對各種事業之投資	3,651,679	4,038,493	110,050,000	100%	4,038,493	不適用	權益法	163,121	-
Talent Eagle Enterprise Inc.	對各種事業之投資	3,786,066	2,915,283	114,100,000	100%	2,915,283	不適用	權益法	157,341	-
瑞新投資股份有限公司	對各種事業之投資	280,000	734,545	28,000,000	100%	734,545	不適用	權益法	(8,960)	-
鴻威創業投資股份有限公司	對各種事業之投資	250,000	530,333	25,000,000	100%	530,333	不適用	權益法	1,038	3,131
瑞擎投資股份有限公司	對各種事業之投資	293,930	191,972	29,392,985	100%	191,972	不適用	權益法	(27,935)	-
瑞曜科技股份有限公司	研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路	5,000	4,887	500,000	100%	4,887	不適用	權益法	(47)	-
波比特科技股份有限公司	電腦設備製造及安裝、電子材料、資訊軟體批發、零售及服務	19,189	19,410	1,918,910	66.67%	29,115	不適用	權益法	166	119
科締納科技股份有限公司	研發與技術服務	66,364	107,718	21,130,000	100%	141,159	不適用	權益法	18,751	-
昱鉉科技股份有限公司	研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路	20,000	(11,836)	2,000,000	100%	30,477	不適用	權益法	51,589	14,691
Realtek Semiconductor (Japan) Corp.	資訊蒐集及技術服務	4,450	7,387	400	100%	7,387	不適用	權益法	709	-

轉投資事業	主要營業項目	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬 (113年度)	
				股數	股權比例				投資損益	分配股利
Realtek Semiconductor (Hong Kong) Limited	資訊及技術服務	6,398	1,151	-	100%	1,151	不適用	權益法	(46)	-
瑞昱半導體(深圳)有限公司	研發與技術服務	165,910	400,935	-	100%	400,935	不適用	權益法	51,865	-
科締納網絡系統(上海)有限公司	研發與技術服務	119,455	146,772	-	100%	221,443	不適用	權益法	13,922	-
瑞晟微電子(蘇州)有限公司	研發與技術服務	929,096	2,611,896	-	100%	2,611,896	不適用	權益法	206,444	-
合肥沛睿微電子股份有限公司	研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路	120,115	138,330	-	100%	138,330	不適用	權益法	(145,800)	-
蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司	研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路	45,758	(157,678)	-	100%	(157,678)	不適用	權益法	(3,115)	-
Realtek Singapore Private Limited	研究、開發、生產、製造、銷售各種積體電路	4,708,031	61,210,059	116,059,638	100%	61,216,516	不適用	權益法	15,354,089	6,530,800
Cortina Access, Inc.	研發與技術服務	1,335,352	1,126,734	16,892	100%	1,018,622	不適用	權益法	61,282	-
Ubilinx Technology Inc.	研發與技術服務	1,990,920	434,185	60,000,000	100%	434,185	不適用	權益法	31,461	-
Realtek Viet Nam Co., Ltd.	研發與技術服務	132,728	95,893	4,000,000	100%	95,893	不適用	權益法	6,545	-
Realtek Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd.	研發與技術服務	78,141	76,874	10,450,000	100%	76,874	不適用	權益法	1,015	-
Realtek Korea Inc.	研發與技術服務	45,080	77,990	200,000	100%	77,990	不適用	權益法	13,880	-
Realtek Germany GmbH	研發與技術服務	17,971	18,718	500,000	100%	18,718	不適用	權益法	251	-
Realtek Bangalore Private Limited	研發與技術服務	5,037	1,550	1,300,000	100%	1,550	不適用	權益法	(3,662)	-

註：本公司之轉投資事業未持有本公司股票。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：無。

### 三、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約 5 筆	科學工業園區管理局	112.01 – 131.12 103.03 – 116.12 108.09 – 127.12 109.02 – 128.12 112.05 – 131.12	建造廠房、倉庫、實驗室或作為儲運、裝卸、包裝及修配等工作場地。	用途限於建造廠房、倉庫、實驗室或作為儲運、裝卸、包裝及修配等事業工作場地之用。

### 參、發行計畫及執行情形

一、本次發行限制員工權利新股應記載事項

(一)資金來源:不適用。

(二)本次發行限制員工權利新股發行及認股辦法:詳附件一。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項:不適用。

## 肆、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### (一)財務分析

##### 1.合併財務分析-國際財務報導準則

項	年 目	最近五年度財務分析					
		109年	110年	111年	112年	113年	114年 3月31日
財務結構	負債占資產比率(%)	62.26	61.52	58.87	54.97	53.50	64.47
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	718.59	672.87	676.96	543.37	582.04	508.88
償還能力	流動比率(%)	144.83	146.62	152.67	149.82	146.06	121.40
	速動比率(%)	125.00	117.36	110.98	123.17	121.89	101.65
	利息保障倍數	59.47	171.22	79.82	39.11	56.84	195.83
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.40	7.07	7.93	7.63	8.13	8.06
	平均收現日數	57	52	46	47	45	45
	存貨週轉率(次)	4.88	3.78	2.36	2.11	3.32	3.98
	應付款項週轉率(次)	4.69	4.63	5.00	5.66	7.08	6.20
	平均銷貨日數	75	97	154	172	110	92
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	19.69	19.62	16.13	11.67	12.34	14.85
	總資產週轉率(次)	1.02	1.17	1.04	0.91	1.09	1.17
獲利能力	資產報酬率(%)	11.79	18.90	15.27	9.05	14.98	16.06
	股東權益報酬率(%)	31.01	49.26	37.80	20.56	32.12	39.27
	稅前利益占實收資本額比率(%)	183.20	344.14	329.94	186.10	318.62	109.29
	純益率(%)	11.30	15.97	14.49	9.61	13.48	13.59
	每股盈餘(元)	17.24	33.00	31.62	17.85	29.82	9.28
現金流量	現金流量比率(%)	33.47	31.19	30.47	38.69	41.29	30.18
	現金流量允當比率(%)	143.56	128.26	108.18	102.64	109.07	113.83
	現金再投資比率(%)	27.31	23.78	10.16	8.40	27.63	32.46
槓桿度	營運槓桿度	3.79	3.02	3.56	6.63	3.90	3.47
	財務槓桿度	1.01	1.00	1.01	1.03	1.02	1.00

最近二年度各項財務比率變動原因(增減變動達20%以上)：

1. 利息保障倍數上升：主係本期獲利增加所致。
2. 存貨週轉率上升及平均銷貨日數下降：主係本期銷貨成本增加及存貨減少所致。
3. 應付款項週轉率上升：主係本期銷貨成本增加所致。
4. 獲利能力上升：主係本期獲利增加所致。
5. 現金再投資比率上升：主係本期營業活動淨現金流量增加與發放現金股利減少所致。
6. 營運槓桿度下降：主係本期營業利益增加所致。

## 2.個體財務分析-國際財務報導準則

項	目	最近五年度財務分析				
		109年	110年	111年	112年	113年
財務結構	負債占資產比率(%)	57.94	57.55	53.67	50.38	48.72
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	763.62	699.96	696.77	549.72	590.45
償還能力	流動比率(%)	54.07	64.45	55.36	58.61	56.99
	速動比率(%)	37.77	40.12	31.17	37.63	37.37
	利息保障倍數	66.31	192.93	86.09	40.92	56.76
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.49	7.07	8.25	7.87	8.56
	平均收現日數	56	52	44	46	43
	存貨週轉率(次)	4.91	3.58	2.53	2.55	3.51
	應付款項週轉率(次)	4.82	4.56	5.63	6.72	7.33
	平均銷貨日數	74	102	144	143	104
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	16.01	13.78	10.36	7.91	8.56
	總資產週轉率(次)	0.82	0.84	0.70	0.65	0.80
獲利能力	資產報酬率(%)	12.97	20.94	17.02	10.08	16.52
	股東權益報酬率(%)	31.02	49.27	37.81	20.57	32.13
	稅前利益占實收資本額比率(%)	183.15	343.80	329.17	185.97	308.02
	純益率(%)	15.58	24.65	24	14.91	20.25
	每股盈餘(元)	17.24	33.00	31.62	17.85	29.82
現金流量	現金流量比率(%)	38.88	27.02	28.61	41.55	36.98
	現金流量允當比率(%)	102.41	95.03	94.87	93.14	105.06
	現金再投資比率(%)	28.10	14.30	1.65	5.16	18.07
槓桿度	營運槓桿度	6.97	7.88	27.81	16.69	185.78
	財務槓桿度	1.04	1.02	1.19	1.16	-1.96

最近二年度各項財務比率變動原因(增減變動達20%以上)：

1. 利息保障倍數增加：主係本期獲利增加所致。
2. 存貨週轉率上升及平均銷貨日數下降：主係本期銷貨成本增加及存貨減少所致。
3. 總資產週轉率上升：主係本期營業收入增加所致。
4. 獲利能力上升：主係本期獲利增加所致。
5. 現金再投資比率上升：主係本期營業活動淨現金流量增加與發放現金股利減少所致。
6. 營運槓桿度上升及財務槓桿度下降：主係本期營業利益減少所致。

計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋長期負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

## 二、財務報告應記載事項

(一)最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告

- 1.民國一百一十二年度合併財務報表及會計師查核報告：請詳附件三。
- 2.民國一百一十三年度合併財務報表及會計師查核報告：請詳附件四。
- 3.民國一百一十四年第一季合併財務報表及會計師核閱報告：請詳附件五。

(二)最近二年度經會計師查核簽證之年度個體財務報告

- 1.民國一百一十二年度個體財務報表及會計師查核報告：請詳附件六。
- 2.民國一百一十三年度個體財務報表及會計師查核報告：請詳附件七。

(三)申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告：無。

## 三、財務概況應記載事項

(一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第 185 條情事者：無。

## 四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

單位：新台幣千元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
		金額	金額	金額	%
流動資產		84,658,007	69,287,620	15,370,387	22.18%
非流動資產		29,238,723	24,527,650	4,711,073	19.21%
資產總額		113,896,730	93,815,270	20,081,460	21.41%
流動負債		57,960,975	46,245,752	11,715,223	25.33%
非流動負債		2,978,267	5,331,356	(2,353,089)	-44.14%
負債總額		60,939,242	51,577,108	9,362,134	18.15%
股本		5,128,636	5,128,636	0	0.00%
資本公積		287,282	542,048	(254,766)	-47.00%
保留盈餘		40,934,415	33,728,036	7,206,379	21.37%
其他權益		6,597,430	2,829,740	3,767,690	133.15%
非控制權益		9,725	9,702	23	0.24%
股東權益總額		52,957,488	42,238,162	10,719,326	25.38%

增減比例變動達 20% 以上說明：

- 1.流動資產增加：主係透過損益按公允價值衡量之金融資產與現金及約當現金增加所致。
- 2.流動負債增加：主係其他應付款及應付帳款增加所致。
- 3.非流動負債減少：主係長期借款減少所致。
- 4.資本公積減少：主係發放現金予股東所致。
- 5.保留盈餘增加：主係獲利增加所致。
- 6.其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

## (二)財務績效

單位：新台幣千元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
		金額	金額	金額	%
營業收入		113,393,698	95,179,276	18,214,422	19.14%
營業成本		(56,231,862)	(54,431,219)	(1,800,643)	3.31%
營業毛利		57,161,836	40,748,057	16,413,779	40.28%
營業費用		(43,660,290)	(34,093,065)	(9,567,225)	28.06%
營業利益		13,501,546	6,654,992	6,846,554	102.88%
營業外收入及支出		2,839,664	2,889,643	(49,979)	-1.73%
繼續營業部門稅前淨利		16,341,210	9,544,635	6,796,575	71.21%
所得稅費用		(1,049,685)	(391,797)	(657,888)	167.92%
本期淨利		15,291,525	9,152,838	6,138,687	67.07%

增減比例變動達 20%以上說明：

1. 營業毛利增加：主係認列存貨回沖利益所致。
2. 營業費用增加：主係用人支出增加所致。
3. 稅前淨利增加：主係營業利益增加所致。
4. 所得稅費用增加：主係當期所得產生所得稅增加。

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：請參閱本公司 113 年年報「致股東報告書 - 114 年度營業計畫概要」。

## (三)現金流量分析

1. 最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫：

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年因投資及籌資 活動淨現金流量	匯率 影響數	現金剩餘(不足) 數額	現金不足額之 補救措施	
					投資 計畫	理財 計畫
10,268,291	23,934,087	(19,773,015)	383,096	14,812,459	—	—

現金流量變動情形分析：

- (一) 營業活動：淨現金流入主係來自營業獲利。
- (二) 投資活動：淨現金流出主係取得透過損益按公允價值衡量之金融資產、不動產、廠房及設備與無形資產所致。
- (三) 籌資活動：淨現金流出主係發放股利及償還長期借款所致。

2. 未來一年現金流動性分析：不適用

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計

劃：

本公司轉投資主要為策略性投資，113 年度合併財務報表按權益法認列之投資損失為 40,813 仟元。未來本公司將持續以策略性投資為原則，審慎評估轉投資計劃。

(六)其他重要事項：無。

## 伍、特別記載事項

- 一、內部控制制度執行狀況：委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。
- 二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等應揭露信用評機構所出具之信用評等報告：不適用。
- 三、證券承銷商評估總結意見：不適用。
- 四、律師法律意見書：不適用。
- 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：請參照附件二。
- 六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金管會通知應補充揭露之事項：不適用。
- 七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。
- 八、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：不適用。
- 九、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：不適用。
- 十、公司治理運作情形：

### (一)董事會運作情形

上屆董事任期：110年08月09日至113年05月30日

本屆董事任期：113年05月30日至116年05月29日

截至公開說明書刊印日為止，董事會113年度共開會6次，114年度共開會2次，董事出席情形如下：

#### 【113年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	莫理仕有限公司 代表人：邱順建	6	0	100%	無
副董事長	莫理仕有限公司 代表人：黃湧芳	6	0	100%	無
董事	桃德股份有限公司/ 太陽有限公司 代表人：葉博任	6	0	100%	無
董事	顏光裕	6	0	100%	無

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
董事	倪淑卿	6	0	100%	無
董事	德佳投資股份有限公司 代表人：葉明翰	4	0	100%	113年5月 30日新任
獨立董事	楊泮池	4	0	100%	
獨立董事	柯復華	3	1	75%	
獨立董事	謝穎青	4	0	100%	
董事	闢德工業股份有限公司 代表人：葉南宏	1	0	50%	113年5月 30日卸任
副董事長	莫理仕有限公司 代表人：陳國忠	2	0	100%	
獨立董事	陳甫彥	2	0	100%	
獨立董事	蔡調彰	2	0	100%	
獨立董事	羅俊拔	2	0	100%	

【114年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	莫理仕有限公司 代表人：邱順建	2	0	100%	無
副董事長	莫理仕有限公司 代表人：黃湧芳	2	0	100%	
董事	桃德股份有限公司 代表人：葉博任	2	0	100%	
董事	顏光裕	2	0	100%	
董事	倪淑卿	2	0	100%	
董事	德佳投資股份有限公司 代表人：葉明翰	2	0	100%	

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	楊泮池	2	0	100%	
獨立董事	柯復華	2	0	100%	
獨立董事	謝穎青	2	0	100%	

其他應記載事項：

1. (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用。  
(2) 其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：不適用
2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對利害關係議案均有迴避。
3. 加強董事會職能之目標與執行情形評估：
  - (1) 設置功能性委員會：為健全監督功能及強化管理機能，本公司已分別設置審計委員會、薪資報酬委員會與提名委員會。
  - (2) 督導永續發展推動績效：督導事項包括永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫；主要利害關係人及其關注之議題；公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討；永續發展未來之改進方向與目標。

4. 董事會暨功能性委員會績效評估執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行內部董事會暨功能性委員會績效評估。	113年1月1日至113年12月31日。	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)之績效評估。	董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會內部自評。績效評估之執行單位為提名委員會。	<p>一、董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。</p> <p>二、個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制。</p> <p>三、功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。</p>

## (二) 審計委員會運作情形

審計委員會主要協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會依本公司審計委員會組織規程運作，每季至少召開一次，並與公司內部稽核主管、簽證會計師等均有良好之溝通聯繫管道。

上屆審計委員任期：110年08月09日至113年05月30日

本屆審計委員任期：113年05月30日至116年05月29日

截至公開說明書刊印日為止，審計委員會113年度共開會6次，114年度共開會2次，獨立董事出席情形如下：

### 【113年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	楊泮池	4	0	100%	113年5月 30日新任
獨立董事	柯復華	3	1	75%	
獨立董事	謝穎青	4	0	100%	
獨立董事	陳甫彥	2	0	100%	113年5月 30日卸任
獨立董事	蔡調彰	2	0	100%	
獨立董事	羅俊拔	2	0	100%	

### 【114年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	楊泮池	2	0	100%	無
獨立董事	柯復華	2	0	100%	
獨立董事	謝穎青	2	0	100%	

其他應記載事項：

#### 1. (1)證交法第14條之5所列事項：

日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113.02.26	1. 本公司112年度合併及個體財務報告。 2. 112年關係人交易情形報告。 3. 本公司及持股100%轉投資公司之資金貸與案。 4. 本公司113年度財務報告簽證會計師及公費案。 5. 本公司112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。	所有獨立董事對議案均一致通過
113.04.18	1. 本公司民國113年第一季合併財務報告。 2. 本公司資金貸與子公司。 3. 辦理子公司資金貸與展期。 4. 本公司112年度營業報告書。 5. 本公司112年度盈餘分配案。 6. 112年度盈餘分派現金股利。 7. 本公司資本公積配發現金案。	
113.05.30	1. 推選本公司第三屆審計委員會召集人及會議主席。	

日期	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
	2. 本公司執行長與副執行長人事異動事宜。	
113.07.25	1. 本公司民國113年第二季合併財務報告。 2. 購置台北辦公室事宜。 3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。 4. 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 5. 修訂本公司「風險管理辦法及程序」。	
113.10.29	1. 本公司民國113年第三季合併財務報告。 2. 本公司展延為子公司背書保證期間及調整背書保證額度。 3. 本公司資金貸與子公司。 4. 提報民國114年關係人交易。 5. 本公司民國114年年度稽核計劃。 6. 修訂本公司「董事會議事規範」。 7. 修訂本公司「公司治理實務守則」。	
113.12.13	1. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」。	
114.02.26	1. 本公司113年度合併及個體財務報告。 2. 本公司113年度營業報告書。 3. 本公司113年度盈餘分配案。 4. 113年度盈餘分派現金股利。 5. 113年關係人交易情形報告。 6. 本公司114年度財務報告簽證會計師及公費案。 7. 本公司113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書。 8. 修訂本公司內部控制制度。 9. 發行114年度限制員工權利新股案。	
114.04.30	1. 本公司民國114年第一季合併財務報告。	

(2)其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與會計師以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就財務報表查核或核閱結果及財會、稅務、證管等相關法令規定進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

本公司獨立董事透過每季審計委員會或單獨與內部稽核主管以會議、座談、電話或電子郵件等方式溝通，就本公司稽核相關業務、稽核報告、發現問題及追蹤改善情形等議題進行討論，若遇有重大事項時得隨時召集會議。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則，投資人並可於本公司網站公司治理專區查詢公司治理相關規章。	—
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司設置投資人關係小組及委託專業股務代理機構處理股東建議或疑義等事宜。	—
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司定期掌握董事、經理人之持股情形。	—
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司為健全與關係企業間之財務業務往來，防杜關係企業間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項有非常規交易、不當利益輸送情事，已訂定關係人相互間財務業務相關作業規範並經董事會通過，規範內容除包括進銷貨交易、取得或處分資產之管理程序，並明訂前開各項重大交易應提報董事會通過後始得進行，且實際交易情形於年度結束後應提最近期股東會報告。	—
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已於 111 年 10 月 28 日董事會通過修正防範內線交易管理辦法，董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。為避免董事誤觸規範，本公司定期通知董事年度與每季財務報告公告前之封閉期間。 並根據本公司防範內線交易管理辦法規定，每年至少一次對現任董事、經理人及所有員工辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新進員工則由人事單位於教育訓練時安排教育宣導。 113 年度已於 01 月 02 日至 12 月 31 日期間對現任董事、經理人及全體員工進行相關教育宣導，113 年度防範內線交易教育訓練總授課時數為 43.83 小時，共 526 人次參與相關課程。課程內容包括重大訊息之保密作業，及	—

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。課程簡報與影音檔案並置於公司內部系統，提供新進員工進行相關教育訓練。	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>本公司董事會成員多元化政策如下：</p> <p>本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機處理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>本公司設置董事九席，其中三席為獨立董事。每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、國際行銷等。</p> <p>本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事會應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中</p>	—

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			之四項。本公司目前董事會與個別董事成員均達成多元化政策之管理目標。 本公司個別董事成員具備之能力請參閱附註 1。	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		公司已設置提名委員會。請參閱公司年報或公司網站揭露之提名委員會運作情形資訊。	—
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會。113年度董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會之績效評估結果均為「優」並已於114年2月27日提報董事會。績效評估之結果將運用於個別董事或功能性委員會委員薪資報酬及提名續任之參考。請參閱公司年報或公司網站揭露之董事會績效評估情形。	—
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年評估簽證會計師之獨立性，除了取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書外，依會計師職業道德規範來評估本公司簽證會計師獨立性，評估標準可參閱本公司 113 年度年報第 50~51 頁。另，取得會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)，針對專業性、獨立性、品質管控、監督、創新能力等五大構面，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。審計委員會經與簽證會計師充分溝通後，逐一評估簽證會計師之適任性。評估後本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性及適任性之情事。 最近一年度評估結果業經 114 年 2 月 26 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 2 月 27 日董事會決議通過。	—
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會	✓		本公司已經董事會決議通過指定公司治理主管，負責公司治理相關事務，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及	—

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
及股東會議事錄等)?			<p>任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程所訂定之事項等。</p> <p>113 年度業務執行情形如下：</p> <p>1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。</p> <p>(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>(4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>(5) 定期檢視本公司現任獨立董事於任職期間之專業資格、獨立性及兼任獨立董事限制，確保均符合相關法令規章</p> <p>2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：</p> <p>(1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p> <p>(3) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		公司網站已設置利害關係人專區，提供與利害關係人溝通與聯繫的專屬信箱，對於企業社會責任相關議題，如有任何疑問、建議或申訴事項，都可藉由此信箱進行暢通及良好之互動。	—
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任中國信託商業銀行代理部辦理股東會事務。	—
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		已於公司網站揭露財務、業務及公司治理資訊，投資人亦可藉由公開資訊觀測站查詢本公司之重大訊息。	—
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司已架設英文網站，並設有發言人負責對外溝通及指定專人依具法令規定於公開資訊觀測站揭露公司及法說會相關訊息。	—
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報 113 年度財務報告，並於法令規定期限內公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	—
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		1. 本公司隨時提供董事需注意之相關法規資訊。 2. 本公司董事出席董事會狀況良好，且皆符合法令之規定。 3. 議案如與董事有利害關係，均要求該董事迴避。 4. 本公司已購買董事責任保險，並經董事會決議通過。 5. 本公司依勞基法規定保障員工合法權益，並透過充實安定員工生活之福利制度及良好之教育訓練，與員工建立互信互賴之良好關係。	—
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司在資通安全方面，已導入ISO 27001 及TISAX 標準，並於113年度通過第三方認證，促進資通安全管理制度能貫徹實行與持續改善，提升資訊安全系統可靠性。另外更制定與營運目標連結之智慧財產管理計畫，該計畫之執行情形已於113年10月30日向董事會報告並於公司官網揭露。本公司持續配合公司治理指標持續提升資訊揭露透明度，及推動落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等相關措施。				

註 1：本公司個別董事成員具備之能力

董事	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
邱順建	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃湧芳	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉博任	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顏光裕	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
倪淑卿	女	✓	✓		✓	✓	✓		✓
葉明翰	男	✓		✓	✓	✓	✓		✓
楊泮池	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
柯復華	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝穎青	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### (四) 薪資報酬委員會之組成及運作情形

##### 1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別及姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	楊泮池		生醫專業、經營管理、策略規劃 工作年資: 45 年	請參閱附註說明	1
獨立董事 (委員)	柯復華		科技專業、經營管理、產業知識 工作年資: 39 年		0
獨立董事 (委員)	謝穎青		法律專業、營運判斷、危機處理 工作年資: 39 年		1

註：(1)本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：無；  
 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：0；  
 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：無；  
 (4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：0。

##### 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

上屆薪資報酬委員：110 年 08 月 09 日至 113 年 05 月 30 日

本屆薪資報酬委員：113 年 07 月 30 日至 116 年 05 月 29 日

截至公開說明書刊印日為止，薪資報酬委員會 113 年度共開會 3 次，114 年度共開會 1 次，委員出席情形如下：

##### 【113 年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊泮池	2	0	100%	113 年 7 月 30 日新任
委員	柯復華	2	0	100%	
委員	謝穎青	2	0	100%	
召集人	蔡調彰	1	0	100%	113 年 5 月 30 日卸任
委員	陳甫彥	1	0	100%	
委員	羅俊拔	1	0	100%	

##### 【114 年度】

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊泮池	1	0	100%	無
委員	柯復華	1	0	100%	
委員	謝穎青	1	0	100%	

##### 3. 定期檢討績效評估與薪資報酬

(1) 本委員成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

- (2) 本委員會履行職權時，應依下列原則為之：
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  - 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  - 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  - 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
- (3) 本公司薪資報酬委員會與董事會視實際經營狀況與相關法令規定，適時檢討董事及經理人薪酬政策，為推動 ESG(環境、社會、治理)目標實現，確保董事與經理人的決策與行為與公司 ESG 目標一致，並激勵董事與經理人關注 ESG 績效，本公司已將 ESG 績效評估結果與董事及經理人之薪酬相連結，並制定 ESG 相關指標作為評估依據，由董事會監督本政策的執行情形，並定期評估政策執行情形及依據需要進行調整和優化，藉此激勵董事與經理人積極參與推動公司永續發展、達成 ESG 目標、提升公司聲譽與競爭力、吸引關注永續發展的合作夥伴與投資人。

4.其他應記載事項：

- (1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
- (2)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無
- (3)薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於成員意見之處理：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會決議之處理
113.04.18	1. 本公司 112 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 2. 本公司 113 年度經理人薪資調整。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
113.07.30	1. 推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
113.10.29	1. 通過今年度經理人年終獎金發放事項。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理
114.02.26	1. 本公司 113 年度董事酬勞與經理人員工酬勞分派。 2. 本公司 114 年度經理人薪資調整。	委員會全體成員同意通過	已按薪資報酬委員會決議結果辦理

#### (五)提名委員會之組成及運作情形

1.本公司於 108 年 10 月設置提名委員會，提名委員會之委任資格條件為整體具備經營管理、策略規劃、法律專業等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。該委員會由三名獨立董事組成，召集人暨會議主席楊泮池具備經營管理與策略規劃能力，獨立董事柯復華具備經營管理能力及產業知識，獨立董事謝穎青具備法律專業、國際市場觀等，均符合該委員會所需之專業能力。

提名委員會主要職權如下：

- (1) 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各董事及各委員會之績效評估。
- (3) 訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫。

2.本公司之提名委員會委員計 3 人

3.上屆提名委員會任期：110 年 08 月 09 日至 113 年 05 月 30 日

4.本屆提名委員會任期：113 年 05 月 30 日至 116 年 05 月 29 日

截至公開說明書刊印日為止，提名委員會 113 年度共開會 5 次，114 年度共開會 1 次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

##### 【113 年度】

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊泮池	生醫專業、經營管理、策略規劃	3	0	100%	113 年 5 月 30 日新任
委員	柯復華	科技專業、經營管理、產業知識	3	0	100%	
委員	謝穎青	法律專業、營運判斷、危機處理	3	0	100%	
召集人	陳甫彥	經營管理、策略規劃	2	0	100%	113 年 5 月 30 日卸任
委員	蔡調彰	法律專業、危機處理	2	0	100%	
委員	羅俊拔	經營管理、會計及財務分析	2	0	100%	

##### 【114 年度】

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	楊泮池	生醫專業、經營管理、策略規劃	1	0	100%	無
委員	柯復華	科技專業、經營管理、產業知識	1	0	100%	
委員	謝穎青	法律專業、營運判斷、危機處理	1	0	100%	

### 5.提名委員之討論事項與決議結果

日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會決議之處理
113.02.26	1. 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。 2. 113 年股東常會改選董事(含獨立董事)人數及董事會成員條件。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.04.18	1. 提出董事(含獨立董事)候選人建議名單。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.05.30	1. 推選第三屆提名委員會之召集人暨會議主席。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.07.25	1. 提出第六屆薪資報酬委員會委員建議名單。	委員會全體成員因利害關係迴避，由董事會決議。	已按董事會決議結果辦理
113.10.29	1. 通過辦理 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
114.02.26	1. 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>本公司永續發展組織架構以董事會為最高指導層級，總經理室為最高管理階層，監督永續發展各面向(經濟、環境、社會以及公司治理)關鍵議題推展的進程，並於總經理室轄下編制永續發展中心，由各部門專人代表擔任永續發展委員，自2008年起持續推動公司治理、研發創新、人才培育與發展、環境永續與社會多元共融等各項永續發展議題，每季至少一次召開跨部門永續精進會議，並至少一年一次將執行情形呈報董事會。</p> <p>2024年永續發展實施成效，已於2024年10月30日向董事會報告。董事會針對包含1. 瑞昱永續發展實踐成果、2. 執行利害關係人溝通情形、3. 誠信經營推動及運作情形、4. 2024年風險管理執行情形報告等議案，進行督導且議定通過，並將持續檢視各項永續發展策略及方案執行情形，善盡董事會督導責任。</p> <p>在永續發展的未來，瑞昱將持續努力實踐1. 堅持永續目標與誠信正直、2. 落實綠能政策與環境責任、3. 永續人才發展與安全環境、4. 積極合作服務與品質要求、5. 創新研發讓世界豐富便利、6. 持續精進溫暖更多人的心等六項目標和承諾，並精進本公司ESG綜合發展策略。</p>	—
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>本公司為落實公司治理義務與維護永續經營目標，及掌握公司營運可能面臨之經濟、社會(人群)與環境等內外部風險，依重大性分析程序進行風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。</p> <p>風險管理組織架構以董事會為風險管理之最高治理單位、審計委員會為本公司風險管理之最高監督單位，由風險管理中心負</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>責風險管理推動與執行，此外，隸屬於董事會之獨立稽核單位負責實施內部稽核，確保風險管理制度得以持續有效實施。</p> <p>我司的風險管理範疇包含策略佈局、營運管理、財務運作以及危害事件等風險，同時納入氣候變遷相關風險，我們參考 ERM (Enterprise risk management) 企業風險管理程序，風險管理中心透過風險辨識、風險衡量、風險監控、風險回應、風險報告與揭露等管理程序，每年定期執行系統性的風險評估與鑑別機制，篩選出風險管理議題，監測潛在風險並實行預防措施，確保我司持續營運、降低風險可能造成之衝擊。</p> <p>各營運單位依據風險管理辦法及程序，匯整 2024 年各類風險管理執行情形，作為風險管理中心分析、辨識依據，鑑別出與公司密切相關的重大風險議題。</p> <p>風險管理執行及運作情形</p> <p>本公司依風險類型由各營運單位執行風險管理措施，並落實全員全面風險控管和防範，以有效作好風險管理，各營運單位提交風險管理資訊予風險管理中心。對於影響公司營運或永續發展之重大潛在風險，定期(每年至少一次)由風險管理中心呈報至審計委員會及董事會報告，作為風險管理監督與指導之依據。2024 年 7 月因應主管機關之上市上櫃公司風險管理實務守則修訂要求，風險管理中心提報董事會及審計委員會通過修訂風險管理辦法，並於 10 月提報重大風險議題及結果。本年度審計委員會及董事會已針對風險管理中心所提出之相關風險管理議題進行 2 次監督及指導，落實公司整體營運風險管理。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制</p>	✓		<p>本公司於 2006 年通過環境管理系統 ISO14001 驗證及取得證書；並於 2023 年 10 月完成 ISO14001 換證外部稽核(有效期為</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
度？			2023/10/12-2026/10/12)，持續落實環境管理系統化與實踐環境永續之目標前進。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司於2023年通過新竹一廠能源管理系統ISO50001驗證及取得證書；並於隔年2024年10月完成新竹二廠驗證並更新證書(有效期為2023/11/23-2026/11/22)，持續提升能源使用效率與朝向淨零減排之目標前進。	—
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司參考「氣候相關財務揭露建議」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構中，關於治理、策略、風險管理及指標和目標等四個核心要素，進行氣候變遷所帶來的潛在風險與機會之鑑別，全面性的檢視氣候變遷對於瑞昱企業營運可能造成的影響，擬定因氣候變遷的因應措施並執行推動，使各項氣候變遷影響能夠有效地被監測、控制與迅速因應。相關的評估結果及所採取的因應措施，皆公佈在當年度之ESG報告書中。	—
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>本公司重視環境與生態永續發展，自 2019 年起開始自主溫室氣體盤查，揭露年度溫室氣體排放量。</p> <p>在管理政策方面制定再生能源使用比例於 2025 達成 10%、2030 達成 50%、2050 達成 100%。並且瑞昱每年持續檢視廠區能源消耗數據，針對電力、空調、空壓、IT 機房進行評估盤查，並提出相關優化管理計劃，例如汰舊換新節能機種、更新成 LED 照明、雨水回收再利用等多項措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 節電量：2023 年度與 2024 年度分別節電 355.8 及 346.4 萬度。</li> <li>● 溫室氣體盤查：2023 年度與 2024 年度分別產生 31,032 與 28,611 公噸。2024 年度溫室氣體盤查尚未完成外部查證，目前顯示數據為集團內部統計之結果，完整確信資訊將於</li> </ul>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>永續報告書中揭露。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 用水量：2023 年度與 2024 年度分別使用 70.12 及 97.69 百萬公升。</li> <li>● 廢棄物總重量：2023 年度與 2024 年度分別產出 632.78 及 659.65 公噸。</li> </ul>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>我司恪守全球各營運據點所在地之勞動相關法規，保障員工合法權益，參考《國際人權法典》、《聯合國全球盟約》、國際勞工組織所頒布的《工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所公布之人權保護精神與基本原則，並依循《負責任商業聯盟行為準則》指標及精神，訂定《瑞昱半導體人權政策》以及《瑞昱半導體勞動政策》，揭發及落實人權相關議題之政策與承諾、目標、減緩措施和申訴管道等，並在員工訓練課程及主管職人員講習會中宣導。2024 年人權政策相關教育訓練課程包含新人訓練活力營課程(100%參與)以及主管職人員講習會等，總授課時數為 149.9 小時。充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴地對待及尊重所有同仁，包含正式員工及約聘人員等。</p>	—
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓		<p>訂定及實施合理之薪酬政策：</p> <p>本公司及從屬子公司員工之薪酬組成包括固定薪資、年節獎金、績效獎金與員工酬勞等，依據當地行業薪資水準釐薪及建立與經營績效相連結之機制，提供合理且具競爭力的薪酬，並依據員工擔任之職務與工作績效等，執行薪酬調整與核給績效獎金。本公司及從屬子公司致力於實現職場多元化與平等，提供所有員工平等的薪酬與晉升機會，不因性別、種族、膚色、宗教、婚姻狀況等因素而有差別待遇。對於包括薪資標準與計算方式、勞工保險、工作時間、休息、休假、退休金等，亦均</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>遵循當地勞動相關法規，以保障員工合法權益。</p> <p>經營績效或成果適當反映於員工薪酬：</p> <p>本公司及從屬子公司除定期依據行業薪資水準調整員工薪酬，並將公司經營績效(包括 ESG 績效)與員工薪酬連結，實現員工分享公司利潤之原則。透過主管與員工日常溝通及定期績效考核，促進雙方共同建立目標共識及確認績效回饋，並依據績效考核結果核定調薪、獎金與員工酬勞等，藉以激勵員工與公司共同成長。</p> <p>為落實將公司經營績效反映於員工薪酬並維持員工薪酬競爭力，本公司除按經營績效提列績效獎金，並依據公司章程，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一作為員工酬勞，且員工酬勞分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。本公司 2023 年非擔任主管職務之全時員工平均薪資為 3,149 仟元，相較台灣半導體業上市公司之平均薪資為 1,745 仟元，高出 80%，顯見本公司員工薪酬不僅具競爭力，且與經營績效適當連結。</p> <p>本公司另訂定及實施合理之員工福利措施，包含員工薪酬、職場多元化與平等、休假制度、各項津貼、禮金與補助等，亦制訂合理薪資報酬政策。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>本公司提供員工安全與健康之工作環境，每年依法檢測作業環境測定二次，以及優於法令每年定期實施在職員工健康檢查及每月健康教育宣導，並每年實施緊急應變消防演練。已於 2024 年完成 ISO45001 職業安全衛生系統更新換證稽核。2024 年度並無職災事件，也無火災及死傷事件。</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		瑞昱教育訓練體系由瑞昱企業大學六大學院建構而成，提供多元/即時且發展藍圖完善之專業教育訓練，促進同仁積累各項創新研發、組織發展與各領域管理知識，並且依據職務需求、技術領域和專業背景，規劃出同仁專屬的職涯發展課程計畫，提升各項員工專業職能、管理職能，積極培育內部接班人才，創造組織與人才雙贏適配度，持續全面強化組織競爭力。2024 年度職涯訓練共計 33,525 人次完成，總時數為 100,313 小時，員工平均受訓時數為 18.9 小時，其餘相關員工培訓計畫和實施情形亦揭露於當年度 ESG 報告書中。	—
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<p>本公司重視客戶關係，對於客戶關係的信念是持續建構深具競爭力的品質管理系統，為客戶提供最高品質之產品及服務，同時，為滿足客戶需求，無論是創新開發、設計、產品推廣或銷售等環節，消費性產品皆依循 ISO9001 品質管理系統之要求，車規產品則依循 IATF16949，或需符合功能安全要求之 ISO26262 等車用品質管理系統要求，以流程導向自我監控與評核，持續深化客戶穩健品質與信賴關係。</p> <p>本公司通過 ISO14001 環境管理系統驗證，善盡對地球保護之責任，針對產品生產所採用的原物料設定嚴格的標準(例如: EU RoHS(2011/65/EU) &amp; REACH regulation (EC) No.1907/2006)，並恪遵國際倡議組織對環境及品質設立之各項標準，避免產品含有對人體健康有害、或造成對環境危害影響的成份。</p> <p>本公司通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統驗證，建構職業安全衛生之工作環境，以保護及改善職業工作之安全衛生，以建構健康幸福職場。</p> <p>本公司持續通過 ISO17025 實驗室品質管理系統驗證，強化品質管理，並透過提高與確保 IC 產品耐用性延長產品的使用壽命，</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>減少生產資源使用，並透過各項可靠性測試流程，在出貨前嚴格檢測產品功能，模擬消費者可能使用之情境，設計嚴格的測試方式，分析裝置在各種狀態下的耐受情況，並反覆實驗與提出解決方案，以確保達到耐用延長壽命目標。此外，我們也關注客戶及消費者回饋，設計特定的測試計畫，使產品品質更臻完善、穩定。</p> <p>本公司為保護客戶個資及隱私，由資通安全委員會及資安中心，依據『資通安全風險管理架構』，定期進行個資及隱私相關資安風險鑑別及提出因應措施，並監督及審查資安控制措施的落實與執行。</p> <p>相關產品與服務政策可參閱年度ESG永續報告書。</p>	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>本公司致力於履行供應鏈管理責任，促進供應鏈夥伴擁有安全的工作環境，確保員工受到尊重並獲得有尊嚴的對待，並推動環境保護與遵守道德規範。我們依據國際標準，如責任商業聯盟準則、「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」、以及「世界人權宣言」，訂定供應商行為準則，要求供應商在勞工、健康與安全、環境、道德規範及管理體系等五大面向達成標準，並完全遵循企業營運所在地的法律法規。此外，瑞昱不僅持續加強現有供應商的永續管理，也在導入新供應商時，要求其簽署瑞昱供應商行為準則，或提供其自身制定的企業行為準則、責任商業聯盟準則與無衝突礦產聲明，以確保責任供應鏈管理的落實。更多供應商管理政策詳見當年度 ESG 報告書。</p>	—
五、 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<p>本公司依循全球永續性報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）發布之最新版 GRI 準則（GRI Universal Standards 2021）編撰發行永續報告書，揭露涵蓋經營績效、公</p>	—

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			司治理、利害關係人議合、社會參與、環境保護、友善職場、員工關懷等重大議題的經營成果。2023 年度瑞昱永續報告書亦通過台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD) 外部查證，確定符合 GRI Standards (2021)與 AA1000 AS v3 中度保證(Type I)。	
<p>六、 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」制定瑞昱永續發展實務守則，其運作情形與永續發展實務守則之精神及原則一致。</p>				
<p>七、 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 我司規劃「瑞昱慈善公益暨共好永續三年期計劃」，建構五大主題推動目標項目群包含：兒少成長與婦幼安全關懷專案、偏鄉教育發展與成長關懷專案、社會互助共好有善行動力專案、學術研究與社會機構贊助專案、瑞昱遠瞻未來暨創造力希望工程行動專案，作為我司公益行動指引原則，使我司更具主動性、系統性及永續性地推動與投入社會公益之永續經營與發展。</p>				

(七)公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	瑞昱的永續組織架構以董事會為最高指導層級，總經理室為最高管理階層，負責監督ESG(環境、社會、公司治理)各面向重大主題推展的進程並責成廠務團隊進行TCFD風險評估流程作業。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	氣候風險與機會對財務主要影響為空調成本的增加、上游供應商轉型成本、增設太陽能發電設施之成本花費，以及永續議題的管理和溝通成本。關於各項氣候議題造成的短、中、長期財務影響，經過量化評估後均小於營收淨額的1%。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	關於各項氣候議題造成的短、中、長期財務影響，經過量化評估後均小於營收淨額的1%。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	瑞昱的風險管理範疇包含策略佈局、營運管理、財務運作以及危害事件等風險，同時納入氣候變遷相關風險，參考ERM(Enterprise Risk Management)企業風險管理程序，透過風險辨識、風險衡量、風險監控、風險回應、風險報告與揭露等管理程序，確保瑞昱持續營運、降低風險可能造成之衝擊。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	瑞昱依據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)之第六次科學評估報告(AR6)，使用「共享社會經濟路徑」(Shared Social-Economic Pathways, SSP)，採用SSP1-1.9、SSP2-4.5、SSP5-8.5等三種氣候情境進行分析。在短、中、長期的時間邊界中，選定以溫升控制在1.5°C的理想情境下，評估氣候變遷對瑞昱主要財務影響小於營收淨額的1%。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	因應氣候相關風險，瑞昱已積極布局能源轉型，於新竹營運總部屋頂建置太陽能板，2024年總裝置容量為1,005 KW，已實際發電126萬度，換算減碳量為645噸CO <sub>2</sub> e。並規劃於2025額外購買再生能源100萬度，使全集團2025年達到RE10。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	瑞昱承諾於2050年達到淨零碳排的重大目標。計畫透過持續開發低碳產品、改善設備能源效率、依據綠建築標準興建辦公大樓並取得認證、提高再生能源使用比例、落實供應鏈減碳目標管理等各項節能減碳措施，逐步降低碳排放總量，進而實現淨零排放目標。淨零目標及時程如下： ● 2030年將範疇一及範疇二產生之溫室氣體碳排放量，相較2021基準年，減少50%。

項目	執行情形
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2030年再生能源使用比例達50%，2050年達100%。</li> <li>● 2050年達成淨零排放目標。</li> </ul> <p>此外，瑞昱持續建置屋頂型太陽能板，已於2024年實際發電130萬度，可取得再生能源憑證(RECs)1,300張。並預計2025年總裝置容量將達1,549KW，預估每年可取得再生能源憑證1,800張。</p>
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	瑞昱通過第三方公正單位英國標準協會確信驗證，其2023年財報範圍內含國內外共16據點所產生之範疇一、範疇二碳排放數據屬於合理保證等級。

## 2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額100億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額50億元以上未達100億元之公司 <input type="checkbox"/> 資本額未達50億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

年度	範疇一、排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)			範疇二、排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)			密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)	
	母公司	子公司	合計	母公司		子公司		
2023	1,143.57	889.50	2033.07	26,074.04		2,924.89	28,998.93	0.286
2024	654.92	707.54	1,362.46	Market-Based	25,149.62	2,098.82	27,248.44	0.252
				Location-Based		4,896.05		
年度	確信機構	確信情形說明						
2023	BSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The Greenhouse Gas Emissions with Realtek Semiconductor Corporation for the period from 2023-01-01 to 2023-12-31 was verified and validated.</li> <li>● The verified organization-level greenhouse gas emissions include direct greenhouse gas emissions 2,033.07 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy 28,998.93 tonnes of CO<sub>2</sub> equivalent.</li> <li>● Realtek Semiconductor Corporation has defined and explained its own process and pre-determined criteria for significance of indirect Greenhouse Gas Emissions and quantify and report these identified significant emissions accordingly.</li> </ul>						

2024		<ul style="list-style-type: none"> <li>● The Greenhouse Gas Emissions with Realtek Semiconductor Corporation for the period from 2024-01-01 to 2024-12-31 was verified and validated.</li> <li>● The verified organization-level greenhouse gas emissions include direct greenhouse gas emissions 1,362.46 tonnes of CO2 equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy 27,248.44(MBS) and 30,045.67(LBS) tonnes of CO2 equivalent.</li> <li>● Realtek Semiconductor Corporation has defined and explained its own process and pre-determined criteria for significance of indirect Greenhouse Gas Emissions and quantify and report these identified significant emissions accordingly.</li> </ul>
------	--	--

註 1：英國標準協會依照 ISO14064-1:2018 標準進行 2023 年度查驗，數據經驗證後屬於合理保證等級及協議程序(AUP)，確信意見書參閱年報第 41 頁。

註 2：因瑞昱蘇州及加州(Cortina Access)兩據點有使用再生能源或再生能源憑證進行碳排抵扣，因此範疇二應區分為 Market-Based 及 Location-Based 統計排放量。

### 3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

目標	短期	1. 2025年，全集團使用再生能源比例達10%。
	長期	1. 2030年，範疇一及範疇二碳排放量，相較2021基準年減少50%。 2. 2030年，全集團使用再生能源比例達50%。 3. 2050年，全集團使用再生能源比例達100%，並達成淨零排放(Net zero)目標。
策略	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 積極參與國際淨零排放倡議。</li> <li>2. 持續開發低碳產品。</li> <li>3. 改善設備能源效率。</li> <li>4. 興建辦公大樓取得綠建築標章。</li> <li>5. 提高再生能源使用比例。</li> <li>6. 供應鏈減碳目標管理。</li> </ol>	
具體行動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於2024年加入國際科學減碳倡議(SBTi)，簽屬commitment letter表示企業減碳決心。</li> <li>2. 2023年財報範圍內含國內外共16據點通過溫室氣體盤查ISO14064外部查證。</li> <li>3. 於2023年取得新竹一廠能源管理ISO50001認證，並於2024年將其認證範圍擴大至新竹二廠。</li> <li>4. 生醫一廠辦公大樓，於2022年已取得臺灣綠建築「黃金級」候選證書。</li> <li>5. 新竹三廠於2023年取得臺灣綠建築「銅級」認證。</li> <li>6. 新竹三廠於2023年獲美國綠建築LEED「金級」證書。</li> <li>7. 於2024年完成新竹一廠前棟及停車棟屋頂型太陽能版，裝置容量共計1,005KW。一廠後棟屋頂太陽能板也預計於2025年完工，屆時總裝置容量將達1,549KW。</li> <li>8. 大陸蘇州廠於2024年開始全面使用綠電，預計購買相關再生能源憑證約4,000張。</li> <li>9. 於2024年導入ISO14067產品碳足跡管理，將產品分為高功率及低功率兩類並通過外部查證。</li> </ol>	
減碳成效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新竹一廠2024年總用電量為36,830,400度，相較前一年度降低1,608,000度。</li> <li>2. 2024年新竹一、二廠總節電率達6.17%，節電量3,463,903度，相當於降低碳排放量1,711噸CO<sub>2</sub>e。</li> <li>3. 新竹一、二、三廠屋頂太陽能發電系統於2024年實際發電1,322,169度。</li> </ol>	

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、 訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		本公司已經董事會通過訂定誠信經營政策、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等誠信經營相關規章，並揭露於公司網站公司治理專區供董事、經理人及全體員工作為誠信經營之遵循。	—
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		本公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、全體同仁行為準則、瑞昱內(外)部人員檢舉不合法不道德行為之處理辦法等誠信經營相關規章，已涵蓋不誠信行為風險之評估機制及防範不誠信行為方案。	—
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		本公司誠信經營作業程序及行為指南已明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並由內部稽核單位查核防範方案遵循情形，並於必要時提出檢討。	—
<p>二、 落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		本公司定期對供應商及往來客戶實施品質及信用評等。對於未通過評等之往來對象，將移出合作名單。	—
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓		本公司由管理處負責推動企業誠信經營，偕同相關單位負責執行，並由內部稽核單位獨立負責稽查事務，確保公司誠信經營理念之落實，且至少一年一次將執行情形呈報董事會。(已於113年10月30日向董事會報告)	—

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則與員工行為準則已涵蓋防止利益衝突政策及陳述管道，供董事、經理人與全體員工遵循。	—
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司已依各項法規訂定會計制度、內部控制制度與內部稽核制度。稽核人員每年依不誠信行為風險之評估結果，擬訂稽核計畫查核防範不誠信行為方案之遵循情形，並定期於董事會報告。	—
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司訂有誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、全體員工行為準則及瑞昱內(外)部人員檢舉不合法不道德行為之處理辦法等相關辦法，並公佈於瑞昱企業網站上提供董事、員工及利害關係人瞭解。 另外，本公司持續對同仁及主管職人員進行誠信經營與道德行為等相關教育訓練，內容包含公司誠信經營相關政策、員工道德行為準則及不道德行為之通報協助管道等，確實向同仁宣導公司誠信經營理念並落實於日常工作中。113年度誠信經營相關教育訓練總授課時數為 223.75小時，共 1,045 人次參與相關課程。	—
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司董事會通過訂定「瑞昱內(外)部人員檢舉不合法不道德行為之處理辦法」，建立檢舉管道及指定受理單位如下： 1. 受理單位：本公司管理階層、內部稽核主管、相關單位或本公司提供之通報管道。 2. 稽核單位通報信箱：audit@realtek.com	—
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司誠信經營作業程序及行為指南、瑞昱內(外)部人員檢舉不合法不道德行為之處理辦法已涵蓋受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。	—

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>1. 受理原則： 通報案件有下列情形之一者，概不受理： 一、 匿名或以不真實姓名通報，且未提供聯繫資料者。 二、 通報案件未提供可資調查之證據者。</p> <p>2. 調查程序： 一、 受理及查證： 受理單位通知內部稽核部門組成通報事件調查及審議小組，應即刻查明相關事實，必要時由相關部門提供協助，並應於受理日起90日內完成調查；若須超過90日，則須呈報總經理裁示是否得延長查證時間。 二、 處置與紀錄留存： 如經證實被通報人確有違反情事，通報事件調查及審議小組應立即要求被通報人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償。通報受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年。 三、 改善與預防管理、呈報： 通報事件調查及審議小組應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善與預防管理措施。內部稽核部門應將通報情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>3. 保密機制： 承辦通報案件之相關人員應嚴格保密通報人之身分及通報事項內容。</p>
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		<p>本公司對於檢舉人採取必要之保護措施，承諾本公司員工不因檢舉而遭受不當處置之措施。</p> <p style="text-align: center;">—</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等相關規章，及誠信經營執行和運作情形內容，均揭露於公司網站、公開資訊觀測站，並落實執行。	—
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營政策、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則、員工行為準則、瑞昱內(外)部人員檢舉不合法不道德行為之處理辦法等誠信經營相關規章，其運作與所定規章並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法等政府相關法令，落實公司誠信經營。				

(九) 公司治理守則及相關規章之揭露查詢方式：本公司公司治理實務守則與相關規章可於公司網站公司治理專區或公開資訊觀測站查詢。

(十) 最近年度及截至本公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無

(十一) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：本公司依規定即時揭露重大訊息，並定期召開法人說明會說明財務業務相關資訊。

附件一  
限制員工權利新股之發行辦法

## 瑞昱半導體股份有限公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法

第一條：發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之關鍵優秀人才，激勵員工達成公司營運目標，創造更高之公司及股東利益，依據公司法第二六七條及金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則)等相關規定，訂定本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法(以下簡稱本辦法)。

第二條：發行期間

於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

第三條：員工資格條件及發放審核程序

- (一) 適用對象以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司全職員工，達一定績效表現且至少符合下列原則之一者：
  1. 與公司未來策略發展高度相關
  2. 對公司營運具重大影響性
  3. 關鍵核心技術人才。
- (二) 具獲配資格之員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考等之因素等擬定分配標準，由董事長核定獲配名單及股數提報董事會同意。惟具本公司董事或經理人身分之員工，應先經薪資報酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。
- (三) 單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計其累計被給予本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主管機關規定辦理。

第四條：發行總額

發行普通股共計 2,700,000 股，每股面額 10 元，發行總額為新台幣 27,000,000 元。

第五條：發行條件

- (一)發行價格：採無償發行新股方式，每股發行價格 0 元。
- (二)發行股份之種類：本公司普通股。
- (三)既得條件：

1. 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成所屬公司所設定個人績效評核指標與本公司營運目標；既得期間為三年，於各年度既得日之既得比率如下：
  - (1) 屆滿一年得既得 33% 股份
  - (2) 屆滿二年得既得 33% 股份
  - (3) 屆滿三年得既得 34% 股份
2. 個人績效評核指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達 A+（含）以上。
3. 公司營運目標：以稅前淨利率、股東權益報酬率及 ESG 為績效指標，各項指標所佔權重及目標條件如下表說明。各項指標分別設定目標值，達成目標值之各項指標，其該年度既得股數係各自以對應之權重比例計算，未達目標值之各項指標，其該年度既得股數之對應權重比例則為 0%。績效指標年度係指既得日前最近一期經會計師查核年度財務報表之會計年度，績效指標則以指標要求期間所對應經會計師查核簽證之合併財務報表為計算基礎。

績效指標	權重	目標
稅前淨利率	30%	高於公司前三年稅前淨利率平均值
股東權益報酬率	30%	高於公司前三年股東權益報酬率平均值或特選臺灣 IC 設計產業代表報酬指數權重前十大成分股股東權益報酬率平均值
ESG	40%	MSCI 年度 ESG 評級為 BBB(含)以上 (註)

註:衡量 MSCI 年度 ESG 評級之年度與稅前淨利率及股東權益報酬率之績效指標年度相同。

#### (四) 員工未達既得條件之處理

1. 員工有自願離職、解雇、資遣之情事：如有未達既得條件之限制員工權利新股，於事實發生日起喪失其既得權利，其股份本公司全數無償收回並予以註銷。
2. 員工因受職業災害致殘疾或一般死亡者：
  - (1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股可於離職時既得，惟針對已確認本公司績效指標與個人績效評核指標達成程度者，可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認本公司績效指標與個人績效評核指標達成程度者，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。
  - (2) 一般死亡者，尚未既得之限制員工權利新股，於死亡發生當日視為既得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。

惟若員工死亡時，針對已確認本公司績效指標與個人績效評核指標達成程度者，可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認本公司績效指標與個人績效評核指標達成程度者，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。

3. 員工辦理留職停薪者：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響，仍需依本辦法所定；惟各年度可既得之實際股份，除本辦法所定既得條件外，需再依員工於各營運目標年度之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，將由本公司無償收回其尚未既得之限制員工權利新股並辦理註銷。
4. 員工辦理退休者：其尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響，仍需依本辦法所定；惟各年度可既得之實際股份，除本辦法所定既得條件外，需再依員工於各營運目標年度之實際在職月數比例計算之。
5. 員工於獲配權利新股後，未同時達成公司營運目標和激勵對象個人績效評核指標，就其未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。
6. 員工於獲配權利新股後，違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定時，公司有權就其之前獲配尚未既得之股份予以收回並註銷。
7. 若有員工對公司貢獻卓著等特殊情形，在終止僱傭關係時，其尚未既得之限制員工權利新股視為達成既得條件或未符既得條件與可得既得比例，授權董事長依實際狀況個別核定，惟具本公司董事或經理人身份之員工應先經薪酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意。
8. 若本公司依企業併購法進行組織調整，其尚未既得之限制員工權利新股視為達成既得條件或未符既得條件與可得既得比例，由董事會核定。
9. 所有未達成既得條件之股票，全數由本公司無償予以收回並註銷。

第六條： 未達既得條件前股份權利受限情形：

- (一) 除繼承外，員工不得將所獲配新股於未達既得條件前出售、質押、轉讓、贈與他人、設定或作其他轉讓處分。
- (二) 獲配之限制員工權利新股於未達既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。
- (三) 獲配之限制員工權利新股於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。
- (四) 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所訂股東會停止過戶期

間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。

第七條：其他約定事項

- (一)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
- (二)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。

第八條：簽約與保密

- (一)獲配限制員工權利新股之員工需依公司承辦單位通知完成簽署「限制員工權利新股受領同意書」與辦理相關信託保管程序後，方可視為取得限制員工權利新股。未依規定完成相關文件簽署者，視同放棄限制員工權利新股。
- (二)員工與任何經本辦法取得限制員工權利新股及衍生權益之所有人皆應遵守本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定，違者視為未達既得條件；且應遵守公司薪資保密規定，不得探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關內容及數量、或將本案相關內容及個人權益告知他人，若有違反之情事，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股予以無償收回並辦理註銷。

第九條：稅賦

依本辦法所獲配之限制員工權利新股其相關之稅賦，按當時受配股票員工所在國家適用之相關法令規定辦理。

第十條：其他重要事項

- (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並提報股東會決議通過後向主管機關申報生效後執行。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
- (二)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

附件二  
會計師複核之案件檢查表彙總意見

瑞昱半導體股份有限公司申報案件檢查表  
會計師複核彙總意見

瑞昱半導體股份有限公司本次為發行限制員工權利新股普通股 2,700,000 股，每股面額新臺幣 10 元，總額新臺幣 27,000,000 元，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下簡稱處理準則）規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，瑞昱半導體股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

瑞昱半導體股份有限公司

資誠聯合會計師事務所

會計師 李典易



中華民國 114 年 6 月 23 日

附件三

112 年度合併財務報表及會計師查核報告

會計師查核報告

(113)財審報字第 23002885 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

瑞昱半導體股份有限公司及子公司（以下簡稱「瑞昱集團」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達瑞昱集團民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與瑞昱集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞昱集團民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

瑞昱集團民國 112 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## **存貨之評價**

### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五、(二)；存貨會計項目說明，請詳合併財務報表附註六、(六)。

瑞昱集團主要係研究、開發、製造、銷售各種積體電路及相關應用軟體，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量。由於存貨金額重大且該等存貨因產業市場變遷快速，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。因此本會計師對瑞昱集團之存貨評價列為查核重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡分類之正確性。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。

## **其他事項 - 個體財務報告**

瑞昱半導體股份有限公司已編製民國 112 年度及 111 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

## **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估瑞昱集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瑞昱集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞昱集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瑞昱集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瑞昱集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瑞昱集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於瑞昱集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瑞昱集團民國 112 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

鄭雅慧

李典易  
鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 10,268,291	11	\$ 13,754,035	12
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		948,832	1	1,563,287	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動		32,373,191	34	41,595,837	37
1170	應收帳款淨額	六(五)	10,663,065	11	9,418,440	8
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七	2,093,922	2	2,594,245	2
1200	其他應收款		616,624	1	488,769	-
130X	存貨	六(六)	11,756,934	13	25,552,543	23
1410	預付款項		566,761	1	524,525	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>69,287,620</u>	<u>74</u>	<u>95,491,681</u>	<u>84</u>
<b>非流動資產</b>						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—非流動		53,000	-	358,145	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		3,126,098	3	3,099,759	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)及八				
	流動		5,509,030	6	618,481	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	131,794	-	170,671	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	8,754,486	9	7,556,636	7
1755	使用權資產	六(九)	1,767,795	2	1,537,328	1
1760	投資性不動產淨額	六(十)	33,878	-	38,416	-
1780	無形資產	六(十一)	2,624,598	3	2,413,195	2
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	337,312	1	132,978	-
1900	其他非流動資產	九	2,189,659	2	2,283,237	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>24,527,650</u>	<u>26</u>	<u>18,208,846</u>	<u>16</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 93,815,270</u>	<u>100</u>	<u>\$ 113,700,527</u>	<u>100</u>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112 年 12 月 31 日		111 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十二)	\$	4,250,000	5	\$	13,737,994	12
2130	合約負債—流動	六(二十一)		336,648	-		117,752	-
2170	應付帳款			6,904,009	7		10,340,079	9
2180	應付帳款—關係人	七		369,104	-		156,296	-
2200	其他應付款	六(十三)		24,513,037	26		27,684,495	25
2220	其他應付款項—關係人	七		60,293	-		90,401	-
2230	本期所得稅負債			1,764,021	2		1,379,985	1
2280	租賃負債—流動			139,213	-		78,446	-
2300	其他流動負債	六(二十一)		7,909,427	9		8,959,279	8
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>46,245,752</u>	<u>49</u>		<u>62,544,727</u>	<u>55</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十四)		2,227,346	2		1,713,316	2
2550	負債準備—非流動	六(十六)		1,392,138	2		1,287,710	1
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		203,766	-		62,725	-
2580	租賃負債—非流動			1,408,856	2		1,223,185	1
2600	其他非流動負債	六(十五)		99,250	-		105,914	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>5,331,356</u>	<u>6</u>		<u>4,392,850</u>	<u>4</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>51,577,108</u>	<u>55</u>		<u>66,937,577</u>	<u>59</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十七)		5,128,636	5		5,128,636	5
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十八)		542,048	1		1,045,147	1
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十九)		8,882,764	9		7,262,359	6
3320	特別盈餘公積			-	-		1,776,089	2
3350	未分配盈餘			24,845,272	27		28,854,826	25
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(二十)		2,829,740	3		2,686,175	2
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>42,228,460</u>	<u>45</u>		<u>46,753,232</u>	<u>41</u>
36XX	<b>非控制權益</b>			<u>9,702</u>	<u>-</u>		<u>9,718</u>	<u>-</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>42,238,162</u>	<u>45</u>		<u>46,762,950</u>	<u>41</u>
<b>重大承諾事項及或有事項</b>								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九	\$	<u>93,815,270</u>	<u>100</u>	\$	<u>113,700,527</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
 合併綜合損益表  
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度		111 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 95,179,276	100	\$ 111,789,791	100
5000 營業成本	六(六)及七	( 54,431,219)	( 57)	( 57,154,955)	( 51)
5950 營業毛利淨額		<u>40,748,057</u>	<u>43</u>	<u>54,634,836</u>	<u>49</u>
營業費用	六(二十六) (二十七)及七				
6100 推銷費用		( 3,864,715)	( 4)	( 4,724,569)	( 4)
6200 管理費用		( 3,768,586)	( 4)	( 4,138,151)	( 4)
6300 研究發展費用		( 26,434,295)	( 28)	( 30,081,533)	( 27)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 25,469)	-	33,415	-
6000 營業費用合計		( 34,093,065)	( 36)	( 38,910,838)	( 35)
6900 營業利益		<u>6,654,992</u>	<u>7</u>	<u>15,723,998</u>	<u>14</u>
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(二十二)	2,581,961	3	950,676	1
7010 其他收入	六(二十三)	203,976	-	388,919	-
7020 其他利益及損失	六(二十四)	398,354	-	96,732	-
7050 財務成本	六(二十五)	( 247,459)	-	( 217,743)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	( 47,189)	-	( 20,723)	-
7000 營業外收入及支出合計		<u>2,889,643</u>	<u>3</u>	<u>1,197,861</u>	<u>1</u>
7900 稅前淨利		9,544,635	10	16,921,859	15
7950 所得稅費用	六(二十八)	( 391,797)	-	( 717,715)	( 1)
8200 本期淨利		<u>\$ 9,152,838</u>	<u>10</u>	<u>\$ 16,204,144</u>	<u>14</u>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金	額	%	金	額	%
<b>其他綜合損益</b>	六(二十)						
<b>不重分類至損益之項目</b>							
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)					
		(\$	123,789)	-	(\$	988,964)	( 1)
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>							
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		283,799	-	5,451,229	5	
8300	<b>其他綜合損益(淨額)</b>		\$ 160,010	-	\$ 4,462,265	4	
8500	<b>本期綜合損益總額</b>		\$ 9,312,848	10	\$ 20,666,409	18	
淨利歸屬於：							
8610	母公司業主		\$ 9,152,772	10	\$ 16,204,052	14	
8620	非控制權益		66	-	92	-	
			\$ 9,152,838	10	\$ 16,204,144	14	
綜合損益總額歸屬於：							
8710	母公司業主		\$ 9,312,782	10	\$ 20,666,317	18	
8720	非控制權益		66	-	92	-	
			\$ 9,312,848	10	\$ 20,666,409	18	
<b>基本每股盈餘</b>							
	六(二十九)						
9750	本期淨利		\$	17.85	\$	31.62	
<b>稀釋每股盈餘</b>							
	六(二十九)						
9850	本期淨利		\$	17.59	\$	30.48	

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併權益變動表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於母公司的業主之權益					其他權益			非控制權益	權益總額
	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	綜合損益		
<b>111 年 度</b>										
111年1月1日餘額	\$ 5,106,849	\$ 1,101,079	\$ 5,577,083	\$ 1,556,049	\$ 27,377,681	(\$ 4,156,871)	\$ 2,380,781	\$ 38,942,651	\$ 9,673	\$ 38,952,324
本期淨利	-	-	-	-	16,204,052	-	-	16,204,052	92	16,204,144
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,451,229	( 988,964)	4,462,265	-	4,462,265
本期綜合損益總額	-	-	-	-	16,204,052	5,451,229	( 988,964)	20,666,317	92	20,666,409
<b>110 年度盈餘指撥及分派</b>										
法定盈餘公積提列	-	-	1,685,276	-	( 1,685,276)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積提列	-	-	-	220,040	( 220,040)	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	( 12,821,591)	-	-	( 12,821,591)	-	( 12,821,591)
員工酬勞轉增資	21,787	969,551	-	-	-	-	-	991,338	-	991,338
資本公積配發現金	-	( 1,025,727)	-	-	-	-	-	( 1,025,727)	-	( 1,025,727)
現金股利返還	-	244	-	-	-	-	-	244	-	244
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	( 47)	( 47)
111年12月31日餘額	\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$ 28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$ 46,753,232	\$ 9,718	\$ 46,762,950
<b>112 年 度</b>										
112年1月1日餘額	\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$ 28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$ 46,753,232	\$ 9,718	\$ 46,762,950
本期淨利	-	-	-	-	9,152,772	-	-	9,152,772	66	9,152,838
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	283,799	( 123,789)	160,010	-	160,010
本期綜合損益總額	-	-	-	-	9,152,772	283,799	( 123,789)	9,312,782	66	9,312,848
<b>111 年度盈餘指撥及分派</b>										
法定盈餘公積提列	-	-	1,620,405	-	( 1,620,405)	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	( 1,776,089)	1,776,089	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	( 13,334,455)	-	-	( 13,334,455)	-	( 13,334,455)
資本公積配發現金	-	( 512,864)	-	-	-	-	-	( 512,864)	-	( 512,864)
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	9,549	-	-	-	-	-	9,549	-	9,549
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	16,445	-	( 16,445)	-	-	-
現金股利返還	-	216	-	-	-	-	-	216	-	216
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	( 82)	( 82)
112年12月31日餘額	\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	\$ 9,702	\$ 42,238,162

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 9,544,635	\$ 16,921,859
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十六)	1,308,355	1,176,920
攤提費用	六(十一)		
	(二十六)	1,716,487	1,627,409
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	25,469	( 33,415 )
利息費用	六(二十五)	247,459	217,743
利息收入	六(二十二)	( 2,581,961 )	( 950,676 )
股利收入	六(二十三)	( 33,337 )	( 60,741 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨(利益)損失	六(二)(二十四)	( 81,860 )	180,983
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	六(七)	47,189	20,723
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十四)	( 5,275 )	( 1,132 )
處分投資利益	六(二十四)	( 305,599 )	-
租賃修改利益	六(二十四)	-	( 24 )
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動		692,017	220,475
應收帳款		( 1,267,400 )	3,404,506
應收帳款-關係人		497,629	605,229
其他應收款		15,161	( 139,755 )
存貨		13,795,609	( 9,003,831 )
預付款項		( 42,236 )	135,358
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		218,896	( 93,348 )
應付票據		-	( 3,276 )
應付帳款		( 3,436,070 )	( 765,489 )
應付帳款-關係人		212,808	( 178,117 )
其他應付款		( 3,893,027 )	4,350,517
其他應付款-關係人		( 30,108 )	( 10,851 )
其他流動負債		( 1,049,852 )	1,419,864
負債準備-非流動		124,713	185,080
應計退休金負債		( 3,632 )	( 4,277 )

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營運產生之現金流入		\$ 15,716,070	\$ 19,221,734
收取之利息		2,438,945	758,590
收取之股利		33,337	60,741
支付之利息		( 250,334 )	( 214,712 )
支付所得稅		( 41,732 )	( 768,184 )
營業活動之淨現金流入		<u>17,896,286</u>	<u>19,058,169</u>
<u>投資活動之現金流量</u>			
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產		309,442	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動		-	( 370,244 )
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		( 64,302 )	( 228,910 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款		18,041	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		( 50,550,558 )	( 92,296,234 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		54,981,575	98,487,508
取得不動產、廠房及設備	六(三十)	( 2,166,602 )	( 2,451,441 )
處分不動產、廠房及設備價款		15,428	1,353
取得無形資產	六(三十)	( 1,461,125 )	( 1,959,501 )
存出保證金減少(增加)		830	( 1,457,055 )
其他非流動資產減少(增加)		1,737	( 91,531 )
投資活動之淨現金流入(流出)		<u>1,084,466</u>	<u>( 366,055 )</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款舉借	六(三十一)	134,242,945	167,983,101
短期借款償還	六(三十一)	( 143,730,939 )	( 167,587,207 )
長期借款舉借	六(三十一)	511,090	711,110
租賃負債本金償還	六(三十一)	( 114,716 )	( 97,150 )
存入保證金減少	六(三十一)	( 92 )	( 892 )
現金股利及資本公積配發現金數		( 13,847,319 )	( 13,847,318 )
現金股利返還		216	244
籌資活動之淨現金流出		<u>( 22,938,815 )</u>	<u>( 12,838,112 )</u>
匯率影響數		472,319	702,682
本期現金及約當現金(減少)增加數		( 3,485,744 )	6,556,684
期初現金及約當現金餘額		13,754,035	7,197,351
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 10,268,291</u>	<u>\$ 13,754,035</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



附件四

113 年度合併財務報表及會計師查核報告

會計師查核報告

(114)財審報字第 24003274 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

瑞昱半導體股份有限公司及子公司（以下簡稱「瑞昱集團」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達瑞昱集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與瑞昱集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞昱集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

瑞昱集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

## **存貨之評價**

### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳合併財務報表附註四、(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五、(二)；存貨會計項目說明，請詳合併財務報表附註六、(六)。

瑞昱集團主要係研究、開發、製造、銷售各種積體電路及相關應用軟體，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量。由於存貨金額重大且該等存貨因產業市場變遷快速，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。因此本會計師對瑞昱集團之存貨評價列為查核重要事項之一。

### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡分類之正確性。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。

## **其他事項 - 個體財務報告**

瑞昱半導體股份有限公司已編製民國 113 年度及 112 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

## **管理階層與治理單位對合併財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估瑞昱集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瑞昱集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞昱集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

### **會計師查核合併財務報表之責任**

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瑞昱集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瑞昱集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瑞昱集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於瑞昱集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瑞昱集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

鄭雅慧

李典易

鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113年12月31日		112年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 14,812,459	13	\$ 10,268,291	11
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		7,520,809	7	948,832	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(四)				
	動		32,766,211	29	32,373,191	34
1170	應收帳款淨額	六(五)	12,305,290	11	10,663,065	11
1180	應收帳款—關係人淨額	六(五)及七	2,641,074	2	2,093,922	2
1200	其他應收款		604,664	-	616,624	1
130X	存貨	六(六)	13,506,049	12	11,756,934	13
1410	預付款項		501,451	-	566,761	1
11XX	<b>流動資產合計</b>		<b>84,658,007</b>	<b>74</b>	<b>69,287,620</b>	<b>74</b>
<b>非流動資產</b>						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—非流動		-	-	53,000	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(三)				
	之金融資產—非流動		3,340,653	3	3,126,098	3
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非	六(四)及八				
	流動		9,067,774	8	5,509,030	6
1550	採用權益法之投資	六(七)	120,646	-	131,794	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	9,610,167	9	8,754,486	9
1755	使用權資產	六(九)	1,681,636	2	1,767,795	2
1760	投資性不動產淨額	六(十)	31,121	-	33,878	-
1780	無形資產	六(十一)	2,659,135	2	2,624,598	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十八)	437,137	-	337,312	1
1900	其他非流動資產	九	2,290,454	2	2,189,659	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<b>29,238,723</b>	<b>26</b>	<b>24,527,650</b>	<b>26</b>
1XXX	<b>資產總計</b>		<b>\$ 113,896,730</b>	<b>100</b>	<b>\$ 93,815,270</b>	<b>100</b>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日		112年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十二)	\$	4,500,000	4	\$	4,250,000	5
2130	合約負債—流動	六(二十一)		413,754	-		336,648	-
2170	應付帳款			9,255,237	8		6,904,009	7
2180	應付帳款—關係人	七		328,371	-		369,104	-
2200	其他應付款	六(十三)		31,243,185	28		24,513,037	26
2220	其他應付款項—關係人	七		80,507	-		60,293	-
2230	本期所得稅負債			2,134,229	2		1,764,021	2
2280	租賃負債—流動			113,601	-		139,213	-
2300	其他流動負債	六(二十一)		9,892,091	9		7,909,427	9
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>57,960,975</u>	<u>51</u>		<u>46,245,752</u>	<u>49</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十四)		-	-		2,227,346	2
2550	負債準備—非流動	六(十六)		1,266,560	1		1,392,138	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十八)		265,722	-		203,766	-
2580	租賃負債—非流動			1,361,638	1		1,408,856	2
2600	其他非流動負債	六(十五)		84,347	-		99,250	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>2,978,267</u>	<u>2</u>		<u>5,331,356</u>	<u>6</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>60,939,242</u>	<u>53</u>		<u>51,577,108</u>	<u>55</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)		5,128,636	5		5,128,636	5
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)		287,282	-		542,048	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)		8,882,764	8		8,882,764	9
3350	未分配盈餘			32,051,651	28		24,845,272	27
其他權益								
3400	其他權益	六(二十)		6,597,430	6		2,829,740	3
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>			<u>52,947,763</u>	<u>47</u>		<u>42,228,460</u>	<u>45</u>
36XX	<b>非控制權益</b>			<u>9,725</u>	<u>-</u>		<u>9,702</u>	<u>-</u>
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>52,957,488</u>	<u>47</u>		<u>42,238,162</u>	<u>45</u>
重大承諾事項及或有事項								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九	\$	<u>113,896,730</u>	<u>100</u>	\$	<u>93,815,270</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 113,393,698	100	\$ 95,179,276	100		
5000 營業成本	六(六)及七	( 56,231,862)	( 50)	( 54,431,219)	( 57)		
5950 營業毛利淨額		<u>57,161,836</u>	<u>50</u>	<u>40,748,057</u>	<u>43</u>		
營業費用	六(二十六) (二十七)及七						
6100 推銷費用		( 4,793,105)	( 4)	( 3,864,715)	( 4)		
6200 管理費用		( 5,328,736)	( 5)	( 3,768,586)	( 4)		
6300 研究發展費用		( 33,543,624)	( 29)	( 26,434,295)	( 28)		
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	5,175	-	( 25,469)	-		
6000 營業費用合計		( 43,660,290)	( 38)	( 34,093,065)	( 36)		
6900 營業利益		<u>13,501,546</u>	<u>12</u>	<u>6,654,992</u>	<u>7</u>		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十二)	2,792,033	2	2,581,961	3		
7010 其他收入	六(二十三)	305,375	-	203,976	-		
7020 其他利益及損失	六(二十四)	71,467	-	398,354	-		
7050 財務成本	六(二十五)	( 288,398)	-	( 247,459)	-		
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	( 40,813)	-	( 47,189)	-		
7000 營業外收入及支出合計		<u>2,839,664</u>	<u>2</u>	<u>2,889,643</u>	<u>3</u>		
7900 稅前淨利		16,341,210	14	9,544,635	10		
7950 所得稅費用	六(二十八)	( 1,049,685)	( 1)	( 391,797)	-		
8200 本期淨利		<u>\$ 15,291,525</u>	<u>13</u>	<u>\$ 9,152,838</u>	<u>10</u>		
其他綜合損益	六(二十)						
不重分類至損益之項目							
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	\$ 229,072	-	( \$ 123,789)	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		3,146,510	3	283,799	-		
8300 其他綜合損益(淨額)		<u>\$ 3,375,582</u>	<u>3</u>	<u>\$ 160,010</u>	<u>-</u>		
8500 本期綜合損益總額		<u>\$ 18,667,107</u>	<u>16</u>	<u>\$ 9,312,848</u>	<u>10</u>		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 15,291,442	13	\$ 9,152,772	10		
8620 非控制權益		83	-	66	-		
		<u>\$ 15,291,525</u>	<u>13</u>	<u>\$ 9,152,838</u>	<u>10</u>		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 18,667,024	16	\$ 9,312,782	10		
8720 非控制權益		83	-	66	-		
		<u>\$ 18,667,107</u>	<u>16</u>	<u>\$ 9,312,848</u>	<u>10</u>		
基本每股盈餘	六(二十九)						
9750 本期淨利		\$ 29.82		\$ 17.85			
稀釋每股盈餘	六(二十九)						
9850 本期淨利		\$ 29.32		\$ 17.59			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
 合併權益變動表  
 民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司的業主之權益					其他權益			非控制權益	權益總額	
	附註	普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益			
<b>112 年 度</b>											
112年1月1日餘額		\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$ 28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$ 46,753,232	\$ 9,718	\$ 46,762,950
本期淨利		-	-	-	-	9,152,772	-	-	9,152,772	66	9,152,838
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	-	-	283,799	( 123,789 )	160,010	-	160,010
本期綜合損益總額		-	-	-	-	9,152,772	283,799	( 123,789 )	9,312,782	66	9,312,848
<b>111 年度盈餘指撥及分派</b>											
法定盈餘公積提列	六(十九)	-	-	1,620,405	-	( 1,620,405 )	-	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	六(十九)	-	-	-	( 1,776,089 )	1,776,089	-	-	-	-	-
股東現金股利	六(十九)	-	-	-	-	( 13,334,455 )	-	-	( 13,334,455 )	-	( 13,334,455 )
資本公積配發現金	六(十八)(十九)	-	( 512,864 )	-	-	-	-	-	( 512,864 )	-	( 512,864 )
採用權益法認列之關聯企業之變動數	六(十八)	-	9,549	-	-	-	-	-	9,549	-	9,549
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(二十)	-	-	-	-	16,445	-	( 16,445 )	-	-	-
現金股利返還	六(十八)	-	216	-	-	-	-	-	216	-	216
非控制權益變動		-	-	-	-	-	-	-	-	( 82 )	( 82 )
112年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	\$ 9,702	\$ 42,238,162
<b>113 年 度</b>											
113年1月1日餘額		\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	\$ 9,702	\$ 42,238,162
本期淨利		-	-	-	-	15,291,442	-	-	15,291,442	83	15,291,525
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	-	-	3,146,510	229,072	3,375,582	-	3,375,582
本期綜合損益總額		-	-	-	-	15,291,442	3,146,510	229,072	18,667,024	83	18,667,107
<b>112 年度盈餘指撥及分派</b>											
股東現金股利	六(十九)	-	-	-	-	( 7,692,955 )	-	-	( 7,692,955 )	-	( 7,692,955 )
資本公積配發現金	六(十八)(十九)	-	( 256,432 )	-	-	-	-	-	( 256,432 )	-	( 256,432 )
採用權益法認列之關聯企業之變動數	六(十八)	-	1,315	-	-	-	-	-	1,315	-	1,315
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(二十)	-	-	-	-	( 392,108 )	-	392,108	-	-	-
現金股利返還	六(十八)	-	351	-	-	-	-	-	351	-	351
非控制權益變動		-	-	-	-	-	-	-	-	( 60 )	( 60 )
113年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 287,282	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 32,051,651	\$ 4,724,667	\$ 1,872,763	\$ 52,947,763	\$ 9,725	\$ 52,957,488

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 16,341,210	\$ 9,544,635
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十六)	1,460,905	1,308,355
攤提費用	六(十一)		
	(二十六)	1,883,109	1,716,487
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	( 5,175 )	25,469
利息費用	六(二十五)	288,398	247,459
利息收入	六(二十二)	( 2,792,033 )	( 2,581,961 )
股利收入	六(二十三)	( 18,575 )	( 33,337 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨	六(二)(二十四)		
利益		( 79,049 )	( 81,860 )
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之	六(七)		
份額		40,813	47,189
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十四)	78	( 5,275 )
處分投資利益	六(二十四)	-	( 305,599 )
金融資產減損損失	六(二十四)	53,000	-
租賃修改利益	六(二十四)	( 146 )	-
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流			
動		( 1,998,912 )	692,017
應收帳款		( 1,636,134 )	( 1,267,400 )
應收帳款-關係人		( 548,068 )	497,629
其他應收款		10,339	15,161
存貨		( 1,749,115 )	13,795,609
預付款項		65,310	( 42,236 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		77,106	218,896
應付帳款		2,351,228	( 3,436,070 )
應付帳款-關係人		( 40,733 )	212,808
其他應付款		6,649,569	( 3,893,027 )
其他應付款-關係人		20,214	( 30,108 )
其他流動負債		1,982,664	( 1,049,852 )
負債準備-非流動		( 209,601 )	124,713
應計退休金負債		( 2,404 )	( 3,632 )

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
營運產生之現金流入	\$ 22,143,998	\$ 15,716,070
收取之利息	2,793,654	2,438,945
收取之股利	18,575	33,337
支付之利息	( 292,547 )	( 250,334 )
支付所得稅	( 729,593 )	( 41,732 )
營業活動之淨現金流入	<u>23,934,087</u>	<u>17,896,286</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 4,652,794 )	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	158,781	309,442
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 64,302 )
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	18,093	18,041
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	120,509	-
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 39,991,204 )	( 50,550,558 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	38,762,429	54,981,575
取得採用權益法之投資	( 28,350 )	-
取得不動產、廠房及設備	六(三十) ( 2,346,904 )	( 2,166,602 )
處分不動產、廠房及設備價款	-	15,428
取得無形資產	六(三十) ( 1,647,943 )	( 1,461,125 )
存出保證金(增加)減少	( 99,791 )	830
其他非流動資產減少	-	1,737
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>( 9,707,174 )</u>	<u>1,084,466</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款舉借	六(三十一) 88,214,680	134,242,945
短期借款償還	六(三十一) ( 87,964,680 )	( 143,730,939 )
長期借款舉借	六(三十一) -	511,090
長期借款償還	六(三十一) ( 2,239,560 )	-
租賃負債本金償還	六(三十一) ( 126,960 )	( 114,716 )
存入保證金減少	六(三十一) ( 285 )	( 92 )
現金股利及資本公積配發現金數	( 7,949,387 )	( 13,847,319 )
現金股利返還	351	216
籌資活動之淨現金流出	<u>( 10,065,841 )</u>	<u>( 22,938,815 )</u>
匯率影響數	383,096	472,319
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,544,168	( 3,485,744 )
期初現金及約當現金餘額	10,268,291	13,754,035
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 14,812,459</u>	<u>\$ 10,268,291</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



附件五

114 年第一季合併財務報表及會計師核閱  
報告

## 會計師核閱報告

(114)財審報字第 25000085 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

**前言**

瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 3 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。

**範圍**

除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照中華民國核閱準則 2410 號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核意見。

**保留結論之基礎**

如合併財務報表附註四(三)及六(七)所述，列入上開合併財務報表之部分非重要子公司及採權益法之投資，其同期間財務報表及附註十三所揭露之相關資訊，係依據各該公司同期間自編未經會計師核閱之財務報表所編製而得。該等子公司民國 114 年及 113 年 3 月 31 日之資產總額分別為新台幣 8,358,780 仟元及新台幣 6,430,075 仟元，分別占合併資產總額之 6.55%及 6.43%；負債總額分別為新台幣 1,537,137 仟元及新台幣 1,159,680 仟元，分別占合併負債總額之 1.87%及 2.21%；其民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之綜合損益總額分別為新台幣(11,979)

仟元及新台幣 487,433 仟元，分別占合併綜合損益總額之(0.22%)及 9.11%。另對於採權益法之投資，民國 114 年及 113 年 3 月 31 日採權益法之投資餘額分別為新台幣 122,193 仟元及新台幣 105,788 仟元；其民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日所認列之投資(損)益分別為新台幣 1,547 仟元及新台幣(26,006)仟元。

### 保留結論

依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述部分非重要子公司及採權益法之投資其財務報表倘經會計師核閱，對合併財務報表可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第 34 號「期中財務報導」編製，致無法允當表達瑞昱半導體股份有限公司及子公司民國 114 年及 113 年 3 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量之情事。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

鄭雅慧

李典易

鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 4 年 4 月 3 0 日

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國114年3月31日及民國113年12月31日、3月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	114年3月31日		113年12月31日		113年3月31日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>流動資產</b>								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 10,568,080	8	\$ 14,812,459	13	\$ 10,167,058	10
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－流動		6,905,333	5	7,520,809	7	902,403	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)						
	產－流動		42,369,021	33	32,766,211	29	34,977,043	35
1170	應收帳款淨額	六(五)	16,119,883	13	12,305,290	11	12,822,372	13
1180	應收帳款－關係人淨額	六(五)及七	3,956,458	3	2,641,074	2	2,679,515	3
1200	其他應收款		677,132	1	604,664	-	1,025,258	1
130X	存貨	六(六)	15,149,433	12	13,506,049	12	11,977,261	12
1410	預付款項		507,636	-	501,451	-	497,681	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>96,252,976</u>	<u>75</u>	<u>84,658,007</u>	<u>74</u>	<u>75,048,591</u>	<u>75</u>
<b>非流動資產</b>								
1510	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產－非流動		-	-	-	-	53,000	-
1517	透過其他綜合損益按公允價	六(三)						
	值衡量之金融資產－非流動		3,339,920	3	3,340,653	3	3,550,443	4
1535	按攤銷後成本衡量之金融資	六(四)及八						
	產－非流動		9,919,379	8	9,067,774	8	5,761,914	6
1550	採用權益法之投資	六(七)	122,193	-	120,646	-	105,788	-
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	9,515,432	8	9,610,167	9	8,842,389	9
1755	使用權資產	六(九)	1,632,599	1	1,681,636	2	1,749,870	2
1760	投資性不動產淨額	六(十)	30,691	-	31,121	-	33,638	-
1780	無形資產	六(十一)	4,070,049	3	2,659,135	2	2,318,843	2
1840	遞延所得稅資產		519,636	-	437,137	-	303,721	-
1900	其他非流動資產	九	2,305,133	2	2,290,454	2	2,212,878	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>31,455,032</u>	<u>25</u>	<u>29,238,723</u>	<u>26</u>	<u>24,932,484</u>	<u>25</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 127,708,008</u>	<u>100</u>	<u>\$ 113,896,730</u>	<u>100</u>	<u>\$ 99,981,075</u>	<u>100</u>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國114年3月31日及民國113年12月31日、3月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	114年3月31日		113年12月31日		113年3月31日	
			金額	%	金額	%	金額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(十二)	\$ 3,879,714	3	\$ 4,500,000	4	\$ 2,400,000	3
2130	合約負債—流動	六(二十一)	324,901	-	413,754	-	323,595	-
2170	應付帳款		12,797,510	10	9,255,237	8	8,801,511	9
2180	應付帳款—關係人	七	367,050	-	328,371	-	334,636	-
2200	其他應付款	六(十三)	47,761,539	38	31,243,185	28	24,614,513	25
2220	其他應付款項—關係人	七	125,460	-	80,507	-	79,851	-
2230	本期所得稅負債		2,853,676	2	2,134,229	2	1,957,546	2
2280	租賃負債—流動		110,453	-	113,601	-	135,779	-
2300	其他流動負債	六(二十一)	11,065,300	9	9,892,091	9	8,370,934	8
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>79,285,603</u>	<u>62</u>	<u>57,960,975</u>	<u>51</u>	<u>47,018,365</u>	<u>47</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十四)	-	-	-	-	2,229,267	2
2550	負債準備—非流動	六(十六)	1,314,471	1	1,266,560	1	1,480,517	2
2570	遞延所得稅負債		346,232	-	265,722	-	167,554	-
2580	租賃負債—非流動		1,311,899	1	1,361,638	1	1,398,004	1
2600	其他非流動負債		75,600	-	84,347	-	97,599	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>3,048,202</u>	<u>2</u>	<u>2,978,267</u>	<u>2</u>	<u>5,372,941</u>	<u>5</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>82,333,805</u>	<u>64</u>	<u>60,939,242</u>	<u>53</u>	<u>52,391,306</u>	<u>52</u>
<b>歸屬於母公司業主之權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)	5,128,636	4	5,128,636	5	5,128,636	5
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)	287,282	-	287,282	-	542,048	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)	8,882,764	7	8,882,764	8	8,882,764	9
3350	未分配盈餘		23,735,183	19	32,051,651	28	27,716,645	28
其他權益								
3400	其他權益	六(二十)	7,330,633	6	6,597,430	6	5,310,003	5
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>45,364,498</u>	<u>36</u>	<u>52,947,763</u>	<u>47</u>	<u>47,580,096</u>	<u>48</u>
36XX	<b>非控制權益</b>		<u>9,705</u>	<u>-</u>	<u>9,725</u>	<u>-</u>	<u>9,673</u>	<u>-</u>
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>45,374,203</u>	<u>36</u>	<u>52,957,488</u>	<u>47</u>	<u>47,589,769</u>	<u>48</u>
重大承諾事項及或有事項								
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	九	<u>\$ 127,708,008</u>	<u>100</u>	<u>\$ 113,896,730</u>	<u>100</u>	<u>\$ 99,981,075</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
民國114年及113年1月1日至3月31日



單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	114年1月1日至3月31日			113年1月1日至3月31日		
		金額	%		金額	%	
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 35,022,396	100		\$ 25,622,844	100	
5000 營業成本	六(六)及七	(16,965,408)	(48)		(12,598,418)	(49)	
5950 營業毛利淨額		18,056,988	52		13,024,426	51	
營業費用	六(二十六) (二十七)及七						
6100 推銷費用		(1,708,525)	(5)		(1,181,035)	(4)	
6200 管理費用		(1,665,121)	(5)		(1,214,069)	(5)	
6300 研究發展費用		(9,732,412)	(28)		(7,859,188)	(31)	
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(47,291)	-		(27,044)	-	
6000 營業費用合計		(13,153,349)	(38)		(10,281,336)	(40)	
6900 營業利益		4,903,639	14		2,743,090	11	
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十二)	662,911	2		632,584	2	
7010 其他收入	六(二十三)	15,726	-		16,675	-	
7020 其他利益及損失	六(二十四)	50,230	-		11,056	-	
7050 財務成本	六(二十五)	(28,837)	-		(41,370)	-	
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	1,547	-		(26,006)	-	
7000 營業外收入及支出合計		701,577	2		592,939	2	
7900 稅前淨利		5,605,216	16		3,336,029	13	
7950 所得稅費用	六(二十八)	(843,681)	(2)		(206,490)	(1)	
8200 本期淨利		\$ 4,761,535	14		\$ 3,129,539	12	
其他綜合損益	六(二十)						
不重分類至損益之項目							
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(三)	(\$ 25,892)	-		\$ 393,962	2	
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		759,095	2		1,828,166	7	
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 733,203	2		\$ 2,222,128	9	
8500 本期綜合損益總額		\$ 5,494,738	16		\$ 5,351,667	21	
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 4,761,555	14		\$ 3,129,508	12	
8620 非控制權益		(20)	-		31	-	
		\$ 4,761,535	14		\$ 3,129,539	12	
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 5,494,758	16		\$ 5,351,636	21	
8720 非控制權益		(20)	-		31	-	
		\$ 5,494,738	16		\$ 5,351,667	21	
基本每股盈餘	六(二十九)						
9750 本期淨利		\$ 9.28			\$ 6.10		
稀釋每股盈餘	六(二十九)						
9850 本期淨利		\$ 9.14			\$ 6.05		

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



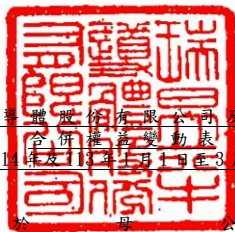
經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及其子公司  
合併權益變動表  
民國113年1月1日至3月31日



單位：新台幣仟元

	歸屬於母公司的業主之權益		其他權益				非控制權益	權益總額	
	保留盈餘	其他權益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之資產未實現損益	其他權益	綜合損益			
附註	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘				
<u>113年1月1日至3月31日</u>									
113年1月1日餘額	\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	\$ 9,702	\$ 42,238,162
本期淨利	-	-	-	3,129,508	-	-	3,129,508	31	3,129,539
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	1,828,166	393,962	2,222,128	-	2,222,128
本期綜合損益總額	-	-	-	3,129,508	1,828,166	393,962	5,351,636	31	5,351,667
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(二十)	-	-	( 258,135 )	-	258,135	-	-	-
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	( 60 )	( 60 )
113年3月31日餘額	\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ 27,716,645	\$ 3,406,323	\$ 1,903,680	\$ 47,580,096	\$ 9,673	\$ 47,589,769
<u>114年1月1日至3月31日</u>									
114年1月1日餘額	\$ 5,128,636	\$ 287,282	\$ 8,882,764	\$ 32,051,651	\$ 4,724,667	\$ 1,872,763	\$ 52,947,763	\$ 9,725	\$ 52,957,488
本期淨利	-	-	-	4,761,555	-	-	4,761,555	( 20 )	4,761,535
本期其他綜合損益	六(二十)	-	-	-	759,095	( 25,892 )	733,203	-	733,203
本期綜合損益總額	-	-	-	4,761,555	759,095	( 25,892 )	5,494,758	( 20 )	5,494,738
113年度盈餘指撥及分派									
股東現金股利	六(十九)	-	-	( 13,078,023 )	-	-	( 13,078,023 )	-	( 13,078,023 )
114年3月31日餘額	\$ 5,128,636	\$ 287,282	\$ 8,882,764	\$ 23,735,183	\$ 5,483,762	\$ 1,846,871	\$ 45,364,498	\$ 9,705	\$ 45,374,203

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國114年及113年1月1日至3月31日



單位：新台幣仟元

附註	114年1月1日 至3月31日	113年1月1日 至3月31日
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期稅前淨利	\$ 5,605,216	\$ 3,336,029
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(二十六) 364,441	351,431
攤提費用	六(十一) (二十六) 520,037	436,978
預期信用減損損失	十二(二) 47,291	27,044
利息費用	六(二十五) 28,837	41,370
利息收入	六(二十二) ( 662,911 )	( 632,584 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨(利益)損失	六(二)(二十四) ( 33,585 )	5,431
採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	六(七) ( 1,547 )	26,006
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十四) -	1
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	724,123	40,998
應收帳款	( 3,849,195 )	( 2,180,400 )
應收帳款-關係人	( 1,328,073 )	( 591,544 )
其他應收款	( 19,755 )	35,252
存貨	( 1,643,384 )	( 220,327 )
預付款項	( 6,185 )	69,080
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動	( 88,853 )	( 13,053 )
應付帳款	3,542,273	1,897,502
應付帳款-關係人	38,679	( 34,468 )
其他應付款	2,783,486	1,179,056
其他應付款-關係人	44,953	19,558
其他流動負債	1,173,209	461,507
負債準備-非流動	33,182	31,990
應計退休金負債	( 8,747 )	454

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國114年及113年1月1日至3月31日



單位：新台幣仟元

附註	114年1月1日 至3月31日	113年1月1日 至3月31日
營運產生之現金流入	\$ 7,263,492	\$ 4,287,311
收取之利息	610,198	188,698
支付之利息	( 28,769 )	( 43,400 )
支付所得稅	( 133,153 )	( 13,292 )
營業活動之淨現金流入	<u>7,711,768</u>	<u>4,419,317</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	16,939	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		
融資產	-	42,727
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 14,692,127 )	( 4,574,252 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,788,794	3,251,539
取得不動產、廠房及設備	六(三十) ( 246,411 )	( 605,880 )
取得無形資產	六(三十) ( 1,259,915 )	( 998,496 )
存出保證金減少(增加)	924	( 1,135 )
投資活動之淨現金流出	<u>( 11,391,796 )</u>	<u>( 2,885,497 )</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款舉借	六(三十一) 15,672,670	22,798,975
短期借款償還	六(三十一) ( 16,300,000 )	( 24,648,975 )
租賃負債本金償還	六(三十一) ( 32,199 )	( 31,635 )
存入保證金減少	六(三十一) -	( 185 )
籌資活動之淨現金流出	<u>( 659,529 )</u>	<u>( 1,881,820 )</u>
匯率影響數	95,178	246,767
本期現金及約當現金減少數	( 4,244,379 )	( 101,233 )
期初現金及約當現金餘額	14,812,459	10,268,291
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 10,568,080</u>	<u>\$ 10,167,058</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



附件六

112 年度個體財務報表及會計師查核報告

會計師查核報告

(113)財審報字第 23002884 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

瑞昱半導體股份有限公司（以下簡稱「瑞昱公司」）民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達瑞昱公司民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與瑞昱公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞昱公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

瑞昱公司民國 112 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

### **存貨之評價**

#### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四、(十一)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五、(二)；存貨會計項目說明，請詳個體財務報告附註六、(三)。

瑞昱公司主要係研究、開發、製造、銷售各種積體電路及相關應用軟體，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量。由於存貨金額重大且該等存貨因產業市場變遷快速，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。因此本會計師對瑞昱公司之存貨評價列為查核最為重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡分類之正確性。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估瑞昱公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瑞昱公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞昱公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瑞昱公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瑞昱公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瑞昱公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於瑞昱公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瑞昱公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

李典易

會計師

鄭雅慧

鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日



瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,406,399	3	\$ 2,538,812	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動		79,523	-	57,533	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	7,616,665	9	5,364,402	5
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)及七	1,362,924	2	1,096,212	1
1200	其他應收款		1,220	-	2,861	-
1210	其他應收款—關係人	七	3,224,525	4	6,910,735	7
130X	存貨	六(三)	7,819,879	9	12,024,974	12
1410	預付款項		369,046	-	366,842	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>22,880,181</u>	<u>27</u>	<u>28,362,371</u>	<u>28</u>
<b>非流動資產</b>						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動		53,000	-	53,000	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動		180,901	-	61,455	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動	八	89,598	-	81,197	-
1550	採用權益法之投資	六(四)	46,919,559	55	59,161,713	59
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	8,382,515	10	7,133,169	7
1755	使用權資產	六(六)	1,574,916	2	1,331,689	1
1780	無形資產	六(七)	2,575,121	3	2,353,616	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	287,659	-	132,969	-
1900	其他非流動資產	九	2,170,167	3	2,262,850	2
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>62,233,436</u>	<u>73</u>	<u>72,571,658</u>	<u>72</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 85,113,617</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100,934,029</u>	<u>100</u>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國112年及111年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	112年12月31日		111年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(八)	\$	4,250,000	5	\$	13,737,994	14
2130	合約負債－流動	六(十六)		131,853	-		52,282	-
2170	應付帳款			4,958,007	6		4,411,608	5
2180	應付帳款－關係人	七		311,850	-		90,102	-
2200	其他應付款	六(九)		21,694,542	26		25,604,066	25
2220	其他應付款項－關係人	七		279,265	-		232,531	-
2230	本期所得稅負債			1,748,109	2		1,374,807	1
2280	租賃負債－流動			29,191	-		27,166	-
2300	其他流動負債	六(十六)		5,630,149	7		5,701,663	6
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>39,032,966</u>	<u>46</u>		<u>51,232,219</u>	<u>51</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十)		2,227,346	3		1,713,316	2
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		203,766	-		62,725	-
2580	租賃負債－非流動			1,322,500	1		1,067,060	1
2600	其他非流動負債	六(十一)		98,579	-		105,477	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>3,852,191</u>	<u>4</u>		<u>2,948,578</u>	<u>3</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>42,885,157</u>	<u>50</u>		<u>54,180,797</u>	<u>54</u>
<b>權益</b>								
<b>股本</b>								
3110	普通股股本	六(十二)		5,128,636	6		5,128,636	5
<b>資本公積</b>								
3200	資本公積	六(十三)		542,048	1		1,045,147	1
<b>保留盈餘</b>								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		8,882,764	10		7,262,359	7
3320	特別盈餘公積			-	-		1,776,089	2
3350	未分配盈餘			24,845,272	29		28,854,826	29
<b>其他權益</b>								
3400	其他權益	六(十五)		2,829,740	4		2,686,175	2
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>42,228,460</u>	<u>50</u>		<u>46,753,232</u>	<u>46</u>
重大承諾事項及或有事項		九						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>85,113,617</u>	<u>100</u>	\$	<u>100,934,029</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司  
個體綜合損益表

民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	112 年 度			111 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 61,378,334	100	\$ 67,491,952	100		
5000 營業成本	六(三)及七	( 34,470,870)	( 56)	( 35,701,718)	( 53)		
5900 營業毛利		26,907,464	44	31,790,234	47		
5910 未實現銷貨利益		( 698)	-	( 168)	-		
5920 已實現銷貨利益		566	-	1,427	-		
5950 營業毛利淨額		26,907,332	44	31,791,493	47		
營業費用	六(二十一) (二十二)及七						
6100 推銷費用		( 2,496,684)	( 4)	( 2,979,097)	( 4)		
6200 管理費用		( 2,624,997)	( 4)	( 2,880,970)	( 4)		
6300 研究發展費用		( 20,057,180)	( 33)	( 24,745,357)	( 37)		
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(二)	( 25,469)	-	33,415	-		
6000 營業費用合計		( 25,204,330)	( 41)	( 30,572,009)	( 45)		
6900 營業利益		1,703,002	3	1,219,484	2		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十七)及七	307,216	-	227,202	-		
7010 其他收入	六(十八)及七	118,103	-	227,189	-		
7020 其他利益及損失	六(十九)	327,900	1	203,097	-		
7050 財務成本	六(二十)	( 235,939)	-	( 201,454)	-		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(四)	7,317,490	12	15,206,534	23		
7000 營業外收入及支出合計		7,834,770	13	15,662,568	23		
7900 稅前淨利		9,537,772	16	16,882,052	25		
7950 所得稅費用	六(二十三)	( 385,000)	( 1)	( 678,000)	( 1)		
8200 本期淨利		\$ 9,152,772	15	\$ 16,204,052	24		
其他綜合損益	六(十五)						
不重分類至損益之項目							
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益		( \$ 50,099)	-	\$ 26,419	-		
8330 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-不重分類至損益之項 目		( 73,690)	-	( 1,015,383)	( 1)		
8310 不重分類至損益之項目總額		( 123,789)	-	( 988,964)	( 1)		
後續可能重分類至損益之項目							
8380 採用權益法認列關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額-可 能重分類至損益之項目		283,799	-	5,451,229	8		
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 160,010	-	\$ 4,462,265	7		
8500 本期綜合損益總額		\$ 9,312,782	15	\$ 20,666,317	31		
基本每股盈餘	六(二十四)						
9750 本期淨利		\$ 17.85		\$ 31.62			
稀釋每股盈餘	六(二十四)						
9850 本期淨利		\$ 17.59		\$ 30.48			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司  
個體權益變動表  
民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	總額
								透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	權益總額
								國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
<u>111 年 度</u>									
111年1月1日餘額		\$ 5,106,849	\$ 1,101,079	\$ 5,577,083	\$ 1,556,049	\$27,377,681	(\$ 4,156,871)	\$ 2,380,781	\$38,942,651
本期淨利		-	-	-	-	16,204,052	-	-	16,204,052
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	5,451,229	( 988,964)	4,462,265
本期綜合損益總額		-	-	-	-	16,204,052	5,451,229	( 988,964)	20,666,317
110年度盈餘指撥及分派									
法定盈餘公積提列	六(十四)	-	-	1,685,276	-	( 1,685,276)	-	-	-
特別盈餘公積提列	六(十四)	-	-	-	220,040	( 220,040)	-	-	-
股東現金股利	六(十四)	-	-	-	-	( 12,821,591)	-	-	( 12,821,591)
員工酬勞轉增資	六(十二)(十三)	21,787	969,551	-	-	-	-	-	991,338
資本公積配發現金	六(十三)	-	( 1,025,727)	-	-	-	-	-	( 1,025,727)
現金股利返還	六(十三)	-	244	-	-	-	-	-	244
111年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$46,753,232
<u>112 年 度</u>									
112年1月1日餘額		\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$46,753,232
本期淨利		-	-	-	-	9,152,772	-	-	9,152,772
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	283,799	( 123,789)	160,010
本期綜合損益總額		-	-	-	-	9,152,772	283,799	( 123,789)	9,312,782
111年度盈餘指撥及分派									
法定盈餘公積提列	六(十四)	-	-	1,620,405	-	( 1,620,405)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	六(十四)	-	-	-	( 1,776,089)	1,776,089	-	-	-
股東現金股利	六(十四)	-	-	-	-	( 13,334,455)	-	-	( 13,334,455)
資本公積配發現金	六(十三)	-	( 512,864)	-	-	-	-	-	( 512,864)
採用權益法認列之關聯企業之變動數		-	9,549	-	-	-	-	-	9,549
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		-	-	-	-	16,445	-	( 16,445)	-
現金股利返還	六(十三)	-	216	-	-	-	-	-	216
112年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$42,228,460

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能





瑞昱半導體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國112年及111年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 9,537,772	\$ 16,882,052
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十一)	1,118,605	976,697
攤提費用	六(七)(二十一)	1,692,464	1,589,992
預期信用減損損失(利益)	十二(二)	25,469	( 33,415 )
利息費用	六(二十)	235,939	201,454
利息收入	六(十七)	( 307,216 )	( 227,202 )
股利收入	六(十八)	( 320 )	( 1,278 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨 (利益)損失	六(十九)	( 21,990 )	71,596
採權益法認列之關聯企業及合資利益之份 額	六(四)	( 7,317,490 )	( 15,206,534 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	( 4,905 )	( 1,002 )
減損損失		-	3,031
處分投資利益	六(十九)	( 305,599 )	-
租賃修改利益	六(十九)	-	( 24 )
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		( 2,275,038 )	2,570,380
應收帳款-關係人		( 269,406 )	720,747
其他應收款		1,394	5,391
其他應收款-關係人		( 39,731 )	( 13,074 )
存貨		4,205,095	( 224,079 )
預付款項		( 2,204 )	119,276
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		79,571	( 31,977 )
應付票據		-	( 3,276 )
應付帳款		546,399	( 2,937,835 )
應付帳款-關係人		221,748	( 146,871 )
其他應付款		( 4,582,071 )	4,010,659
其他應付款項-關係人		46,734	168,577
其他流動負債		( 71,514 )	657,199
應計退休金負債		( 3,873 )	( 4,484 )

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	附註	112 年 度	111 年 度
營運產生之現金流入		\$ 2,509,833	\$ 9,146,000
收取之利息		304,123	227,111
收取之股利		13,671,511	6,235,211
支付之利息		( 238,814 )	( 198,423 )
支付所得稅		( 25,412 )	( 748,966 )
營業活動之淨現金流入		<u>16,221,241</u>	<u>14,660,933</u>
<u>投資活動之現金流量</u>			
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			
-非流動		-	( 53,000 )
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		( 64,302 )	( 35,037 )
取得按攤銷後成本衡量之金融資產		( 8,401 )	( 10,125 )
處分按攤銷後成本衡量之金融資產		-	4,786
其他應收款-關係人增加		( 6,537,032 )	( 11,788,573 )
其他應收款-關係人減少		7,192,173	15,495,845
取得採用權益法之投資	六(四)	( 30,215 )	-
處分採用權益法之投資		6,436,133	-
採權益法之被投資公司減資退回股款		3,067,700	-
取得不動產、廠房及設備	六(二十五)	( 2,108,931 )	( 2,349,017 )
處分不動產、廠房及設備價款		12,355	4,064
取得無形資產	六(二十五)	( 1,455,145 )	( 1,953,420 )
存出保證金減少(增加)		1,672	( 1,452,037 )
其他非流動資產增加		-	( 91,011 )
投資活動之淨現金流入(流出)		<u>6,506,007</u>	<u>( 2,227,525 )</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>			
短期借款舉借	六(二十六)	134,242,945	161,350,173
短期借款償還	六(二十六)	( 143,730,939 )	( 160,954,279 )
長期借款舉借	六(二十六)	511,090	711,110
租賃負債本金償還	六(二十六)	( 35,569 )	( 28,142 )
存入保證金減少	六(二十六)	( 85 )	( 719 )
現金股利及資本公積配發現金數		( 13,847,319 )	( 13,847,318 )
現金股利返還		216	244
籌資活動之淨現金流出		<u>( 22,859,661 )</u>	<u>( 12,768,931 )</u>
本期現金及約當現金減少數		( 132,413 )	( 335,523 )
期初現金及約當現金餘額		<u>2,538,812</u>	<u>2,874,335</u>
期末現金及約當現金餘額		<u>\$ 2,406,399</u>	<u>\$ 2,538,812</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



附件七

113 年度個體財務報表及會計師查核報告

會計師查核報告

(114)財審報字第 24003275 號

瑞昱半導體股份有限公司 公鑒：

**查核意見**

瑞昱半導體股份有限公司（以下簡稱「瑞昱公司」）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達瑞昱公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

**查核意見之基礎**

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與瑞昱公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

**關鍵查核事項**

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對瑞昱公司民國 113 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

瑞昱公司民國 113 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

### **存貨之評價**

#### 事項說明

有關存貨評價之會計政策，請詳個體財務報告附註四、(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五、(二)；存貨會計項目說明，請詳個體財務報告附註六、(三)。

瑞昱公司主要係研究、開發、製造、銷售各種積體電路及相關應用軟體，對於存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量。由於存貨金額重大且該等存貨因產業市場變遷快速，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。因此本會計師對瑞昱公司之存貨評價列為查核重要事項之一。

#### 因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序如下：

1. 瞭解及評估存貨備抵跌價損失提列政策合理性。
2. 測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量及金額與存貨明細一致、驗證存貨異動日期之相關佐證文件，確認庫齡分類之正確性。
3. 評估及確認淨變現價值決定之合理性，包含驗證淨變現價值之相關佐證文件。

### **管理階層與治理單位對個體財務報表之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估瑞昱公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算瑞昱公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

瑞昱公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對瑞昱公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使瑞昱公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致瑞昱公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於瑞昱公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對瑞昱公司民國 113 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

李典易

會計師

鄭雅慧

李典易

鄭雅慧



金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1020028992 號

前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日



瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國113年及112年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	113年12月31日		112年12月31日	
			金額	%	金額	%
<b>流動資產</b>						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 7,083,963	7	\$ 2,406,399	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資 產—流動		677,158	1	79,523	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流 動		1,639,050	2	-	-
1170	應收帳款淨額	六(二)	7,013,282	7	7,616,665	9
1180	應收帳款—關係人淨額	六(二)及七	1,453,622	1	1,362,924	2
1200	其他應收款		80,594	-	1,220	-
1210	其他應收款—關係人	七	244,160	-	3,224,525	4
130X	存貨	六(三)	9,218,023	9	7,819,879	9
1410	預付款項		332,823	-	369,046	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>27,742,675</u>	<u>27</u>	<u>22,880,181</u>	<u>27</u>
<b>非流動資產</b>						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資 產—非流動		-	-	53,000	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動		73,865	-	180,901	-
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非 流動	八	140,453	-	89,598	-
1550	採用權益法之投資	六(四)	59,274,486	57	46,919,559	55
1600	不動產、廠房及設備	六(五)	9,245,962	9	8,382,515	10
1755	使用權資產	六(六)	1,546,507	2	1,574,916	2
1780	無形資產	六(七)	2,618,949	3	2,575,121	3
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	360,563	-	287,659	-
1900	其他非流動資產	九	2,267,910	2	2,170,167	3
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>75,528,695</u>	<u>73</u>	<u>62,233,436</u>	<u>73</u>
1XXX	<b>資產總計</b>		<u>\$ 103,271,370</u>	<u>100</u>	<u>\$ 85,113,617</u>	<u>100</u>

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司  
個體資產負債表  
民國113年及112年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	113年12月31日		112年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>								
2100	短期借款	六(八)	\$	4,500,000	4	\$	4,250,000	5
2130	合約負債—流動	六(十六)		183,330	-		131,853	-
2170	應付帳款			5,627,798	6		4,958,007	6
2180	應付帳款—關係人	七		212,428	-		311,850	-
2200	其他應付款	六(九)		29,134,620	28		21,694,542	26
2220	其他應付款項—關係人	七		77,329	-		279,265	-
2230	本期所得稅負債			1,622,093	2		1,748,109	2
2280	租賃負債—流動			42,060	-		29,191	-
2300	其他流動負債	六(十六)		7,278,485	7		5,630,149	7
21XX	<b>流動負債合計</b>			<u>48,678,143</u>	<u>47</u>		<u>39,032,966</u>	<u>46</u>
<b>非流動負債</b>								
2540	長期借款	六(十)		-	-		2,227,346	3
2570	遞延所得稅負債	六(二十三)		265,722	1		203,766	-
2580	租賃負債—非流動			1,296,801	1		1,322,500	1
2600	其他非流動負債	六(十一)		82,941	-		98,579	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>			<u>1,645,464</u>	<u>2</u>		<u>3,852,191</u>	<u>4</u>
2XXX	<b>負債總計</b>			<u>50,323,607</u>	<u>49</u>		<u>42,885,157</u>	<u>50</u>
<b>權益</b>								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		5,128,636	5		5,128,636	6
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		287,282	-		542,048	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		8,882,764	9		8,882,764	10
3350	未分配盈餘			32,051,651	31		24,845,272	29
其他權益								
3400	其他權益	六(十五)		6,597,430	6		2,829,740	4
3XXX	<b>權益總計</b>			<u>52,947,763</u>	<u>51</u>		<u>42,228,460</u>	<u>50</u>
重大承諾事項及或有事項		九						
3X2X	<b>負債及權益總計</b>		\$	<u>103,271,370</u>	<u>100</u>	\$	<u>85,113,617</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司  
個體綜合損益表

民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	113 年 度			112 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十六)及七	\$ 75,482,296	100		\$ 61,378,334	100	
5000 營業成本	六(三)及七	( 39,649,469)	( 53)		( 34,470,870)	( 56)	
5900 營業毛利		35,832,827	47		26,907,464	44	
5910 未實現銷貨利益		( 173)	-		( 698)	-	
5920 已實現銷貨利益		280	-		566	-	
5950 營業毛利淨額		35,832,934	47		26,907,332	44	
營業費用	六(二十一) (二十二)及七						
6100 推銷費用		( 3,708,204)	( 5)		( 2,496,684)	( 4)	
6200 管理費用		( 3,841,679)	( 5)		( 2,624,997)	( 4)	
6300 研究發展費用		( 28,103,442)	( 37)		( 20,057,180)	( 33)	
6450 預期信用減損利益(損失)	十二(二)	5,175	-		( 25,469)	-	
6000 營業費用合計		( 35,648,150)	( 47)		( 25,204,330)	( 41)	
6900 營業利益		184,784	-		1,703,002	3	
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(十七)及七	338,243	1		307,216	-	
7010 其他收入	六(十八)及七	243,727	-		118,103	-	
7020 其他利益及損失	六(十九)	( 87,902)	-		327,900	1	
7050 財務成本	六(二十)	( 279,055)	-		( 235,939)	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額	六(四)	15,397,428	20		7,317,490	12	
7000 營業外收入及支出合計		15,612,441	21		7,834,770	13	
7900 稅前淨利		15,797,225	21		9,537,772	16	
7950 所得稅費用	六(二十三)	( 505,783)	( 1)		( 385,000)	( 1)	
8200 本期淨利		\$ 15,291,442	20		\$ 9,152,772	15	
其他綜合損益	六(十五)						
不重分類至損益之項目							
8316 透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益		( \$ 107,036)	-		( \$ 50,099)	-	
8330 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損益 之份額-不重分類至損益之項 目		336,108	1		( 73,690)	-	
8310 不重分類至損益之項目總額		229,072	1		( 123,789)	-	
後續可能重分類至損益之項目							
8380 採用權益法認列關聯企業及合 資之其他綜合損益之份額-可 能重分類至損益之項目		3,146,510	4		283,799	-	
8300 其他綜合損益(淨額)		\$ 3,375,582	5		\$ 160,010	-	
8500 本期綜合損益總額		\$ 18,667,024	25		\$ 9,312,782	15	
基本每股盈餘	六(二十四)						
9750 本期淨利		\$	29.82		\$	17.85	
稀釋每股盈餘	六(二十四)						
9850 本期淨利		\$	29.32		\$	17.59	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建

經理人：顏光裕

會計主管：張智能

瑞昱半導體股份有限公司  
個體權益變動表  
民國113年及112年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	普通股	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	其他權益	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	權益總額
112 年 度										
112年1月1日餘額		\$ 5,128,636	\$ 1,045,147	\$ 7,262,359	\$ 1,776,089	\$ 28,854,826	\$ 1,294,358	\$ 1,391,817	\$ 46,753,232	
本期淨利		-	-	-	-	9,152,772	-	-	9,152,772	
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	283,799	( 123,789 )	160,010	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	9,152,772	283,799	( 123,789 )	9,312,782	
111 年度盈餘指撥及分派										
法定盈餘公積提列	六(十四)	-	-	1,620,405	-	( 1,620,405 )	-	-	-	
特別盈餘公積迴轉	六(十四)	-	-	-	( 1,776,089 )	1,776,089	-	-	-	
股東現金股利	六(十四)	-	-	-	-	( 13,334,455 )	-	-	( 13,334,455 )	
資本公積配發現金	六(十三)(十四)	-	( 512,864 )	-	-	-	-	-	( 512,864 )	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	六(十三)	-	9,549	-	-	-	-	-	9,549	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(十五)	-	-	-	-	16,445	-	( 16,445 )	-	
現金股利返還	六(十三)	-	216	-	-	-	-	-	216	
112年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	
113 年 度										
113年1月1日餘額		\$ 5,128,636	\$ 542,048	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 24,845,272	\$ 1,578,157	\$ 1,251,583	\$ 42,228,460	
本期淨利		-	-	-	-	15,291,442	-	-	15,291,442	
本期其他綜合損益	六(十五)	-	-	-	-	-	3,146,510	229,072	3,375,582	
本期綜合損益總額		-	-	-	-	15,291,442	3,146,510	229,072	18,667,024	
112 年度盈餘指撥及分派										
股東現金股利	六(十四)	-	-	-	-	( 7,692,955 )	-	-	( 7,692,955 )	
資本公積配發現金	六(十三)(十四)	-	( 256,432 )	-	-	-	-	-	( 256,432 )	
採用權益法認列之關聯企業之變動數	六(十三)	-	1,315	-	-	-	-	-	1,315	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	六(十五)	-	-	-	-	( 392,108 )	-	392,108	-	
現金股利返還	六(十三)	-	351	-	-	-	-	-	351	
113年12月31日餘額		\$ 5,128,636	\$ 287,282	\$ 8,882,764	\$ -	\$ 32,051,651	\$ 4,724,667	\$ 1,872,763	\$ 52,947,763	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能





瑞昱半導體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	113 年 度	112 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期稅前淨利		\$ 15,797,225	\$ 9,537,772
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(二十一)	1,282,590	1,118,605
攤提費用	六(七)(二十一)	1,863,142	1,692,464
預期信用減損(利益)損失	十二(二)	( 5,175 )	25,469
利息費用	六(二十)	279,055	235,939
利息收入	六(十七)	( 338,243 )	( 307,216 )
股利收入	六(十八)	( 320 )	( 320 )
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失(利益)	六(十九)	40,871	( 21,990 )
採權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	六(四)	( 15,397,428 )	( 7,317,490 )
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九)	-	( 4,905 )
處分投資利益	六(十九)	-	( 305,599 )
金融資產減損損失	六(十九)	53,000	-
未實現銷貨利益		( 107 )	132
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
應收帳款		609,474	( 2,275,038 )
應收帳款-關係人		( 91,614 )	( 269,406 )
其他應收款		3,077	1,394
其他應收款-關係人		( 3,014 )	( 39,731 )
存貨		( 1,398,144 )	4,205,095
預付款項		36,223	( 2,204 )
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債-流動		51,477	79,571
應付帳款		669,791	546,399
應付帳款-關係人		( 99,422 )	221,748
其他應付款		7,356,370	( 4,582,071 )
其他應付款項-關係人		( 201,935 )	46,734
其他流動負債		1,648,336	( 71,514 )
應計退休金負債		( 3,602 )	( 3,873 )

(續次頁)

瑞昱半導體股份有限公司  
個體現金流量表  
民國113年及112年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	113 年 度	112 年 度
營運產生之現金流入	\$ 12,151,627	\$ 2,509,965
收取之利息	255,792	304,123
收取之股利	6,526,861	13,671,511
支付之利息	( 283,204 )	( 238,814 )
支付所得稅	( 645,341 )	( 25,412 )
營業活動之淨現金流入	<u>18,005,735</u>	<u>16,221,373</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	( 638,506 )	-
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	( 64,302 )
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	( 1,689,905 )	( 8,401 )
其他應收款-關係人增加	( 5,661,498 )	( 6,537,032 )
其他應收款-關係人減少	8,644,877	7,192,173
取得採用權益法之投資	六(四) -	( 30,215 )
處分採用權益法之投資	-	6,436,001
採權益法之被投資公司減資退回股款	-	3,067,700
取得不動產、廠房及設備	六(二十五) ( 2,269,618 )	( 2,108,931 )
處分不動產、廠房及設備價款	-	12,355
取得無形資產	六(二十五) ( 1,638,738 )	( 1,455,145 )
存出保證金(增加)減少	( 97,743 )	1,672
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>( 3,351,131 )</u>	<u>6,505,875</u>
<u>籌資活動之現金流量</u>		
短期借款舉借	六(二十六) 88,214,680	134,242,945
短期借款償還	六(二十六) ( 87,964,680 )	( 143,730,939 )
長期借款舉借	六(二十六) -	511,090
長期借款償還	六(二十六) ( 2,239,560 )	-
租賃負債本金償還	六(二十六) ( 38,622 )	( 35,569 )
存入保證金增加(減少)	六(二十六) 178	( 85 )
現金股利及資本公積配發現金數	( 7,949,387 )	( 13,847,319 )
現金股利返還	351	216
籌資活動之淨現金流出	<u>( 9,977,040 )</u>	<u>( 22,859,661 )</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	4,677,564	( 132,413 )
期初現金及約當現金餘額	2,406,399	2,538,812
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 7,083,963</u>	<u>\$ 2,406,399</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：邱順建



經理人：顏光裕



會計主管：張智能



瑞昱半導體股份有限公司



董事長 邱順建

